合肥新汇成微电子股份有限公司

Union Semiconductor（Hefei）Co., Ltd.

（合肥市新站区合肥综合保税区内）

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

保荐机构（主承销商）

海通证券股份有限公司

HAITONG SECURITIES CO., LTD.

（上海市广东路 689 号）

二〇二四年八月

声 明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转换公司债券，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性管理要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转换公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募集资金投资项目正常实施的风险。

二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。

三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的信用评级报告，发行人主体信用评级为 AA-，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA-。

本次发行的可转换公司债券上市后，在债券存续期内，中证鹏元将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

四、本次发行不提供担保

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在的兑付风险。

五、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险：

（一）市场竞争加剧及公司综合竞争力相对行业头部企业较小的风险

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，显示驱动芯片封测领域资本不断涌入。一方面，境内行业龙头企业不断拓展产品线，如通富微电2017年立项研究12吋晶圆金凸块制造技术，进军显示驱动芯片封测领域。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，如深圳同兴达科技股份有限公司与日月光半导体（昆山）有限公司合作的“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”已经逐步实施。

相比显示驱动芯片封测行业头部企业颀邦科技、南茂科技等，公司业务规模仍存在较大差距。公司起步较晚，受资金、规模等方面的限制，综合竞争力亟待提升。在业务快速扩张的过程中，如果公司不能很好地应对同行业龙头企业竞争中的规模优势，将可能导致公司业务发展受阻；此外，境内外龙头企业的双重竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击。

（二）区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内主要生产设备和部分原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在60%以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

（三）毛利率波动及下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为30.63%、30.18%和27.17%，2023年毛利率相较于2022年度有所下降，主要系2022年下半年至2023年第一季度，公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，而订单饱和度有所下降，单位固定成本有所上升导致。如果未来受显示面板产业周期波动影响，或国家产业政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展，造成人力成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者公司研发未来受限于资金规模，不能持续有效地实施业务发展规划，保持技术与服务的领先性，提供高附加值服务，均可能导致公司毛利率面临进一步下滑的风险。

（四）客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的主营业务收入合计分别为56,284.51万元、70,531.76万元和89,078.78万元，占当期主营业务收入的比例为73.48%、79.75%和76.24%，客户集中度较高。如果未来公司的主要客户生产经营出现问题，导致其向公司下达的订单数量下降，或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

（五）供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购额合计为28,053.53万元、

30,939.63万元和39,853.89万元，占当期原材料采购总额的比例为83.79%、83.07%和80.32%，供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（六）实际控制人借款金额较大，存在影响公司实际控制人稳定性的风险

公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投入规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展、为员工持股平台支付增资款以吸引优秀人才和维持团队稳定，以及受让股东持有的部分股权，资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至2024年5月13日，公司实际控制人郑瑞俊存在多项未到期的大额负债，借款本金超过3亿元，负债到期时间为2025年1月至2026年9月不等。如实际控制人不能按期偿还借款，则届时实际控制人持有的公司股份可能被债权人要求冻结、处置，存在对公司实际控制人稳定性造成不利影响的风险。

（七）本次募集资金投资项目未达预期效益的风险

本次募集资金投资主要投向12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目，募集资金投资项目的实施计划、实施进度主要根据发行人及行业过往建设经验确定，项目预计效益主要根据可行性研究报告编制时点的市场购销价格、历史经验以及未来预测市场情况等测算得出，综合考虑了市场环境、行业发展趋势等各种因素。若项目建设过程中出现项目管理和实施等方面的不可预见风险，或项目建成后市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游需求不及预期、原材料成本上升等情形，则可能导致本次募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

（八）本次募投项目与前次募投项目新增折旧摊销对公司经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目全部建成后，发行人将新增大量固定资产，项目投入运营后，正常年度每年预计新增折旧摊销金额为10,247.86万元，公司本次募投项目与前次募投项目新增折旧摊销金额对公司经营业绩的影响情况如下：

单位：万元

项目	前次募投项目	本次募投项目	合计
折旧摊销金额①	8,115.70 注	10,247.86	18,363.56
本次募投项目预计新增收入②			45,142.44
公司 2023 年度收入③			123,829.30
占 2023 年度收入及募投项目预计新增收入之和的比例④=①/（②+③）			**10.87%**
本次募投项目预计新增息税折旧摊销前利润⑤			20,265.78
公司 2023 年度息税折旧摊销前利润⑥			47,730.24
占 2023 年度利润总额及募投项目预计新增利润总额之和的比例⑦=①/（⑤+⑥）			**27.01%**

注：截至 2023 年 12 月末，公司前次募投项目已实施完毕，为充分反映前次募投项目折旧摊销金额对公司经营业绩的影响，上表中前次募投项目折旧摊销金额系根据 2023 年 12 月前次募投项目折旧摊销金额年化计算，即 2023 年 12 月前次募投项目折旧摊销金额*12。

如上表所示，公司前次募投项目和本次募投项目折旧摊销合计金额占2023年度收入及募投项目预计新增收入之和的比例为10.87%，占2023年度息税折旧摊销前利润及募投项目预计新增息税折旧摊销前利润之和的比例为27.01%。由于项目从开始建设到产生效益需要一段时间，且影响募集资金投资效益实现的因素较多，如果未来市场环境发生重大不利变化或者项目经营管理不善，使得项目在投产后实际效益低于预期或晚于预期，则公司仍存在因折旧摊销费用增加而导致利润下滑的风险。

（九）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险

1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对公司生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致

可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

六、关于填补即期回报的措施和承诺

（一）应对本次发行摊薄即期回报采取的主要措施

公司向不特定对象发行可转换公司债券后，存在公司即期回报被摊薄的风险。公司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，以填补股东回报，实现公司的可持续发展、增强公司持续回报能力。但需要提醒投资者特别注意的是，公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。具体措施如下：

1、严格执行募集资金管理制度，保证募集资金合理规范使用

为规范募集资金的管理和使用，确保募集资金专项用于募集资金投资项目，公司已经根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定并完善了公司的募集资金管理制度，明确规定公司对募集资金采用专户专储、专款专用的制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况加以监督。公司将定期检查募集资金使用情况，保证募集资金得到合理合法使用。

2、稳步推进募集资金投资项目建设，争取尽快实现效益

本次募集资金将用于公司 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目。本次发行可转债募集资金投资项目的实施，有利于扩大公司的市场占有率，进一步提升公司竞争优势，提升可持续发展能力，有利于实现并维护股东的长远利益。公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目尽快完成，提高公司经营业绩和盈利能力，有助于填补本次发行对股东即期回报的摊薄。

3、完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司严格遵循《公司法》《证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权

并作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，特别是中小股东的合法权益；确保监事会能够独立有效地行使对董事和高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、完善利润分配政策，重视投资者回报

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展战略、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。

为进一步完善和健全公司的利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》，结合公司实际情况，公司制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》。未来，公司将严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。

（二）应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺

1、公司控股股东出具的相关承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司控股股东扬州新瑞连承诺：

“1、本承诺人承诺将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本承诺人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

3、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必

要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

4、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺；

5、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”

2、公司实际控制人出具的相关承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人郑瑞俊、杨会承诺：

“1、本承诺人承诺将忠实、勤勉地履行作为实际控制人的职责，维护公司和全体股东的合法权益；

2、本承诺人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

3、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

4、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺；

5、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”

3、公司董事、高级管理人员出具的相关承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员承诺：

“1、本承诺人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，

也不得采用其他方式损害公司利益；

2、本承诺人承诺对本承诺人的职务消费行为进行约束；

3、本承诺人承诺不得动用公司资产从事与本承诺人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本承诺人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度；

5、本承诺人承诺如公司未来实施新的股权激励方案，应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本承诺人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，根据未来中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本承诺人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

7、本承诺出具日后至公司本次发行完毕前，中国证券监督管理委员会、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足该等规定时，本承诺人承诺届时将出具补充承诺；

8、若本承诺人违反上述承诺给上市公司及其他股东造成损失，一切损失将由本承诺人承担。”

请投资者关注以上重大事项提示，并仔细阅读本募集说明书中“第三节 风险因素”等有关章节。

目 录

声 明 1

重大事项提示 2

一、不符合科创板股票投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持可转换债券不能转股的风险 2

二、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 2

三、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级 3

四、本次发行不提供担保 3

五、特别风险提示 3

六、关于填补即期回报的措施和承诺 7

目 录 11

第一节 释义 15

第二节 本次发行概况 21

一、发行人基本情况 21

二、本次发行的背景和目的 21

三、本次发行概况 24

四、本次发行可转债的基本条款 28

五、本次发行的有关机构 39

六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系 41

第三节 风险因素 42

一、与发行人相关的风险 42

二、与行业相关的风险 46

三、其他风险 47

第四节 发行人基本情况 51

一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况 51

二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施 52

三、公司组织结构及主要对外投资情况 53

四、公司控股股东、实际控制人基本情况 55

五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....58
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员.....62
七、公司所处行业基本情况.....80
八、公司的主营业务情况.....104
九、与产品有关的技术情况.....116
十、与业务相关的主要固定资产及无形资产.....120
十一、上市以来的重大资产重组情况.....125
十二、境外经营情况.....125
十三、发行人报告期内的分红情况.....125
十四、发行人的最近三年发行的债券情况.....130
第五节 财务会计信息与管理层分析.....131
一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平.....131
二、发行人财务报表.....131
三、财务报表的编制基础.....135
四、合并财务报表范围及变化情况.....136
五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表.....136
六、报告期内会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正.....139
七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策.....140
八、财务状况分析.....142
九、盈利能力分析.....165
十、现金流量分析.....182
十一、资本性支出分析.....185
十二、技术创新分析.....186
十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响....188
十四、本次发行的影响.....189
第六节 合规经营与独立性.....190
一、发行人及其子公司报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况.....190
二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被中国证

监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况.....190
三、发行人资金占用和对外担保情况.....190
四、同业竞争.....190
五、关联方及关联交易情况.....193
第七节 本次募集资金运用.....211
一、本次募集资金使用计划.....211
二、本次募集资金投资项目的具体情况.....211
三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式.....222
四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性.....223
五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响.....225
第八节 历次募集资金运用.....227
一、最近五年内募集资金情况.....227
二、前次募集资金基本情况.....228
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用.....232
四、前次募集资金运用专项报告结论.....233
第九节 声明.....234
一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明.....234
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....235
三、保荐机构（主承销商）声明（一）.....236
三、保荐机构（主承销商）声明（二）.....237
四、发行人律师声明.....238
五、承担审计业务的会计师事务所声明.....239
六、评级机构声明.....240
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺.....241
第十节 备查文件.....242

附件一、专利 243

第一节 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

一、普通名词释义		
公司、本公司、发行人、汇成股份	指	合肥新汇成微电子股份有限公司
汇成有限	指	合肥新汇成微电子有限公司，发行人前身
江苏汇成	指	江苏汇成光电有限公司，发行人全资子公司
晶汇聚芯	指	合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙），发行人参股公司
晶合汇信	指	合肥晶合汇信私募基金管理有限公司，发行人参股公司
扬州新瑞连	指	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙），发行人控股股东
香港宝信	指	宝信国际投资有限公司，一家中国香港公司，员工持股平台
合肥芯成	指	合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥汇芯	指	合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥宝芯	指	合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
汇成投资	指	汇成投资控股有限公司，发行人股东
嘉兴高和	指	嘉兴高和股权创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东，原名为嘉兴高和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
志道投资	指	安徽志道投资有限公司，发行人股东
海通新动能	指	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人股东
海通新能源	指	海通新能源私募股权投资管理有限公司，海通新动能执行事务合伙人
海通开元	指	海通开元投资有限公司，海通证券全资子公司，海通新能源股东
合肥创投	指	合肥市创业投资引导基金有限公司，发行人股东
瑞成建筑	指	瑞成建筑工程（安徽）有限公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
瑞成投资	指	瑞成投资控股有限公司，一家中国香港公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
香港瑞仕	指	香港瑞仕投资控股有限公司，一家中国香港公司，实际控制人郑瑞俊之子控制的企业
百瑞发投资	指	百瑞发投资股份有限公司，一家中国台湾公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
天虹科技	指	天虹科技股份有限公司，股票代码：6937.TWO
语音基金	指	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股东
蔚华电子	指	蔚华电子科技（上海）有限公司，发行人股东
Spirox	指	Spirox Cayman Corporation，一家开曼公司，蔚华电子之控股股东
蔚华科技	指	蔚华科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：

		3055.TW，Spirox 之控股股东
Advance	指	Advance Allied Limited，一家塞舌尔公司，发行人股东
Great Title	指	Great Title Limited，一家 BVI 公司，发行人股东
Strong Lion	指	Strong Lion Limited，一家塞舌尔公司，发行人股东
合肥鑫城	指	合肥鑫城控股集团有限公司，原名为合肥鑫城国有资产经营有限公司
合肥国正	指	合肥产投国正股权投资有限公司，原名为合肥市国正资产经营有限公司
汇成股份专项资管计划	指	富诚海富通汇成股份员工参与科创板战略配售集合资产管理计划，发行人的高级管理人员与核心员工参与首次公开发行股票战略配售设立的专项资产管理计划
天钰科技	指	天钰科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：4961.TW，发行人客户
联咏科技	指	联咏科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码为：3034.TW，发行人客户
奇景光电	指	Himax Technologies Inc，奇景光电股份有限公司，美股上市公司，股票代码为：HIMX.O，发行人客户
瑞鼎科技	指	瑞鼎科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3592.TWO，发行人客户
矽创电子	指	矽创电子股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：8016.TW，发行人客户
奕力科技	指	奕力科技股份有限公司，知名显示驱动芯片设计公司，发行人客户
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司，知名显示驱动芯片设计公司，发行人客户
爱协生	指	深圳市爱协生科技股份有限公司，知名显示驱动芯片设计公司，发行人客户
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：000725.SZ，知名面板厂商
华星光电	指	TCL 华星光电技术有限公司，知名面板厂商，其控股股东 TCL 科技集团股份有限公司系 A 股上市公司，股票代码：000100.SZ
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002387.SZ，知名面板厂商
友达光电	指	友达光电股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：2409.TW，知名面板厂商
惠科股份	指	惠科股份有限公司，知名面板厂商
日月光	指	日月光投资控股股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3711.TW
Amkor	指	Amkor Technology Inc，安靠科技，美股上市公司，股票代码：AMKR.O
颀邦科技	指	颀邦科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：6147.TWO
南茂科技	指	南茂科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：8150.TW
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：600584.SH
通富微电	指	通富微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002156.SZ

华天科技	指	天水华天科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002185.SZ
甬矽电子	指	甬矽电子（宁波）股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688362.SH
晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：603005.SH
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688135.SH
气派科技	指	气派科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688216.SH
颀中科技	指	合肥颀中科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688352.SH
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688249.SH，知名晶圆制造厂商，位于合肥市综合保税区，主要从事面板显示驱动芯片的晶圆代工
田中贵金属	指	田中贵金属（上海）有限公司，发行人供应商，其母公司为田中贵金属工业株式会社，隶属于日本田中贵金属集团
光洋科技	指	光洋应用材料科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：1785.TW，光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司与光洋新材料科技（昆山）有限公司之控股股东，发行人供应商
光洋化学	指	光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司，发行人供应商
利机股份	指	利机企业股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3444.TWO，发行人供应商
昇云半导体	指	昇云半导体科技（香港）有限公司，发行人供应商
怡康化工	指	上海怡康化工材料有限公司，发行人供应商，系中国台湾上市公司华立企业股份有限公司（3010.TW）集团内企业，是光刻胶领域巨头日本合成橡胶株式会社在中国大陆的代理商之一
中国半导体行业协会	指	由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织
Frost & Sullivan	指	弗若斯特沙利文公司，成立于 1961 年，总部位于美国纽约，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立 45 个办公室，拥有超过 2,000 名咨询顾问，为多家全球 1,000 强公司、新兴企业和投资机构提供了市场投融资及战略与管理咨询服务
保荐人、保荐机构、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司，发行人保荐机构
发行人律师	指	安徽天禾律师事务所，发行人律师
天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙），发行人会计师
评级机构、中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
报告期	指	2021 年、2022 年及 2023 年
可转债	指	可转换公司债券
本次发行、本期可转债	指	本次发行人向不特定对象发行可转换公司债券
本募集说明书	指	《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

《公司章程》	指	《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业术语释义		
吋	指	英寸的缩写，一吋等于 2.54 厘米
Bumping	指	在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，反应了先进制程“以点代线”的发展趋势，广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装
Gold Bumping	指	金凸块制造，是一种利用金凸块接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术
CP	指	Chip Probing 的缩写，即晶圆测试，是一道用探针对每个晶粒上的接点进行接触测试其电气特性，标记出不合格的晶粒的工序
COG	指	Chip on Glass 的缩写，即玻璃覆晶封装，是一种将芯片直接绑定在玻璃上的封装技术
COF	指	Chip on Film/Flex 的缩写，即薄膜覆晶封装，是一种将芯片绑定在软性基板电路上的封装技术
引脚	指	集成电路内部电路与外围电路的接线
pin	指	探针，连接晶圆管脚和探针卡的金属针
铝垫	指	金属铝制作的晶圆内部电路电信号输入输出的端口，即晶圆管脚
探针	指	一种测试接口，通过电气连接对芯片参数进行测试
I/O	指	Input/Output 的缩写，即输入输出端口
电镀液	指	可以扩大金属的阴极电流密度范围、改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体
光刻胶	指	在光线照射下，溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料
UV	指	Ultraviolet，紫外线
Tray 盘	指	晶粒盘，是用于承托晶粒（芯片）的托盘
模组	指	由数个基础功能组件组成的特定功能组件，可用来组成具备完整功能之系统、设备或程序
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示，是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示技术
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有机发光二极管，属于一种电流型的有机发光显示技术
AMOLED	指	Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有源矩阵有机发光二极管，其中 OLED（有机发光二极管）是描述薄膜显示技术的具体类型，AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术
Micro LED	指	Micro Light-Emitting Diode 的缩写，指微型发光二极管，高密度集成的 LED 阵列
4K	指	3840*2160 分辨率，属于超高清分辨率
8K	指	7680*4320 分辨率，为 4K 的 4 倍
Fabless	指	仅进行芯片的设计、研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装测试厂商的经营模式
Foundry	指	专门负责晶圆制造的代工厂

OSAT	指	Outsourced Semiconductor Assembly and Testing 的缩写，即半导体封装测试外包，专门负责封装测试的代工厂
FC、Flip Chip	指	一种封装技术，FC 系 Flip Chip 的缩写，即倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
WLCSP	指	一种封装技术，Wafer Level Chip Scale Packaging 的缩写，晶圆片级芯片规模封装，此技术是先在整片晶圆上进行封装测试，其后再切割成单个芯片
SoC	指	一种封装技术，System on Chip 的缩写，即系统级单芯片封装，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
MEMS	指	一种封装技术，Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，微机电系统，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源、微能源、信号处理和控制电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统
TSV	指	一种封装技术，Through Silicon Via 的缩写，即晶圆级系统封装-硅通孔，是一种通过硅通道垂直穿过组成堆栈的不同芯片或不同层实现不同功能芯片集成的封装技术
Fan-Out	指	一种封装技术，扇出型集成电路封装，指基于晶圆重构技术，将芯片重新埋置到晶圆上，然后按照与标准 WLP 工艺类似的步骤进行封装，得到的实际封装面积要大于芯片面积，在面积扩展的同时也可以增加其它有源器件及无源元件形成 SiP
TO	指	一种封装技术，Transistor Outlin 的缩写，即晶体管封装，插入式封装之一，较早期的封装形式
DIP	指	一种封装技术，Dual In-line Package 的缩写，即双列直插式封装，插装型封装之一，引脚从封装两侧引出
CDIP	指	一种封装技术，Ceramic Dual In-line Package 的缩写，即陶瓷双列直插封装，一种 DIP 封装，芯片封装材料为陶瓷
PDIP	指	一种封装技术，Plastic Dual In-Line Package 的缩写，即塑料双列直插式封装，是一种 DIP 封装，芯片封装材料为塑料
SIP	指	一种封装技术，Single In-line 的缩写，即单列直插式封装，引脚从封装一个侧面引出，排列成一条直线，当装配到印刷基板上时封装呈侧立状
PLCC	指	一种封装技术，Plastic Leaded Chip Carrier 的缩写，即塑料有引线片式载体封装，表面贴装型封装形式之一，是一种带引线、塑料的芯片封装载体，引脚从封装的四个侧面引出，呈“丁”字形，外形尺寸比 DIP 封装小得多
QFP	指	一种封装技术，Quad Flat Package 的缩写，即方型扁平式封装，表面贴装型封装之一，引脚从四个侧面引出呈海鸥翼型
PQFP	指	一种封装技术，Plastic Quad Flat Package 的缩写，即塑料四边引线扁平封装，是一种 QFP 封装，芯片封装材料为塑料
SOP	指	一种封装技术，Small Outline Package 的缩写，即小外形表面封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）
SOT	指	一种封装技术，Small Outline Transistor 的缩写，即小外形晶体管封装，一种 SOP 系列封装
QFN	指	一种封装技术，Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低

PQFN	指	一种封装技术，Power Quad Flat No-lead Package 的缩写，即功率方形扁平无引脚封装，是一种基于 QFN 封装的热性能增强版本，在四周底侧装有金属化端子
BGA	指	一种封装技术，Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装，圆形或柱状的焊点按阵列形式分布在基板下面的封装形式
PBGA	指	一种封装技术，Plastic Ball Grid Array Package 的缩写，即塑料焊球阵列封装，是一种 BGA 封装，芯片封装材料为塑料
CBGA	指	一种封装技术，Ceramic Plastic Ball Grid Array Package 的缩写，即陶瓷焊球阵列封装，是一种 BGA 封装，芯片封装材料为陶瓷
EBGA	指	一种封装技术，Enhanced Plastic Ball Grid Array Package 的缩写，即带散热器焊球阵列封装，是一种 BGA 封装，具有低功耗和高散热效果的特点
FC-BGA	指	一种封装技术，Flip Chip Ball Grid Array 的缩写，即倒装芯片焊球阵列封装，是图形加速芯片最主要的封装格式
LGA	指	一种封装技术，Land Grid Array 的缩写，即栅格阵列封装，是一种 BGA 封装
WLP	指	一种封装技术，Wafer Level Packaging 的缩写，即晶圆级封装，一般指直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序，之后再进行切割（Singulation）制成单颗组件的封装技术
CSP	指	一种封装技术，Chip Size Package 的缩写，即芯片级封装，是最新一代的内存芯片封装技术，可以让芯片面积与封装面积之比超过 1:1.14
MCM	指	一种封装技术，Multi-Chip Module 的缩写，即多芯组装，一种将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的封装形式
SiP	指	一种封装技术，System In a Package 的缩写，系统级封装，是将多种功能芯片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，实现一定功能的单个标准封装件，从而形成一个系统或者子系统
3D	指	一种封装技术，三维立体封装，是在 2D 的基础上进一步向 Z 方向发展的微电子组装高密度化封装形式，主要有埋置型、有源基板型与叠层型三种类型
TCP	指	一种封装技术，Tape Carrier Package 的缩写，即带载封装技术，是 LCD 模块组装工序中封装有驱动芯片的 TAB（Tape Automated Bonding 带式自动组装）的一种封装方式
牛鞭效应	指	营销过程中的需求变异放大现象被通俗地称为“牛鞭效应”，指供应链上的信息流从最终客户向原始供应商端传递时候，由于无法有效地实现信息的共享，使得信息扭曲而逐渐放大，导致了需求信息出现越来越大的波动

本募集说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

公司名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
英文名称	Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
股本总额	83,485.3281 万元
股票代码	688403
股票简称	汇成股份
股票上市地	上海证券交易所
法定代表人	郑瑞俊
有限公司成立日期	2015 年 12 月 18 日
股份公司成立日期	2021 年 3 月 30 日
上市日期	2022 年 8 月 18 日
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内

二、本次发行的背景和目的

（一）本次发行的背景

1、公司具备先进且成熟的制程工艺，为项目建设提供了保障

显示驱动芯片封装测试行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，需要企业具备丰富的生产加工经验。近年来，OLED 显示驱动芯片不断应用于高端电子消费产品和新能源汽车上，下游厂商对于 OLED 显示驱动芯片的品质要求越来越高，且集成电路设计和制造业技术不断进步，加快了各种封装技术和工艺水平的更新进步周期，需要企业不断进行创新和改进技术水平。

汇成股份长期专注于显示驱动芯片封装测试的研究开发和产业化应用，针对显示驱动芯片封装测试过程中的具体工艺或生产装置进行技术研发，自主研发积累了大量工艺技术，在行业内具有领先地位。公司的核心技术包括驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术、高精度高效内引脚接合工艺等，特别是金凸块制造技术以黄金作为材料，具有出色的导电

性、机械加工性以及散热性能，可满足显示面板驱动的使用要求。本次募投项目各制程主要采用公司成熟的工艺，可快速部署投入生产，保障项目顺利实施。

2、公司具备扎实的客户合作基础，为项目建设提供了良好基础

集成电路设计与制造行业具有技术和资本密集特点，行业集中度较高。基于对产品良率和成本的考量，封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认证后才能达成长期合作，故存在较高的供应链门槛。公司凭借稳定的产品良率、全流程的生产服务能力和交付能力获得了行业内知名客户的广泛认可，公司所封测的显示驱动芯片也被应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，服务能力被各方合作企业所信赖。公司的下游客户覆盖了全球排名前五和国内排名前十显示驱动芯片设计公司中的主要企业，包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等知名显示驱动芯片设计企业，具备良好的客户合作基础，能够为本次募投项目的投产运营提供市场支持。综上所述，广泛的客户资源和良好的客户认可度，为公司的业务承接和业务推广提供了帮助，有助于本次募投项目建成后的产能消化。

3、广阔的市场前景为项目的实施提供了保障

随着社会经济和科学技术的发展，显示驱动产品不仅仅应用于智能手机、电脑、电视等电子产品，智能家居的兴起使得智能冰箱、空调、家居中控也都采用显示屏作为智能交互系统。同时，由于新能源汽车的智能驾驶、智慧座舱理念的推广，车载用屏尺寸和数量持续上升，车载显示市场需求快速增长。根据 Frost & Sullivan 分析，由于晶圆产能供给紧张，显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模也将随之上涨，预计在 2025 年达到 56.10 亿美元。在显示驱动芯片封测市场需求量持续走高的情况下，下游市场能够快速消化本次募投项目新增的产能，为本次募投项目的运营提供保障。

（二）本次发行的目的

1、顺应行业发展趋势，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求

公司是国内领先的显示驱动芯片封装测试服务商，制程包括金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装。公司多次开展生产线投资扩产，目前已

建成江苏扬州和安徽合肥两大生产基地，由于技术稳定且服务完善，在全球范围内取得了广泛认可。

随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达到 14.0 亿颗，预计 2025 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达 24.5 亿颗，市场占比达到 10.5%。

公司作为专业从事于晶圆测试和封装的企业，在显示驱动芯片封测行业深耕多年，具备丰富的产品经验和服务技术经验。针对市场发展趋势，公司计划扩大在 OLED 领域的产能配置，但是公司当前的设备配置无法满足 OLED 显示驱动芯片需求快速增长的生产需要。为抓住市场机遇，公司计划引进先进高效的生产设备，提升 OLED 产品封装测试能力，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求，进一步提升公司在显示驱动芯片领域的竞争优势。

2、有利于提高规模效益，抢占市场份额，提升公司影响力

显示驱动芯片封装测试行业技术水平要求较高、资金需求大、人才综合素质门槛高、客户认证严格，因此行业进入壁垒较高，国内可以实现大规模显示驱动芯片封装测试的企业较少。公司在显示驱动芯片封装测试领域从业多年，拥有扎实的核心技术体系和规模生产经验，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。通过本次募投项目的建设，公司的封装测试服务能力进一步加强，扩充了产品生产规模，强化了规模效益，有利于降低服务成本，提高单位产品的盈利能力；另一方面，本次募投项目购置的先进封测设备，能够满足新型 OLED 产品的生产需求，从而公司能够更快地布局 OLED 显示驱动芯片封测市场，抓住 OLED 市场机遇。有助于公司稳固现有客户的同时，进行 OLED 市场的开拓，获取更大的市场份额。

随着我国集成电路产业供应链体系的不断完善，本土显示驱动芯片产业的发展前景广阔。首先，第三代显示技术 OLED 具有能耗低、发光率好、亮度高和

轻薄等优点，在终端设备中的应用越来越广泛，国产厂商的产能规模快速扩大。其次，随着智能网联汽车的兴起，座舱系统对显示面板的需求快速增加，有望拉动显示面板行业的增长。本次募投项目建成后，公司将扩大 OLED 面板的显示驱动封装测试规模，并且拓展车载显示面板市场，扩大国内市场份额，提升公司的品牌影响力。

3、有利于满足市场对先进封装测试服务的需要，提高封装测试行业的国产化水平

随着技术的升级换代，高集成度、低能耗成为电子产品最主要的发展趋势，终端用户对性能体验的要求促进了芯片设计、制造与封装的发展。先进封装测试工艺能够减小芯片占用尺寸、布线长度、厚度等，帮助降低能耗，提高终端用户的屏幕交互体验，促使显示面板厂商会优先采用先进封装测试工艺，因此市场规模快速增长。公司自主开发的金凸块制造技术直接在晶圆上形成焊球或金柱，在此基础上实现了显示驱动芯片的晶圆级高密度细间距倒装封装，有助于开发屏占比高和轻薄化的显示面板，符合整体行业发展趋势。本次募投项目引入先进高效的生产设备后能够提高公司针对 OLED 等新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造和测试服务能力，满足下游客户不断增长的对先进显示驱动芯片封装测试的需求。

目前，我国的液晶显示面板产能占到了全球的 60%以上，但我国芯片产业起步较晚，境外发达国家及地区已经掌握芯片制程的核心技术，并占据了主要芯片市场，因此显示面板上游的芯片制造等高附加值产业大多为境外企业所掌握。在此背景下，境内企业拓展显示面板产品上游产业链，提升产业链上游及中游产品供给能力，实现全流程国产化势在必行。本次募投项目的建设，有助于推动芯片产业链中芯片封测这一环节的建设，强化国产芯片在晶圆封测这一环节的技术能力，使境内产业链整体流转更加畅通，提高行业的国产化水平。

三、本次发行概况

（一）本次发行证券的类型

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。

（二）发行数量

本次发行的可转债拟募集资金总额 114,870.00 万元，共计 1,148,700 手（11,487,000 张）。

（三）证券面值和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（四）预计募集资金量及募集资金净额

本次拟发行可转债的募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后预计募集资金净额为 114,252.79 万元。

（五）募集资金专项存储账户

公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行的募集资金将存放于公司董事会（或董事会授权人士）指定的募集资金专项账户中。

（六）募集资金投向

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投入以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	35,000.00
2	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	50,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	29,870.00
合计		**138,711.04**	**114,870.00**

注：上述拟使用募集资金已扣除公司第一届董事会第十七次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资 5,130.00 万元。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（七）发行方式与发行对象

本次发行的汇成转债向发行人在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由保荐人（主承销商）包销。

向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后登记在册的公司所有 A 股股东。

网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（上证发〔2022〕91 号）的相关要求。

本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

（八）向原股东配售的安排

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。

原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日 2024 年 8 月 6 日（T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有的汇成股份股份数量按每股配售 1.395 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001395 手可转债。实际配售比例将根据可配售数量、可参与配售的股本基数确定。若至本次发行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化导致优先配售比例

发生变化，发行人和保荐人（主承销商）将于申购日（T 日）前（含）披露原股东优先配售比例调整公告。

原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

发行人现有总股本 834,853,281 股，剔除公司回购专户库存股 11,877,470 股后，可参与原股东优先配售的股本总额为 822,975,811 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 1,148,700 手。

（九）承销方式及承销期

本次发行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时间：自 2024 年 8 月 5 日至 2024 年 8 月 13 日。

（十）发行费用

项目	金额
保荐及承销费用	350.00 万元
律师费用	75.47 万元
审计费用	75.47 万元
资信评级费用	47.17 万元
用于本次发行的信息披露费用	56.60 万元
发行手续费等	12.49 万元
合计	617.21 万元

注：以上费用均为不含税金额，各项发行费用可能会根据本次发行的实际情况有所增减。上述表格数据尾差，系四舍五入所造成。

（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次发行期间的主要日程安排如下：

日期	发行安排
T-2 日 2024 年 8 月 5 日	刊登《募集说明书》及摘要、《发行公告》、《网上路演公告》
T-1 日	网上路演 原股东优先配售股权登记日

2024 年 8 月 6 日	
T 日 2024 年 8 月 7 日	刊登《发行提示性公告》 原股东优先配售（缴付足额资金） 网上申购（无需缴付申购资金） 确定网上中签率
T+1 日 2024 年 8 月 8 日	刊登《网上发行中签率及优先配售结果公告》 网上申购摇号抽签
T+2 日 2024 年 8 月 9 日	刊登《网上中签结果公告》 网上投资者根据中签号码确认认购数量并缴纳认购款（须确保资金账户在 T+2 日日终有足够的认购资金）
T+3 日 2024 年 8 月 12 日	保荐人（主承销商）根据资金到账情况确定最终配售结果和包销金额
T+4 日 2024 年 8 月 13 日	刊登《发行结果公告》 募集资金划至发行人账户

注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

本次申请向不特定对象发行的可转债将在上海证券交易所上市。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快申请本次向不特定对象发行的可转换公司债券在上海证券交易所上市，具体上市时间公司将另行公告。

本次发行的证券不设持有期限制。

四、本次发行可转债的基本条款

（一）债券期限

本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即 2024 年 8 月 7 日至 2030 年 8 月 6 日。

（二）面值

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

（三）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

（四）转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日2024年8月13日（T+4日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 2 月 13 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 6 日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。

（五）评级情况

公司本次发行的可转债已经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，其中公司主体信用等级为 AA-，本次可转债信用等级为 AA-，评级展望稳定。

在本次可转债存续期间，评级机构每年至少进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

（六）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

（1）债券持有人的权利

①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

②根据可转换公司债券募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

③根据可转换公司债券募集说明书约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）债券持有人的义务

①遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内及期满赎回期限内，发生下列情形之一的，公司董事会应召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更募集说明书的约定；

（2）拟修改可转换公司债券持有人会议规则；

（3）拟变更受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（4）公司未能按期支付当期应付的可转换公司债券本息；

（5）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被托管、解散、重整或者申请破产；

（6）担保人（如有）或担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；

（7）债券受托管理人、公司董事会、单独或合计持有本期可转债 10%以上未偿还债券面值的债券持有人书面提议召开；

（8）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

（9）公司提出重大债务重组方案的；

（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（11）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）债券受托管理人；

（2）公司董事会；

（3）单独或合计持有当期未偿还的可转债面值总额 10%以上的债券持有人书面提议；

（4）相关法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

3、债券持有人会议的表决、决议

（1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（2）公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

（3）债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨

认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

（4）债券持有人进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。

（5）会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

（6）会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

（7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

（8）除本规则另有规定外，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

（9）债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更发行人与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和《募集说明书》明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力外：

①如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力；

②如果该决议是根据发行人的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。

（七）转股价格调整的原则及方式

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转债的初始转股价格为 7.70 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。

前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；

前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：$P1=P0/(1+n)$；

增发新股或配股：$P1=(P0+A\times k)/(1+k)$；

上述两项同时进行：$P1=(P0+A\times k)/(1+n+k)$；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)/(1+n+k)

其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规定来制订。

（八）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。转股价格不得向上修正。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（九）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q：指可转换公司债券的转股数量；V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换 1 股的可转换公司债券余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额以及该余额对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。

（十）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 112%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十一）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的全部或部分可转换公司债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因六个月后的第一个交易日起而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司债券的权利，可转换公司债券持有人在满足附加回售条件后，可以在附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

当期应计利息的计算方式参见“（十）赎回条款”的相关内容。

（十二）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日下午收市后登记在册的所有 A 股普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十三）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：$I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

3、到期还本付息

公司将在本次可转债期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余额本息的事项。

（十四）构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

1、违约事件

在本次债券存续期内，以下事件构成发行人在债券受托管理协议和本次债券项下的违约事件：

（1）公司未能按时完成本次债券或本期债券的本息兑付；

（2）除债券受托管理协议另有约定外，公司不履行或违反债券受托管理协议关于公司义务的规定，出售重大资产以致对公司本次债券或本期债券的还本付

息能力产生实质不利影响；

（3）公司丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始与破产、清算相关的诉讼程序；

（4）公司发生未能清偿到期债务的违约情况；债务种类包括但不限于中期票据、短期融资券、企业债券、公司债券、可转换债券、可分离债券等直接融资债务，以及银行贷款、承兑汇票等间接融资债务；

（5）公司未按照债券持有人会议规则规定的程序，私自变更本次债券或本期债券募集资金用途；

（6）其他对本次债券或本期债券的按期付息兑付产生重大不利影响的情形。

2、违约责任

上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向可转债持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就可转债受托管理人因公司违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。

3、争议解决机制

受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，双方约定通过向受托管理人住所所在地有管辖权人民法院提起诉讼方式解决争议。

当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使受托管理协议项下的其他权利，并应履行受托管理协议项下的其他义务。

五、本次发行的有关机构

（一）发行人

名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
法定代表人	郑瑞俊

住所	合肥市新站区合肥综合保税区内
董事会秘书	奚勰
联系电话	0551-67139968-7099
传真号码	0551-67139968-7099

（二）保荐人（主承销商）

名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	周杰
住所	上海市广东路 689 号
联系电话	021-23219000
传真号码	021-63411627
保荐代表人	赵庆辰、何立
项目协办人	秦寅臻
其他项目组成员	陈杰、邢丞栋、李翔

（三）律师事务所

名称	安徽天禾律师事务所
机构负责人	卢贤榕
住所	合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层
联系电话	0551-62642792
传真号码	0551-62620450
经办律师	卢贤榕、陈磊、孙静

（四）会计师事务所

名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	王国海
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话	0571-88216888
传真号码	0571-88216999
经办注册会计师	向晓三、许红瑾

（五）申请上市的证券交易所

名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区杨高南路 388 号

电话	021-68808888
传真	021-68804868

（六）资信评级机构

机构名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
法定代表人	张剑文
住所	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼
联系电话	0755-82872897
传真号码	0755-82872090
经办评级人员	董斌、李爱文

（七）收款银行

开户行	上海银行徐汇支行
户名	海通证券股份有限公司
账号	03004485897

（八）证券登记机构

名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
联系地址	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话	021-58708888
传真	021-58899400

六、发行人与本次发行有关的中介机构的关系

截至 2023 年 12 月 31 日，保荐机构子公司海通创新证券投资有限公司持有汇成股份 6,678,826 股，持股比例 0.80%；海通新动能持有汇成股份 12,727,273 股，持股比例 1.52%，保荐机构子公司海通开元持有海通新能源 51.00%股权，海通新能源系海通新动能执行事务合伙人并持股 0.67%，海通开元另持有海通新动能 19.33%股权；保荐机构子公司上海海通证券资产管理有限公司资管业务持有汇成股份 6,868 股，持股比例 0.00082%；保荐机构衍生产品与交易部多空互换对冲账户持有汇成股份 43,002 股，持股比例 0.0052%。除此之外，发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

第三节 风险因素

投资者在评价发行人本次发行可转债时，除本募集说明书提供的其他资料外，应特别认真考虑下述风险因素。下述风险因素根据重要性原则或可能影响投资者决策的程度大小排序，该排序并不表示风险因素依次发生。

一、与发行人相关的风险

（一）技术风险

1、技术升级迭代的风险

随着显示面板性能需求的不断提升，显示驱动芯片技术朝着高分辨率、高帧率、高带宽、外围器件较少与功能高度集成化的方向发展。为了满足上述行业发展趋势，显示驱动芯片封测企业需通过设计及工艺的创新不断提升产品性能，为新产品的开发带来了更多的挑战，亦促进了Bumping、COG与COF等封装技术的发展。

目前公司专注于显示驱动芯片先进封测领域，主要使用Bumping、COG、COF等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

2、公司综合技术实力与全球行业龙头相比存在差距的风险

在整个集成电路封测行业，主要公司日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技产品线均横跨封测行业多个细分领域。在显示驱动芯片封测领域，头部企业颀邦科技、南茂科技依托原有技术布局其他细分领域多年，积极开拓新的产品线。公司在封测行业其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

在未来，如果公司未能实现其他细分领域封装工艺的研发，弥补与行业头部公司在研发能力与技术实力方面的差距，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

3、核心技术人才流失的风险

公司所处集成电路封测行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人才流失或不足、技术泄密等高科技企业共同面临的技术风险。

显示驱动芯片封测行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。目前中国大陆显示驱动芯片封测行业人才缺口较大，行业内人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。若公司核心技术人才流失或无法继续培养或招揽，将对公司的研发生产造成较大不利影响。

（二）经营风险

1、市场竞争加剧及公司综合竞争力相对行业头部企业较小的风险

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，显示驱动芯片封测领域资本不断涌入。一方面，境内行业龙头企业不断拓展产品线，如通富微电2017年立项研究12吋晶圆金凸块制造技术，进军显示驱动芯片封测领域。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，如深圳同兴达科技股份有限公司与日月光半导体（昆山）有限公司合作的“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”已经逐步实施。

相比显示驱动芯片封测行业头部企业颀邦科技、南茂科技等，公司业务规模仍存在较大差距。公司起步较晚，受资金、规模等方面的限制，综合竞争力亟待提升。在业务快速扩张的过程中，如果公司不能很好地应对同行业龙头企业竞争中的规模优势，将可能导致公司业务发展受阻；此外，境内外龙头企业的双重竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击。

2、客户集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大客户的主营业务收入合计分别为56,284.51万元、70,531.76万元和89,078.78万元，占当期主营业务收入的比例为73.48%、79.75%和76.24%，客户集中度较高。如果未来公司的主要客户生产经营出现问题，导致其向公司下达的订单数量下降，或公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

3、供应商集中度较高的风险

报告期内，公司向前五大原材料供应商采购额合计为28,053.53万元、30,939.63万元和39,853.89万元，占当期原材料采购总额的比例为83.79%、83.07%和80.32%，供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

4、其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期的风险

公司投入大量资金持续建设研发中心、吸纳技术人才，研发凸块制造技术及新能源车载芯片、图像处理芯片等其他细分领域封装技术。如果公司未来在其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期，有可能影响未来的业绩增长空间。

（三）财务风险

1、毛利率波动及下滑的风险

报告期内，公司主营业务毛利率分别为30.63%、30.18%和27.17%，2023年毛利率相较于2022年度有所下降，主要系2022年下半年至2023年第一季度，公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，而订单饱和度有所下降，单位固定成本有所上升导致。如果未来受显示面板产业周期波动影响，或国家产业政策调整，导致显示驱动芯片封测需求持续下滑，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展，造成人力成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者公司研发未来受限于资金规模，不能持续有效地实施业务发展规划，保持技术与服务的领先性，提供高附加值服务，均可能导致公司毛利率面临进一步下滑的风险。

2、存货跌价风险

报告期末，公司存货账面价值23,699.77万元，占期末流动资产的比例为36.32%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

3、新增固定资产折旧规模较大风险

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。报告期内，公司市场开拓良好，为了应对持续增长的市场需求，发行人通过自筹资金及IPO募集资金持续加大投资力度，固定资产规模持续增加，对应所产生的折旧费用保持在较高水平，报告期各期固定资产折旧费用金额分别为16,897.19万元、21,271.20万元和27,731.57万元，截至2023年末，在建工程账面价值为18,068.39万元。公司新增固定资产折旧规模较大，期末在建工程的逐步转固会进一步增加固定资产的折旧规模，且本次募投项目建成投产后的初期阶段，新增固定资产折旧将可能对发行人的经营业绩产生较大的影响。如果公司未来市场及客户开发不利，不能获得与新增折旧规模相匹配的销售规模增长，则公司存在因新增固定资产折旧规模较大导致利润下滑的风险。

4、政府补助政策变化的风险

集成电路行业系国家重点战略产业，各级政府或主管部门给予的补助政策较多，报告期内，公司计入当期损益的政府补助为4,296.13万元、2,979.05万元和2,343.60万元。如果未来相关政策发生变化，公司政府补助规模无法延续，将对公司经营业绩造成一定影响。

（四）内控风险

1、实际控制人借款金额较大，存在影响公司实际控制人稳定性的风险

公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投入规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展、为员工持股平台支付增资款以吸引优秀人才和维持团队稳定，以及受让股东持有的部分股权，资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至2024年5月13日，公司实际控制人郑瑞俊存在多项未到期的大额负债，借款本金超过3亿元，负债到期时间为2025年1月至2026年9月不等。如实际控制人不能按期偿还借款，则届时实际控制人持有的公司股份可能被债权人要求冻结、处置，存在对公司实际控制人稳定性造成不利影响的风险。

二、与行业相关的风险

（一）区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内主要生产设备和部分原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在60%以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、单位成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

（二）集成电路行业周期性波动风险

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性，若下游终端市场需求大幅减少，将对产业链上游供应产生不利影响，若公司无法提高市场占有率，提升对客户的供应份额，宏观经济环境以及终端市场的整体波动可能通过“牛鞭效应”对公司的经营业绩产生一定的影响。

（三）产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

三、其他风险

（一）募投项目风险

1、本次募集资金投资项目未达预期效益的风险

本次募集资金投资主要投向12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目和12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目，募集资金投资项目的实施计划、实施进度主要根据发行人及行业过往建设经验确定，项目预计效益主要根据可行性研究报告编制时点的市场购销价格、历史经验以及未来预测市场情况等测算得出，综合考虑了市场环境、行业发展趋势等各种因素。若项目建设过程中出现项目管理和实施等方面的不可预见风险，或项目建成后市场环境发生不利变化导致行业竞争加剧、产品价格下滑、下游需求不及预期、原材料成本上升等情形，则可能导致本次募集资金投资项目的实际效益与预期存在一定的差异。

2、本次募投项目与前次募投项目新增折旧摊销对公司经营业绩带来的风险

本次募集资金投资项目全部建成后，发行人将新增大量固定资产，项目投入运营后，正常年度每年预计新增折旧摊销金额为10,247.86万元，公司本次募投项目与前次募投项目新增折旧摊销金额对公司经营业绩的影响情况如下：

单位：万元

项目	前次募投项目	本次募投项目	合计
折旧摊销金额①	8,115.70 注	10,247.86	18,363.56
本次募投项目预计新增收入②			45,142.44
公司 2023 年度收入③			123,829.30
占 2023 年度收入及募投项目预计新增收入之和的比例④=①/（②+③）			**10.87%**
本次募投项目预计新增息税折旧摊销前利润⑤			20,265.78
公司 2023 年度息税折旧摊销前利润⑥			47,730.24
占 2023 年度利润总额及募投项目预计新增利润总额之和的比例⑦=①/（⑤+⑥）			**27.01%**

注：截至 2023 年 12 月末，公司前次募投项目已实施完毕，为充分反映前次募投项目折旧摊销金额对公司经营业绩的影响，上表中前次募投项目折旧摊销金额系根据 2023 年 12 月前次募投项目折旧摊销金额年化计算，即 2023 年 12 月前次募投项目折旧摊销金额*12。

如上表所示，公司前次募投项目和本次募投项目折旧摊销合计金额占2023年度收入及募投项目预计新增收入之和的比例为10.87%，占2023年度息税折旧摊销前利润及募投项目预计新增息税折旧摊销前利润之和的比例为27.01%。由于项目从开始建设到产生效益需要一段时间，且影响募集资金投资效益实现的因素较多，如果未来市场环境发生重大不利变化或者项目经营管理不善，使得项目在投产后实际效益低于预期或晚于预期，则公司仍存在因折旧摊销费用增加而导致利润下滑的风险。

3、募集资金投资项目实施风险

本次募集资金投资项目经过充分的市场调研及严谨的论证并结合公司实际经营状况而确定，符合公司的实际发展需求。如果出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境变化等不利变化，公司募投项目将存在不能全部按期竣工投产的风险。

4、新增产能消化风险

公司本次募集资金投资项目的实施将会新增公司Bumping、CP、COG与COF等工序的产能，对公司的市场营销和业务拓展提出了更高的要求。若公司不能相应有效地拓展产品市场，在客户开发、技术发展、经营管理等方面不能与扩张后的业务规模相匹配，则可能导致公司未来存在一定的产能消化风险。

（二）与本次可转换公司债券发行相关的主要风险

1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者行使回售权，则公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，对公司生产经营产生负面影响。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，不能从预期的还款来源获得足够的资金，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及投资者回售时的承兑能力。

2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债转股情况受转股价格、转股期内公司股票价格、投资者偏好及预期等诸多因素影响。如因公司股票价格低迷或未达到债券持有人预期等原因导致

可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

3、可转债投资价值风险

本次发行可转债存续期限较长，而影响本次可转债投资价值的市场利率高低与股票价格水平受到国际和国内政治经济形势、国民经济总体运行状况、国家货币政策等诸多不确定因素的影响。故在本次可转债存续期内，当上述因素发生不利变化时，可转债的价值可能会随之相应降低，进而使投资者遭受损失。

4、转股后公司每股收益和净资产收益率摊薄的风险

本次可转债发行后，如债券持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司股本和净资产将一定程度的增加，但本次募集资金从投入到产生收益需要一定的时间，故可能存在公司利润增长幅度小于总股本及净资产增加幅度的情况。本次发行募集资金到位后，公司存在每股收益及净资产收益率下降的风险。

5、可转债转股价格未能向下修正以及修正幅度不确定的风险

公司在本次可转债发行中已设置可转债转股价格向下修正的条款，但未来在触发转股价格修正条款时，公司董事会可能基于市场因素、公司业务发展情况以及财务状况等多重因素考虑，不提出转股价格向下修正方案，或董事会虽提出转股价格向下修正方案但方案未能通过股东大会表决进而未能实施。若发生上述情况，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款无法实施的风险。

此外，若公司董事会提出转股价格向下修正方案并获股东大会通过，但修正方案中转股价格向下修正幅度存在不确定，公司之后股票价格仍有可能低于修正后的转股价格。上述情况的发生仍可能导致投资者持有本可转换公司债券不能实施转股的风险。

6、资信风险

公司本次发行的可转换公司债券已经中证鹏元评级，其中汇成股份主体信用等级为 AA-，本次可转换公司债券信用等级为 AA-，评级展望稳定。在本期债券存续期内，如果公司所处经营环境或自身的经营状况发生重大不利变化，有可能

会导致发行人的资信评级与本次债券评级状况出现不利变化，进而使本期债券投资者的利益受到不利影响。

7、未提供担保的风险

公司本次发行可转债，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转债存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而增加兑付风险。

第四节 发行人基本情况

一、本次发行前的股本总额及前十名股东的持股情况

（一）股本结构

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 83,485.3281 万股，具体情况如下：

序号	股东性质	持股数量（万股）	占公司总股本比例
1	有限售条件股份	37,847.87	45.33%
2	其中：国有法人持股	222.50	0.27%
3	境内非国有法人持股	29,577.64	35.43%
4	境内自然人持股	3,026.06	3.62%
5	境外法人持股	5,021.67	6.02%
6	境外自然人持股	-	-
7	无限售条件流通股份	45,637.46	54.67%
合计		**83,485.33**	**100.00%**

（二）前十名股东的持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（万股）
1	扬州新瑞连	境内非国有法人	17,410.36	20.85	17,410.36
2	嘉兴高和	境内非国有法人	6,000.00	7.19	-
3	汇成投资	境外法人	3,771.67	4.52	3,771.67
4	志道投资	境内非国有法人	2,430.00	2.91	-
5	杨会	境内自然人	2,359.39	2.83	2,359.39
6	Advance	境外法人	2,000.00	2.40	-
7	四川鼎祥股权投资基金有限公司	境内非国有法人	1,818.18	2.18	1,818.18
8	蔚华电子	境内非国有法人	1,600.00	1.92	-
9	安徽正奇资产管理有限公司	境内非国有法人	1,570.00	1.88	-
10	Great Title	境外法人	1,515.39	1.82	-

序号	股东名称	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（万股）
合计			**40,474.99**	**48.48**	**25,359.60**

二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的研究与应用，深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业中具有领先地位。截至 2024 年 5 月 13 日，公司共拥有国内专利 442 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 409 项。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过光刻与电镀环节在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，实现了封装领域“以点代线”的技术跨越，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势，在行业中处于领先地位。

（二）公司保持科技创新能力的机制或措施

公司自成立以来，高度重视技术创新工作，经过多年的实践与积累，已建立了一套以自身研发实力为基础、以客户市场需求为导向、以高端人才为核心的技术创新机制，为公司的技术进步和工艺水平提升提供了制度保障。

1、创新激励机制

公司对各部门研发技术人员和生产管理人员等员工采取必要的激励制度和

措施，一方面对于研发人员的薪酬设置为工资薪金加项目提成的方式以激励员工创新，另一方面设立科技成果奖，实行分级管理、分级奖励的原则，积极引导员工在研发上紧跟技术发展趋势、贴近市场需求，提高研发的成功率和市场效益，从而对研发创新形成了有效的激励机制。

2、技术交流培训

公司鼓励并积极组织研发技术人员参与各类技术培训活动、学术交流活动等，促使研发技术人员对行业技术发展趋势有更加深入的了解，通过集体学习提升自身技术水平与行业需求相适应，并保障研发技术人员在技术职务领域具有畅通的晋升渠道和广阔的发展空间。

3、创新战略规划

一方面，公司积极培养年轻技术人员，在日常的研发活动中，资历较深的技术人员会负责带教后辈，丰富的技术储备为持续的自主研发创新打下坚实的基础；另一方面，公司加大产品技术方面的人才引进，改善研发队伍人才结构，致力于提升研发成果的质量。

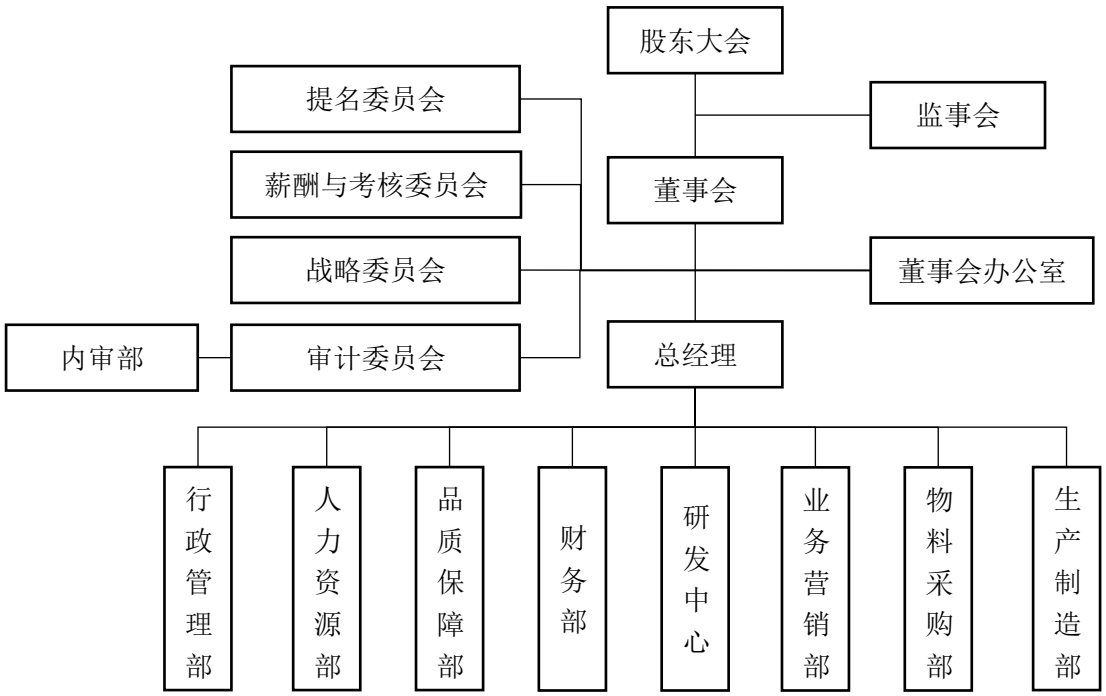
4、技术储备

公司根据行业发展的趋势和下游客户的需求，围绕现有产品和技术成果，在现有产品结构设计、工艺优化以及新产品开发等方面不断创新，从而使公司现有产品技术水平保持行业领先地位并拓展新的应用领域和产品类型。

三、公司组织结构及主要对外投资情况

（一）公司组织结构图

截至本募集说明书签署日，公司的组织结构图如下：



（二）子公司情况

截至本募集说明书签署日，公司有一家全资子公司江苏汇成。全资子公司江苏汇成具体情况如下：

公司名称	江苏汇成光电有限公司
统一社会信用代码	91321000581042566E
成立日期	2011 年 8 月 29 日
注册资本	56,164.02 万元
实收资本	56,164.02 万元
注册地址	扬州高新区金荣路 19 号
主要生产经营地	扬州高新区金荣路 19 号
法定代表人	郑瑞俊
股东构成	汇成股份持有 100%股权
经营范围	半导体（硅片及化合物半导体）集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试，销售本公司自产产品及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
主营业务	从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务

最近一年，江苏汇成的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.12.31/2023 年度
总资产	118,367.28
净资产	33,386.05
营业收入	27,997.36
净利润	-1,443.56

注：上表中 2023 年度财务数据已经天健会计师审计。

（三）参股公司情况

截至本募集说明书签署日，公司参股公司情况如下：

序号	参股公司	注册资本（万元）	关联关系
1	晶汇聚芯	35,200.00	发行人持有 14.20%的财产份额
2	晶合汇信	1,000.00	发行人持有 13.00%的财产份额

四、公司控股股东、实际控制人基本情况

（一）控股股东

截至 2023 年 12 月 31 日，扬州新瑞连持有发行人 20.85%的股份，系发行人控股股东，扬州新瑞连具体情况如下：

企业名称	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014 年 5 月 13 日
认缴出资额	50 万元
实缴出资额	50 万元
注册地址	扬州高新技术产业开发区纵一路与横三路交界处管委会大楼内 12 楼 1202 室
执行事务合伙人	杨会
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询服务。
主营业务	投资管理
与发行人主营业务关系	无

截至 2023 年 12 月 31 日，扬州新瑞连的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨会	普通合伙人	35.00	70.00

2	纪念	有限合伙人	15.00	30.00
合计			**50.00**	**100.00**

最近一年，扬州新瑞连的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2023.12.31/2023 年度
总资产	39,687.88
净资产	51.54
营业收入	-
净利润	0.02

注：上表中财务数据未经审计。

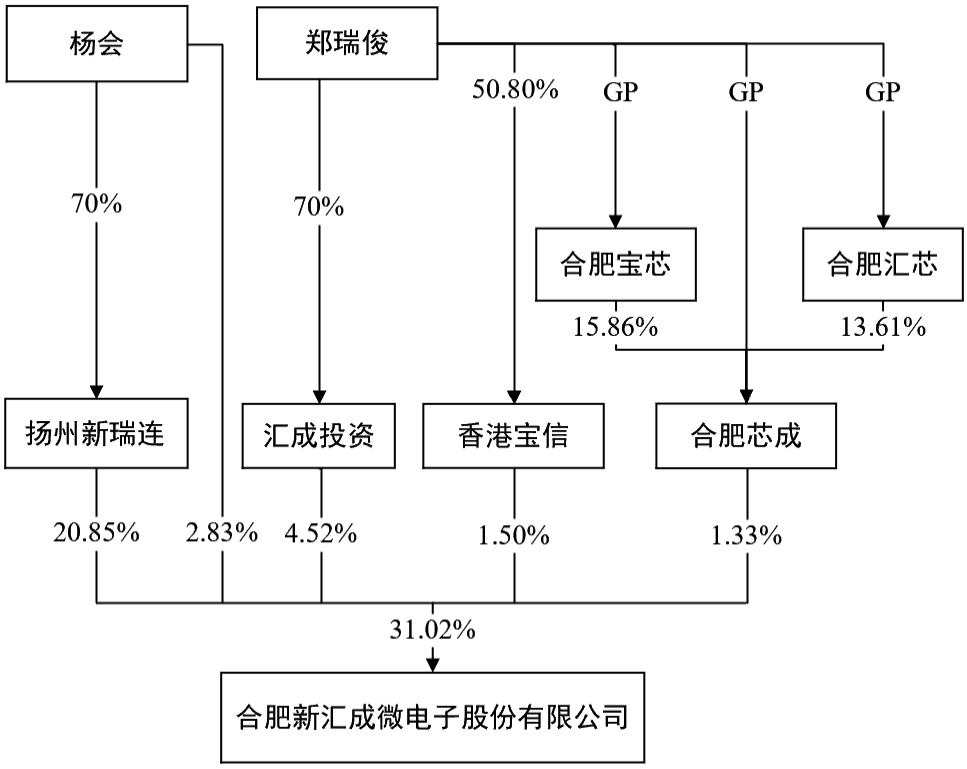
（二）实际控制人

郑瑞俊、杨会系夫妻关系。

截至 2023 年 12 月 31 日，郑瑞俊持有汇成投资 70%的股份，为汇成投资的实际控制人，并通过汇成投资间接控制发行人 4.52%的股份；郑瑞俊持有香港宝信 50.80%的股权，为香港宝信第一大股东，且香港宝信其他股东持股较为分散，故郑瑞俊为香港宝信的实际控制人，通过香港宝信间接控制发行人 1.50%的股份；郑瑞俊担任合肥芯成的执行事务合伙人，为合肥芯成的实际控制人，通过合肥芯成间接控制发行人 1.33%的股份。

截至 2023 年 12 月 31 日，杨会直接持有发行人 2.83%的股份；同时，杨会担任扬州新瑞连的执行事务合伙人，为扬州新瑞连的实际控制人，通过扬州新瑞连间接控制发行人 20.85%的股份。

郑瑞俊、杨会直接持有及间接控制发行人股份的情况具体如下图所示：



综上，郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 31.02%的股份表决权，同时郑瑞俊担任发行人董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响，郑瑞俊、杨会为公司共同实际控制人。

公司实际控制人的基本信息如下：

郑瑞俊先生，中国台湾人士，台湾居民来往大陆通行证号 0070****。

杨会女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 341127198205******。

（三）上市以来控股股东、实际控制人变化情况

公司自上市以来，控股股东、实际控制人均未发生变化。

（四）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份被质押、冻结或潜在纠纷的情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在被质押、冻结或潜在纠纷的情况。

（五）实际控制人对其他企业的投资情况

截至本募集说明书签署日，除公司及子公司、控股股东扬州新瑞连外，公司实际控制人郑瑞俊、杨会主要对外投资情况如下：

姓名	对外投资企业名称	出资比例/持股比例（%）
郑瑞俊	合肥芯成	37.91
	合肥宝芯	23.98
	合肥汇芯	22.52
	香港宝信	50.80
	汇成投资	70.00
	瑞成建筑	80.00
	瑞成投资	70.00
	百瑞发投资	50.96
	天虹科技	6.37
杨会	南京邦盛聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）	37.04
	苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙）	9.98
	苏州盛泽邦盛成果转化创业投资合伙企业（有限合伙）	3.77

五、报告期内相关主体所作出的重要承诺及承诺的履行情况

（一）本次发行前所作出的重要承诺及履行情况

本次发行前相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司 2023 年年度报告》之“第六节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。

（二）本次发行所作出的重要承诺及履行情况

1、应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺

本次发行相关主体所作出的应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺具体请见“重大事项提示”之“六、关于填补即期回报的措施和承诺”之“（二）应对本次发行摊薄即期回报的相关承诺”的内容。

2、公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员参与本次可转债认购的相关承诺

（1）控股股东扬州新瑞连承诺

本企业作为公司控股股东，就参与公司本次可转债认购事项承诺如下：

“1、如汇成股份启动本次可转债发行，本企业将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购汇成股份本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若汇成股份启动本次可转债发行之日与本企业最后一次减持汇成股份股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本企业将不参与认购汇成股份本次发行的可转债。

2、如届时本企业决定认购汇成股份本次发行的可转换公司债券的，本企业将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本企业成功认购取得汇成股份本次发行的可转债，本企业将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持汇成股份股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本企业将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺而减持汇成股份股票或可转债的，由此所得收益全部归汇成股份所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

5、若本次发行前，规范本企业买卖公司股票或可转换公司债券、短线交易等行为的法律、法规或规范性文件发生变更的，本企业将根据届时有效的法律、法规或规范性文件，重新出具对本次可转债发行认购的承诺函。”

（2）实际控制人郑瑞俊、杨会承诺

本人作为公司的实际控制人，就参与公司本次可转债认购事项及减持计划承诺如下：

“1、如汇成股份启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购汇成股份本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若汇成股份启动本次可转债发行之日与本人及本人的配偶、父母、子女最后一次减持汇成股份股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本人及本人的配偶、父母、子女将不参与认购汇成股份本次发行的可转债。

2、如届时本人决定认购汇成股份本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得汇成股份本次发行的可转债，本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持汇成股份股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本人将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持汇成股份股票或可转债的，由此所得收益全部归汇成股份所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

5、若本次发行前，规范本人买卖公司股票或可转换公司债券、短线交易等行为的法律、法规或规范性文件发生变更的，本人将根据届时有效的法律、法规或规范性文件，重新出具对本次可转债发行认购的承诺函。”

（3）其他非独立董事、监事、高级管理人员承诺

公司其他非独立董事、监事、高级管理人员将视情况参与本次可转债认购，并出具承诺：

“1、如汇成股份启动本次可转债发行，本人将按照《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定，根据本次可转债发行时的市场情况及资金安排决定是否参与认购汇成股份本次发行的可转债，并严格履行相应信息披露义务。若汇成股份启动本次可转债发行之日与本人及本人配偶、父母、子女最后一次减持汇成股份股票的日期间隔不满六个月（含六个月）的，本人及本人配偶、父母、子女将不参与认购汇成股份本次发行的可转债。

2、如届时本人决定认购汇成股份本次发行的可转换公司债券的，本人将以自有或自筹资金参与本次可转债认购；如届时本人成功认购取得汇成股份本次发行的可转债，本人承诺：本人及本人的配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，在本次发行的可转债认购后六个月内（含六个月）不减持汇成股份股票和本次发行的可转债，并遵守证监会和上海证券交易所的其他相关规定。

3、本人将严格遵守《证券法》关于买卖上市公司股票的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式）进行违反《证券法》第四十四条规定买卖公司股票或可转债的行为，不实施或变相实施短线交易等违法行为。

4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人或本人的配偶、父母、子女违反上述承诺而减持汇成股份股票或可转债的，由此所得收益全部归汇成股份所有，本人将依法承担由此产生的法律责任。

5、若本次发行前，规范本企业买卖公司股票或可转换公司债券、短线交易等行为的法律、法规或规范性文件发生变更的，本企业将根据届时有效的法律、法规或规范性文件，重新出具对本次可转债发行认购的承诺函。”

（4）独立董事承诺

公司独立董事就参与公司本次向不特定对象发行可转债认购事项及减持计划承诺如下：

“1、本承诺人及本承诺人配偶、父母、子女将不参与本次可转换公司债券发行认购，亦不会委托其他主体参与本次可转换公司债券发行认购。

2、本承诺人保证本承诺人配偶、父母、子女自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束，严格遵守短线交易的相关规定。

3、若本承诺人及本承诺人配偶、父母、子女违反上述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。”

本次发行相关主体严格履行上述承诺。

六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

截至 2024 年 5 月 13 日，发行人董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人；监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 人；高级管理人员 7 人；核心技术人员 4 人。具体情况如下：

1、董事情况

截至 2024 年 5 月 13 日，发行人董事的基本情况如下：

序号	姓名	现任职务	提名人	本届任职期间
1	郑瑞俊	董事长	扬州新瑞连	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
2	沈建纬	董事	扬州新瑞连	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
3	赵亚彬	董事	志道投资	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
4	吴海龙	董事	合肥创投	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
5	杨辉	独立董事	扬州新瑞连	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
6	程敏	独立董事	扬州新瑞连	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
7	蔺智挺	独立董事	扬州新瑞连	2021 年 6 月 30 日-2024 年 3 月 25 日

注：2024 年 5 月 15 日，公司召开 2023 年年度股东大会，进行董事会、监事会换届选举，同日召开第二届董事会第一次会议，聘任公司高管。上述事项完成后，洪伟刚、朱景懿新任董事，吴海龙、赵亚彬不再担任公司董事；罗昆新任独立董事，程敏不再担任公司独立董事；公司监事、高级管理人员未发生变化。

（1）郑瑞俊

郑瑞俊，男，1963 年 1 月出生，中国台湾人士，硕士学历。1994 年 7 月至今，历任瑞成建筑董事长、董事等职；2011 年 8 月至今，历任江苏汇成董事、董事长、执行董事、总经理等职；2016 年 6 月至 2020 年 9 月，任汇成有限董事长；2020 年 9 月至 2021 年 3 月，任汇成有限董事长、总经理；2021 年 3 月至今，

任汇成股份董事长、总经理。

（2）沈建纬

沈建纬，男，1959 年 4 月出生，中国台湾人士，高中学历。1987 年 11 月至 1993 年 5 月，任建纬机械有限公司总经理；1993 年 5 月至 1999 年 7 月，从事房产投资业务；1999 年 7 月至今，历任瑞成建筑总经理、副董事长、董事长等职；2011 年 8 月至 2020 年 8 月，任江苏汇成董事；2016 年 6 月至 2021 年 3 月，任汇成有限董事；2021 年 3 月至今，任汇成股份董事。

（3）赵亚彬

赵亚彬，男，1967 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988 年 7 月至 1994 年 7 月，任中国银行安徽省分行国际业务部职员；1994 年 7 月至 1997 年 9 月，任安徽省化工轻工总公司职员；1997 年 9 月至 2004 年 7 月，任安徽省华物期货经纪有限责任公司部门经理；2004 年 7 月至 2009 年 10 月，任合肥信息投资有限公司副总经理；2009 年 10 月至 2013 年 3 月，任安徽新华长江投资有限公司副总经理；2013 年 4 月至今，历任正奇控股投资总监、副总裁；2021 年 3 月至今，任汇成股份董事。

（4）吴海龙

吴海龙，男，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，美国特许金融分析师（CFA），金融风险管理师。2013 年 5 月至 2014 年 6 月，任东方金诚国际信用评估有限公司安徽分公司分析师；2014 年 6 月至 2015 年 3 月，任合肥市国有资产控股有限公司投资部助理业务员；2015 年 3 月至 2019 年 11 月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司基金部投资经理、高级投资经理、副总经理（主持工作）；2019 年 12 月至 2022 年 2 月，任合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理；2022 年 2 月至 2022 年 12 月，任合肥产投资本创业投资管理有限公司副总经理；2023 年 1 月至今任科大硅谷服务平台（安徽）有限公司董事长、总经理；2021 年 3 月至今，任汇成股份董事。

（5）杨辉

杨辉，男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。

1987 年 7 月至 1999 年 12 月，任合肥经济技术学院教师；1999 年 12 月至今，历任中国科学技术大学管理学院副教授、法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授；2021 年 3 月至今，任汇成股份独立董事。

（6）程敏

程敏，女，1966 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 7 月至 2000 年 7 月，任安徽省财政学校教师；2000 年 7 月至今，任安徽大学会计系副教授；2021 年 3 月至今，任汇成股份独立董事。

（7）蔺智挺

蔺智挺，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009 年 3 月至 2011 年 9 月，任中国科学技术大学计算机科学与技术系博士后；2011 年 10 月至今，历任安徽大学讲师、副教授、教授；2021 年 6 月至今，任汇成股份独立董事。

2、监事情况

截至 2024 年 5 月 13 日，发行人监事的基本情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	本届任职期间
1	郭小鹏	监事会主席	公司监事会	2023 年 11 月 20 日-2024 年 3 月 25 日
2	程红艳	职工代表监事	职工代表大会	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
3	陈殊凡	监事	扬州新瑞连	2023 年 5 月 11 日-2024 年 3 月 25 日

（1）郭小鹏

郭小鹏，男，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007 年至 2008 年任 IBMGBS 咨询顾问；2008 年至 2014 年任职于江苏高科技投资集团有限公司，历任投资经理助理、投资经理、部门副总经理（主持工作）；2014 年 3 月至今任南京邦盛投资管理有限公司董事及副总经理、江苏邦盛股权投资基金管理有限公司监事；2015 年 4 月至今任江苏沿海创新资本管理有限公司副总经理及合伙人；2023 年 11 月至今，任汇成股份监事会主席。

（2）程红艳

程红艳，女，1983 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006 年 4 月至 2015 年 2 月，任合肥金屯旅游服务有限公司主管；2015 年 6 月至 2016 年 6 月，任合肥洁家卫生材料有限公司主管；2016 年 7 月至 2017 年 7 月，任合肥通升捷电子有限公司人事行政科长；2017 年 9 月至 2021 年 3 月，任汇成有限行政管理部专案专员；2021 年 3 月至今，任汇成股份职工代表监事、行政管理部专案专员。

（3）陈殊凡

陈殊凡，男，1981 年 8 月出生，中国台湾人士，本科学历。2007 年 5 月至今，任瑞成建筑工程（安徽）有限公司稽核部长兼总经理秘书；2023 年 5 月至今，任汇成股份监事。

3、高级管理人员情况

截至 2024 年 5 月 13 日，发行人高级管理人员的基本情况如下：

序号	姓名	职位	本届任职期间
1	郑瑞俊	总经理	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
2	林文浩	副总经理	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
3	钟玉玄	副总经理	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
4	马行天	副总经理	2021 年 3 月 26 日-2024 年 3 月 25 日
5	黄振芳	副总经理	2023 年 5 月 29 日-2024 年 3 月 25 日
6	奚勰	董事会秘书	2023 年 4 月 20 日-2024 年 3 月 25 日
7	闫柳	财务总监	2022 年 11 月 25 日-2024 年 3 月 25 日

（1）郑瑞俊

郑瑞俊，简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事情况”。

（2）林文浩

林文浩，男，1970 年 11 月出生，中国台湾人士，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 5 月，任华辰科技股份有限公司工程课课长；2003 年 5 月至 2005 年 9 月，任和舰科技（苏州）有限公司工程部经理；2005 年 9 月至 2009 年 8 月，任

颀中科技（苏州）有限公司工程部经理；2009 年 9 月至 2014 年 11 月，任昆山龙腾光电股份有限公司专案经理；2014 年 12 月至 2016 年 4 月，任苏州顺惠有色金属制品有限公司厂长；2016 年 4 月至 2016 年 8 月，任丽智电子（昆山）有限公司供应链处长；2016 年 9 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心主任；2021 年 3 月至今，任汇成股份副总经理、研发中心主任。

（3）钟玉玄

钟玉玄，女，1963 年 3 月出生，中国台湾人士，专科学历。1990 年 2 月至 2003 年 3 月，任京元电子股份有限公司生产部经理；2003 年 3 月至 2006 年 9 月，任华阳电子股份有限公司协理；2006 年 9 月至 2013 年 9 月，任颀邦科技股份有限公司生产部资深处长；2013 年 10 月至 2015 年 4 月，任江苏汇成生产制造部总监；2017 年 3 月至 2019 年 4 月，任江苏汇成生产制造部总监；2019 年 4 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心副主任；2021 年 3 月至今，任汇成股份副总经理、生产制造部总监、研发中心副主任。

（4）马行天

马行天，男，1966 年 5 月出生，中国台湾人士，本科学历。1989 年 12 月至 1991 年 9 月，任联华电子股份有限公司高级工程师；1991 年 10 月至 1997 年 8 月，任旺宏电子股份有限公司项目经理；1997 年 9 月至 2011 年 11 月，任联华电子股份有限公司亚太业务处副处长；2011 年 12 月至 2012 年 8 月，任联华骐商贸（北京）有限责任公司总经理；2012 年 9 月至 2013 年 7 月，任智原科技股份有限公司业务支援总监；2014 年 1 月至 2014 年 8 月，任星展通有限公司负责人；2014 年 9 月至 2015 年 10 月，任联华电子股份有限公司亚太业务处处长；2015 年 11 月至 2017 年 9 月，任联暻半导体（山东）有限公司业务副总经理；2017 年 12 月至 2020 年 8 月，任九佳科技股份有限公司业务副总经理；2020 年 8 月至 2021 年 3 月，任汇成有限业务营销部总监；2021 年 3 月至今，任汇成股份副总经理。

（5）黄振芳

黄振芳，男，1964 年 9 月出生，中国台湾人士，硕士研究生学历，毕业于台湾清华大学科技管理学院。1989 年 9 月至 1997 年 7 月，先后任职于台湾华智

股份有限公司与茂硅电子股份有限公司担任工程师、副理；1997 年 8 月至 2021 年 2 月，任职于南茂科技股份有限公司，历任副理至副总经理；2021 年 2 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监；2021 年 3 月至 2023 年 5 月，任汇成股份生产制造部总监；2023 年 5 月至今，任汇成股份副总经理。

（6）奚勰

奚勰，男，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于上海交通大学高级金融学院，拥有法律职业资格、证券从业资格。2013 年 7 月至 2017 年 6 月，任上海市海华永泰律师事务所律师；2017 年 6 月至 2020 年 6 月，先后任职于德邦证券股份有限公司投资银行管理总部、第一创业证券承销保荐有限责任公司；2020 年 6 月至 2023 年 2 月，任海通证券股份有限公司投资银行总部高级副总裁；2023 年 2 月至 2023 年 4 月，任汇成股份总经理助理；2023 年 4 月至今，任汇成股份董事会秘书。

（7）闫柳

闫柳，女，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2008 年 7 月至 2010 年 5 月，就职于江南会计师事务所；2010 年 5 月至 2021 年 8 月，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、审计经理；2021 年 8 月至 2022 年 11 月，任汇成股份财务经理；2022 年 11 月至今，任汇成股份财务总监。

4、核心技术人员情况

截至本募集说明书签署日，公司核心技术人员的基本情况如下：

序号	姓名	职位
1	林文浩	副总经理、研发中心主任
2	钟玉玄	副总经理、生产制造部总监、研发中心副主任
3	许原诚	生产制造部总监、研发中心总监
4	陈汉宗	生产制造部总监、研发中心总监

（1）林文浩

林文浩，简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”

之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员情况”。

（2）钟玉玄

钟玉玄，简历参见本节“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员情况”。

（3）许原诚

许原诚，男，1971 年 11 月出生，中国台湾人士，硕士学历。2000 年 5 月至 2002 年 5 月，任远东纺织化纤股份有限公司品保科长；2002 年 5 月至 2008 年 6 月，任米辑科技股份有限公司黄光科科长；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任飞信半导体股份有限公司黄光科副理；2010 年 10 月至 2015 年 4 月，任颀邦科技股份有限公司专案副理；2015 年 5 月至 2016 年 4 月，任职于联立（徐州）半导体有限公司；2016 年 6 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心总监；2021 年 3 月至今，任汇成股份生产制造部总监、研发中心总监。

（4）陈汉宗

陈汉宗，男，1971 年 12 月出生，中国台湾人士，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 6 月，任联华电子股份有限公司测试设备工程师；2003 年 6 月至 2011 年 10 月，任颀邦科技股份有限公司测试制造主任、产品工程主管；2012 年 5 月至 2017 年 2 月，任群雅电子股份有限公司产品主管、制造经理；2017 年 2 月至 2018 年 2 月，任立卫科技股份有限公司生产经理；2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任东莞矽德半导体有限公司研发副处长；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心总监；2021 年 3 月至今，任汇成股份生产制造部总监、研发中心总监。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至 2024 年 5 月 13 日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系情况如下：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
郑瑞俊	合肥芯成	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
	合肥宝芯	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
	合肥汇芯	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
	香港宝信	董事	发行人员工持股平台
	汇成投资	董事	实际控制人控制的企业
	瑞成建筑	董事	实际控制人控制的企业
	瑞成投资	董事	实际控制人控制的企业
	百瑞发投资	董事长	实际控制人控制的企业
	本溪瑞成房地产开发经营有限公司（注1）	副董事长	无其他关联关系
	海南巨东房地产开发有限公司（注2）	副董事长	
沈建纬	瑞成建筑	董事长、总经理	实际控制人控制的企业
赵亚彬	正奇控股	副总裁	报告期内曾间接持股 5%以上股东
	志道投资	董事兼总经理	报告期内曾持股 5%以上股东
	武汉正奇志道投资有限公司	执行董事兼总经理	报告期内曾持股 5%以上股东控制的企业
	安徽正奇资产管理有限公司	董事兼总经理	持股 5%以下股东
	合肥质然房地产开发有限公司	董事	无其他关联关系
	正奇（上海）股权投资管理有限公司	董事兼总经理	
	广东惠伦晶体科技股份有限公司	董事	
吴海龙	科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	董事长兼总经理	无其他关联关系
	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	董事	
	安徽易芯半导体有限公司	董事	
	合肥北航通航产业技术有限公司	董事	
	合肥工投智聚股权投资有限公司	执行董事兼总经理	
	合肥市科创集团有限公司	董事	
	合肥创投	董事	
	合肥市场景应用创新促进中心有限公司	董事长	
	合肥德丰杰雷名创业投资企业	法定代表人	
杨辉	国元农业保险股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
	安徽金田高新材料股份有限公司	独立董事	
	安徽九华山旅游发展股份有限公司	独立董事	

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
	合肥美亚光电技术股份有限公司	独立董事	
	合肥紫金钢管股份有限公司	独立董事	
	安徽海慧供应链科技有限公司	董事	
	怀化市物联民爆器材有限公司	董事	
	中国科学技术大学	公共事务学院副教授	
程敏	科大智能物联技术股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
	淮南万泰电子股份有限公司	独立董事	
	安徽商信政通信息技术股份有限公司	独立董事	
	安徽大学	会计系副教授	
蔺智挺	苏州麦种科技有限公司	总经理	无其他关联关系
	合肥存算体企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	
	晶合集成	独立董事	
	安徽大学	教授	
郭小鹏	南京邦盛投资管理有限公司	董事、副总经理	间接持有公司股份
	江苏邦盛股权投资基金管理有限公司	监事	间接持有公司股份
	上海天数智芯半导体有限公司	监事	无其他关联关系
	南京威派视半导体技术有限公司	监事	
	浩德科技股份有限公司	董事	
	成都万创科技股份有限公司	董事	
	南京博兰得电子科技有限公司	董事	
	江苏华中气体有限公司	董事	
	南京典格通信科技有限公司	董事	
	上海携益信息技术有限公司（注3）	执行董事	
陈殊凡	瑞成建筑	稽核部长兼总经理秘书	实际控制人控制的企业

注 1：本溪瑞成房地产开发经营有限公司已于 2001 年 6 月因逾期未年检被吊销；
注 2：海南巨东房地产开发有限公司已于 1999 年 12 月因逾期未年检被吊销；
注 3：上海携益信息技术有限公司已于 2008 年 3 月被吊销。

截至 2024 年 5 月 13 日，除上表所列情况外，公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员无其他对外兼职。

（三）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员薪酬情况

2023 年度，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人领取薪酬

情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从发行人处领取的薪酬	是否在公司关联方处领取薪酬
郑瑞俊	董事长、总经理	143.02	否
沈建纬	董事	-	是
赵亚彬	董事	-	是
吴海龙	董事	-	是
杨辉	独立董事	4.80	否
程敏	独立董事	4.80	否
蔺智挺	独立董事	4.80	否
杨欢	监事会主席（已离任）	-	是
郭小鹏	监事会主席	-	是
赵志清	监事（已离任）	54.89	否
陈殊凡	监事	-	是
程红艳	职工代表监事	14.15	否
林文浩	副总经理、核心技术人员、研发中心主任	124.44	否
钟玉玄	副总经理、核心技术人员、生产制造部总监、研发中心副主任	101.50	否
马行天	副总经理	103.57	否
黄振芳	副总经理	100.41	否
奚勰	董事会秘书	46.01	否
闫柳	财务总监	45.44	否
许原诚	核心技术人员、生产制造部总监、研发中心总监	57.57	否
陈汉宗	核心技术人员、生产制造部总监、研发中心总监	52.16	否
合计		**857.55**	**-**

注 1：上述薪酬包括基本工资、奖金等，为税前薪酬；

注 2：截至本募集说明书签署日，赵志清、杨欢不再担任监事。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有发行人股份情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有的公司股份情况如下：

1、直接持股

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人不存在直接持有发行人股份情况。

2、间接持股情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员间接持有发行人股份情况如下：

姓名	职务	间接持股主体	持股数量（万股）	持股比例	近三年持股数是否发生变化
郑瑞俊	董事长、总经理	通过持有汇成投资的股权，间接持有公司股份 通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份 通过持有合肥宝芯和合肥汇芯的财产份额，间接持有合肥芯成的财产份额，同时直接持有合肥芯成的财产份额，从而间接持有公司股份 通过持有汇成股份专项资管计划的财产份额，从而间接持有公司股权	3,996.16	4.79%	是
赵亚彬	董事	通过持有天津德善信息咨询服务合伙企业的财产份额，间接持有正奇控股股份有限公司的股份，从而间接持有志道投资和安徽正奇资产管理有限公司的股权，进而间接持有公司股份	9.21	0.01%	是
赵志清	监事（已离任）	通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份	60.00	0.07%	是
郭小鹏	监事	通过南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙）、南京邦盛聚沣创业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份	5.78	0.01%	是
程红艳	职工代表监事	通过持有合肥汇芯的财产份额，间接持有合肥芯成的财产份额，从而间接持有公司股份	4.00	0.00%	是
林文浩	副总经理、核心技术人员、研发中心主任	通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份 通过持有汇成股份专项资管计划的财产份额，从而间接持有公司股份	256.09	0.31%	是
钟玉玄	副总经理、核心技术人员、生产制造部总监、研发中心副主任	通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份	100.00	0.12%	是
马行天	副总经理	通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份	50.00	0.06%	是

施周峰	财务总监（已离职）、董事会秘书（已离职）	通过持有合肥芯成的财产份额，从而间接持有公司股份	100.01	0.12%	是
许原诚	核心技术人员、生产制造部总监、研发中心总监	通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份	30.00	0.04%	是
陈汉宗	核心技术人员、生产制造部总监、研发中心总监	通过持有香港宝信的股权，间接持有公司股份	20.00	0.02%	是
合计			**4,631.26**	**5.55%**	**-**

注 1：截至本募集说明书签署日，施周峰已离职，赵志清不再担任监事。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近三年内的变动情况

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近三年内的变动情况如下：

1、发行人董事最近三年的变动情况

变动时间	原董事	变更后董事	变动原因
2021年3月	郑瑞俊、沈建纬、袁飞、郭小鹏、赵亚彬	郑瑞俊、沈建纬、赵亚彬、吴海龙、杨辉、程敏、TIEER GU（顾铁）	汇成有限整体变更为股份有限公司，发行人召开创立大会暨首次股东大会选举郑瑞俊、沈建纬、赵亚彬、吴海龙、杨辉、程敏、TIEER GU（顾铁）为发行人第一届董事会成员，其中杨辉、程敏、TIEER GU（顾铁）系独立董事
2021年6月	郑瑞俊、沈建纬、赵亚彬、吴海龙、杨辉、程敏、TIEER GU（顾铁）	郑瑞俊、沈建纬、赵亚彬、吴海龙、杨辉、程敏、蔺智挺	TIEER GU（顾铁）因精力有限向发行人辞任董事职务，发行人召开2020年年度股东大会选举蔺智挺为公司第一届董事会独立董事

2、发行人监事最近三年的变动情况

变动时间	原监事	变更后监事	变动原因
2021年3月	杨毅梅	杨欢、赵志清、程红艳	汇成有限整体变更为股份有限公司，发行人召开创立大会暨首次股东大会选举杨欢、赵志清为监事，与职工代表大会选举的职

			工代表监事程红艳组成公司第一届监事会监事
2023年5月	杨欢、赵志清、程红艳	杨欢、程红艳、陈殊凡	赵志清因工作变动原因辞任监事职务，仍在公司担任其他职务，发行人召开2022年年度股东大会选举陈殊凡为公司第一届监事会非职工代表监事
2023年11月	杨欢、程红艳、陈殊凡	郭小鹏、程红艳、陈殊凡	杨欢因工作安排调整辞去公司监事会主席、非职工代表监事职务，发行人召开2023年第三次临时股东大会选举郭小鹏为公司第一届监事会非职工代表监事

3、发行人高级管理人员最近三年的变动情况

变动时间	原高级管理人员	变更后高级管理人员	变动原因
2021年3月	郑瑞俊、施周峰	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、施周峰	汇成有限整体变更为股份有限公司，发行人召开第一届董事会第一次会议聘任郑瑞俊为发行人总经理，林文浩、钟玉玄、马行天为副总经理，施周峰为财务总监兼董事会秘书
2022年11月	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、施周峰	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、闫柳	施周峰因个人原因从公司离职并辞去财务总监兼董事会秘书职务，发行人召开第一届董事会第十二次会议聘任闫柳为发行人财务总监
2023年4月	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、闫柳	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、奚勰、闫柳	发行人召开第一届董事会第十四次会议聘任奚勰为发行人董事会秘书
2023年5月	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、奚勰、闫柳	郑瑞俊、林文浩、钟玉玄、马行天、黄振芳、奚勰、闫柳	发行人召开第一届董事会第十六次会议聘任黄振芳为发行人副总经理

注：公司副总经理林文浩于2022年11月至2023年2月代行公司董事会秘书的职责；2023年2月至2023年10月公司董事长郑瑞俊代行公司董事会秘书的职责；2023年10月起奚勰正式履行公司董事会秘书职责。

4、发行人核心技术人员最近三年的变动情况

最近三年，发行人的核心技术人员为林文浩、钟玉玄、许原诚、陈汉宗，上述人员未发生变动。

（六）公司对董事、高级管理人员及其他员工的激励情况

公司采用员工持股平台和限制性股票方式对高级管理人员和重要员工等进行股权激励，充分调动员工的积极性和创造性，建立健全公司长效激励机制，同时肯定员工对公司做出的贡献，与员工分享公司的经营成果，提升团队凝聚力，有利于稳定重要员工和持续改善公司的经营状况。

1、股权激励平台情况

截至本募集说明书签署日，合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯、香港宝信均系主要由发行人员工持股，以持有发行人股份为目的设立的持股平台，具体情况如下：

（1）合肥芯成

企业名称	合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310120MA1HT4JD0Y
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2019 年 7 月 23 日
认缴出资总额	500.00 万元
执行事务合伙人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢 3 层 503 室
经营范围	企业管理咨询
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本募集说明书签署日，合肥芯成共有 45 名合伙人，公司实际控制人郑瑞俊担任普通合伙人，44 名有限合伙人中合肥宝芯、合肥汇芯为员工持股平台，其余 42 名为公司激励对象，具体情况如下：

序号	合伙人	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）	职务/人员类别
1	郑瑞俊	普通合伙人	189.55	37.91	董事长、总经理
2	合肥宝芯	有限合伙人	79.30	15.86	员工持股平台
3	合肥汇芯	有限合伙人	68.04	13.61	员工持股平台
4	施周峰	有限合伙人	45.06	9.01	财务总监（已离职）、董事会秘书（已离职）

序号	合伙人	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）	职务/人员类别
5	其他激励对象 41 名	有限合伙人	118.05	23.61	-
合计	**共计 45 名**	**-**	**500.00**	**100.00**	**-**

（2）合肥宝芯

在合肥芯成合伙人中，合肥宝芯持有其 79.30 万元出资额，占合肥芯成出资总额的 15.86%。合肥宝芯的基本情况如下：

企业名称	合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2WGBFK6U
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020 年 12 月 3 日
认缴出资总额	1.00 万元
执行事务合伙人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢
经营范围	企业管理咨询
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本募集说明书签署日，合肥宝芯共有 27 名合伙人，公司实际控制人郑瑞俊担任普通合伙人，其余 26 名有限合伙人均为公司激励对象，具体情况如下：

序号	合伙人	合伙人性质	出资额（元）	出资比例（%）	职务/人员类别
1	郑瑞俊	普通合伙人	2,397.71	23.98	董事长、总经理
2	其他激励对象 26 名	有限合伙人	7,602.29	76.02	-
合计	**共计 27 名**	**-**	**10,000.00**	**100.00**	**-**

（3）合肥汇芯

在合肥芯成合伙人中，合肥汇芯持有其 68.04 万元出资额，占合肥芯成出资总额的 13.61%。合肥汇芯的基本情况如下：

企业名称	合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2WGB9Y2Q
企业类型	有限合伙企业

成立时间	2020 年 12 月 3 日
认缴出资总额	1.00 万元
执行事务合伙人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢
经营范围	企业管理咨询
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本募集说明书签署日，合肥汇芯共有 38 名合伙人，公司实际控制人郑瑞俊担任普通合伙人，其余 37 名有限合伙人均为公司激励对象，具体情况如下：

序号	合伙人	合伙人性质	出资额（元）	出资比例（%）	职务/人员类别
1	郑瑞俊	普通合伙人	2,251.56	22.52	董事长、总经理
2	其他激励对象 37 名	有限合伙人	7,748.44	77.48	-
合计	**共计 38 名**	**-**	**10,000.00**	**100.00**	**-**

合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯均为发行人员工持股平台，仅以其自有资金认购发行人股份，不开展除投资发行人以外的其他任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募投资基金产品或私募投资基金管理人，无需履行基金管理人登记或基金备案程序。

（4）香港宝信

公司名称	宝信国际投资有限公司
公司编号	2261496
公司类型	有限公司
成立日期	2015 年 7 月 10 日
发行股本	3,524.34 万股（每股面值 1 港币）
董事	郑瑞俊
注册地址	Room 1002, 10/F, Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本募集说明书签署日，香港宝信的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	职务/人员类别
1	郑瑞俊	1,790.37	50.80	董事长、总经理
2	钟玉玄	281.95	8.00	副总经理、生产制造部总监、研发中心副主任
3	赵志清	169.17	4.80	业务营销部总监
4	林文浩	169.17	4.80	副总经理、研发中心主任
5	马行天	140.97	4.00	副总经理
6	许原诚	84.58	2.40	生产制造部总监、研发中心总监
7	陈汉宗	56.39	1.60	生产制造部总监、研发中心总监
8	其他激励对象 14 名	831.74	23.60	-
合计	**共计 21 名**	**3,524.34**	**100.00**	**-**

香港宝信为发行人员工持股平台，香港宝信仅以其自有资金认购发行人股份，不开展除投资发行人以外的其他任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募投资基金产品或私募投资基金管理人，无需履行基金管理人登记或基金备案程序。

2、限制性股票激励计划情况

2023 年 5 月 29 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》等相关议案。2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。

2023 年 6 月 16 日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（1）股权激励计划的来源

本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。

（2）授予限制性股票的数量

本激励计划拟向激励对象授予 1,100.00 万股限制性股票，占本激励计划草案公告日公司股本总额83,485.33万股的1.32%。其中，首次授予限制性股票1,046.00万股，占本激励计划草案公布日公司股本总额 83,485.33 万股的 1.25%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 95.09%；预留 54.00 万股，占本激励计划草案公布日公司股本总额 83,485.33 万股的 0.06%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 4.91%。

截至激励计划草案公告日，公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票，累计不超过本激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1%。

在激励计划公告日至激励对象获授限制性股票前，以及激励对象获授限制性股票后至归属前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予数量进行相应的调整。

3、激励对象获授的限制性股票分配情况

报告期内，本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

姓名	国籍/地区	职务	获授限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数比例	占本激励计划公告日股本总额比例
一、高级管理人员、核心技术人员（9 人）					
郑瑞俊	中国台湾	董事长、总经理	280.00	25.4545%	0.3354%
林文浩	中国台湾	副总经理、核心技术人员	70.00	6.3636%	0.0838%
钟玉玄	中国台湾	副总经理、核心技术人员	30.00	2.7273%	0.0359%
马行天	中国台湾	副总经理	30.00	2.7273%	0.0359%
黄振芳	中国台湾	副总经理	100.00	9.0909%	0.1198%

奚勰	中国	董事会秘书	50.00	4.5455%	0.0599%
闫柳	中国	财务总监	25.00	2.2727%	0.0299%
许原诚	中国台湾	核心技术人员	15.00	1.3636%	0.0180%
陈汉宗	中国台湾	核心技术人员	15.00	1.3636%	0.0180%
二、核心骨干人员（57 人）					
核心管理、技术、业务骨干人员			431.00	39.1818%	0.5163%
首次授予合计（66 人）			**1,046.00**	**95.0909%**	**1.2529%**
三、预留部分			54.00	4.9091%	0.0647%
合计			**1,100.00**	**100.00%**	**1.3176%**

注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%，公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 20%；

注 2：本计划激励对象不包括独立董事、监事；

注 3：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息；

注 4：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

七、公司所处行业基本情况

（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片。

根据《国民经济行业分类》（GB/4754-2017），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造业”；根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。

1、行业监管体制及主管部门

集成电路制造行业的管理体制是国家产业宏观调控下的市场调节机制，由国家主管部门制定行业发展战略、发展规划及产业政策，对行业进行宏观调控；行业协会对行业进行自律规范管理；企业则面向市场自主经营并自主承担市场风险。

集成电路制造行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，主要负责对行业的发展方向进行宏观调控，包括提出优化产业布局、结构的政策建议和发

展战略；制定并组织实施行业发展规划和产业政策；拟定行业技术标准，推动重大技术自主创新；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化，促进电子信息技术的推广应用。

集成电路制造行业的自律组织主要为中国半导体行业协会，负责行业的引导与服务，包括贯彻落实政府半导体相关产业政策、开展产业及市场研究，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场发展趋势、经济运行预测等信息，提供咨询服务、行业自律管理以及代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、最近三年监管政策的变化

集成电路制造行业是国民经济支柱性行业之一，是信息技术产业的重要组成部分，是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，属于国家高度重视和鼓励发展的行业，其发展程度是衡量一个国家科技发展水平的核心指标之一。近年来，国家相关部委及地方政府出台了一系列支持和引导集成电路制造行业发展的政策法规，主要情况如下：

序号	文件名称	主要涉及的内容	颁布机构	颁布时间
1	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SIP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）、2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试	发改委	2023 年 12 月
2	《关于进一步促进集成电路产业高质量发展的若干政策》	为进一步推动集成电路产业高质量发展，从提升产业创新能力、提升产业链整体水平、形成财税金融支持合力、增强产业人才支撑、优化发展环境等五个方面，最高支持 4000 万，支持集成电路产业发展。	江苏省人民政府	2023 年 1 月
3	《关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	为做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，将有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准进行规范。重点集成电路设计领域包括高性能处理器和 FPGA 芯片、智能传感器、工业、通信、汽车和安全芯片等。	发改委、工信部、财政部等	2022 年 3 月

4	《“十四五”数字经济发展规划》	瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路等战略性前瞻性领域，提高数字技术基础研发能力；提升产业链关键环节竞争力，完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系。	国务院	2021 年 12 月
5	《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件（2021 年本）》	对符合条件的封装、测试企业进行所得税优惠。	工信部、发改委、财政部、税务总局	2021 年 4 月
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	强化国家战略科技力量，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。	第十三届全国人大第四次会议	2021 年 3 月
7	《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》	对符合条件的集成电路相关企业免征进口关税；符合条件的承建集成电路重大项目的企业进口新设备，对未缴纳税款提供海关认可的税款担保，可六年内分期缴纳进口环节增值税。	财政部、海关总署、税务总局等	2021 年 3 月
8	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。	国务院	2020 年 7 月
9	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	为做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，公布了有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。	发改委、工信部、财政部等	2020 年 3 月
10	《战略性新兴产业分类（2018）》	集成电路的制造被列为战略新兴产业。	国家统计局	2018 年 11 月
11	《关于印发江苏省“产业强链”三年行动计划（2021－2023 年）的通知》	促进其中特高压设备、起重机、车联网、品牌服装、先进碳材料、生物医药、集成电路、高技术船舶、轨道交通装备、“大数据+”等 10 条产业链实现卓越提升。	江苏省政府办公厅	2020 年 12 月
12	《合肥市数字经济发展规划（2020-2025 年）》	以显示驱动、智能家电、汽车电子、功率集成电路、存储器等芯片为切入点，通过应用牵引搭建产业合作平台、公共服务平台，瞄准先进工艺，积极联合行业领军企业建设高水平集成电路芯片生产线和先进封装测试生产线。	合肥市政府办公室	2020 年 5 月

（二）行业近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

1、集成电路封装测试行业发展情况

（1）集成电路封装测试行业的基本情况

集成电路制造产业链主要包括芯片设计、晶圆制造、封装测试三个子行业，

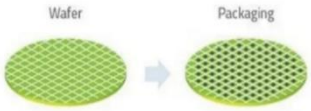
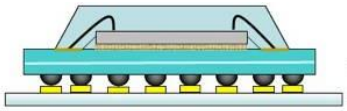
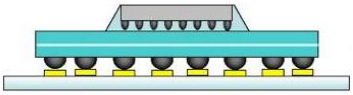
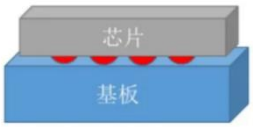
封装测试行业位于产业链的中下游，该业务实质上包括了封装和测试两个环节，但由于测试环节一般也主要由封装厂商完成，因而一般统称为封装测试业。

封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电子产品的过程，目的是保护芯片免受损伤，保证芯片的散热性能，以及实现电信号的传输。经过封装的芯片可以在更高的温度环境下工作，抵御物理损害与化学腐蚀，带来更佳的性能表现与耐用度，同时也更便于运输和安装。测试则包括进入封装前的晶圆测试以及封装完成后的成品测试，晶圆测试主要检验的是每个晶粒的电性，成品测试主要检验的是产品电性和功能，目的是在于将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的芯片筛选出来，是节约成本、验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

封装测试业是我国集成电路行业中发展最为成熟的细分行业，在世界上拥有较强竞争力，全球的封装测试产业正在向中国大陆转移。根据中国半导体行业协会统计数据，目前国内的集成电路产业结构中芯片设计、晶圆制造、封装测试的销售规模大约呈 4：3：3 的比例，产业结构的均衡有利于形成集成电路行业的内循环，随着上游芯片设计产业的加快发展，也能够推进处于产业链下游的封装测试行业的发展。

封装技术历经较长的发展过程，形成了复杂多样的封装形式，其发展历史如下：

阶段	时间	封装技术	具体封装形式	图示
第一阶段（传统封装）	20 世纪 70 年代前	通孔插装型封装	晶体管封装（TO）、双列直插封装（DIP）、陶瓷双列直插封装（CDIP）、塑料双列直插封装（PDIP）、单列直插式封装（SIP）	
第二阶段（传统封装）	20 世纪 80 年代以后	表面贴装型封装	塑料有引线片式载体封装（PLCC）、四边引脚扁平封装（QFP）、塑料四边引线扁平封装（PQFP）、小外形表面封装（SOP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、小外形晶体管封装（SOT）、双边扁平无引脚封装（DFN）	

阶段	时间	封装技术	具体封装形式	图示
第三阶段（先进封装）	20 世纪 90 年代以后	面积阵列型封装	球栅阵列封装（BGA）、塑料焊球阵列封装（PBGA）、陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、带散热器焊球阵列封装（EBGA）、倒装芯片焊球阵列封装（FC-BGA）	
			晶圆级封装（WLP）	
			芯片级封装（CSP）	
第四阶段（先进封装）	20 世纪末开始	多芯组装（MCM）、系统级封装（SiP）、三维立体封装（3D）、凸块制造（Bumping）		 **以凸点（Bumping）为例**
第五阶段（先进封装）	21 世纪前 10 年开始	系统级单芯片封装（SoC）、微电子机械系统封装（MEMS）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、倒装封装（FC）、扇出型封装（Fan-out）		 **以倒装（FC）为例**

资料来源：《中国半导体封装业的发展》、Frost & Sullivan，海通证券整理

集成电路的封装形式多样复杂，基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，并结合行业内按照封装工艺分类的惯例，封装分为传统封装（第一阶段和第二阶段）及先进封装（第三至第五阶段），考虑到技术路径与指标的差异可将先进封装进一步细分，分为中端先进封装（第三阶段中大部分封装技术）与高端先进封装（第三阶段中少部分封装技术以及第四至第五阶段）。传统封装与先进封装的主要区别包括键合方式由传统的引线键合发展为球状凸点焊接，封装元件概念演变为封装系统，封装对象由单芯片向多芯片发展，由平面封装向立体封装发展。目前，全球封装行业的主流技术处于以 CSP、BGA 为主的第三阶段，并向以倒装封装（FC）、凸块制造（Bumping）、系统级封装（SiP）、系统级单芯片封装（SoC）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

（2）凸块制造（Bumping）在先进封测技术中的重要性

①凸块制造的概念

凸块制造是一种新型的芯片与基板间电气互联的方式，这种技术通过在晶圆上制作金属凸块实现。具体工艺流程为：晶圆在晶圆代工厂完成基体电路后，由封测代工厂在切割之前进行加工，利用薄膜制程、黄光、化学镀制程技术及电镀、印刷技术、蚀刻制程，在芯片的焊垫上制作金属焊球或凸块。

相比传统的打线技术向四周辐射的金属“线连接”，凸块制造技术反映了“以点代线”的发展趋势，可以大幅缩小芯片体积，具有密度大、低感应、低成本、散热能力优良等优点；且凸块阵列在芯片表面，引脚密度可以被做得极高，便于满足芯片性能提升的需求。此外，凸块的选材、构造、尺寸设计会受多种因素影响，例如封装大小、成本、散热等性能。

②凸块制造技术的起源

凸块制造技术起源于 20 世纪 60 年代。上世纪 60 年代，IBM 公司开发了倒装芯片技术，第一代倒装芯片为具有三个端口的晶体管产品。随着电子器件体积的不断减小以及 I/O 密度的不断增加，20 世纪 70 年代，IBM 公司将倒装芯片技术发展为应用在集成电路中的 C4 技术，C4 技术通过高铅含量的焊料凸块将芯片上的可润湿金属焊盘与基板上的焊盘相连，C4 焊球可以满足具有更细密焊盘的芯片的倒装焊要求。此后凸块制造技术进一步发展，利用熔融凸块表面张力以支撑晶片的重量及控制凸块的高度。

IBM 公司开发出的初代凸块制造技术奠定了凸块制造技术的底层工艺，并就该技术申请了发明专利。IBM 公司通过高铅焊料蒸镀工艺进行凸块加工，使用高温/低温共烧陶瓷载板（基板）进行互联，受该工艺方案限制，当时凸块间距较大（>250μm）、焊接温度过高（>300℃），且生产成本高居不下，极大限制了凸块制造技术的推广和应用。

③凸块制造技术的发展

随着集成电路行业的发展，新的凸块制造工艺打破了初代技术的困局，其发展阶段与集成电路行业的两次重大产业转移以及显示面板产业的发展密切相关。

集成电路行业的第一次产业转移在 1970-1980 年代由美国至日本：美国作为

集成电路的发源地，20 世纪 70 年代间，前 10 大集成电路制造商几乎均来自美国。日本在美国技术支持与本国政策与资金支持下，依托家电和工业级计算机产业繁荣发展实现反超，在 20 世纪 80 年代末，前 10 大集成电路制造商中有一半以上来自日本。与此同时，日本本土对面板智能化、轻薄化的需求增加，随之涌现大批日本封测技术厂商，凸块制造技术在这期间得到较大发展。

第二次集成电路行业产业转移在20世纪80年代-21世纪初，由日本至韩国、中国台湾：凭借低廉人工成本及大量高素质人才，韩国顺应消费级 PC 的趋势快速发展，而中国台湾在晶圆代工厂、芯片封测领域的垂直分工下出现市场机会，韩国与中国台湾迅速取代日本在集成电路产业大部分的市场份额。面板产业亦转移至韩国与中国台湾，凸块制造技术在产业化及转移的过程中随着终端应用的需求不断被优化，溅射凸块底部金属工艺和电镀凸块工艺取代了原先成本高昂的蒸镀技术方案，并将凸块间距缩小至 200μm 以下，原材料亦出现多元化，生产良率不断上升。

2010 年以来，全球集成电路产业与显示面板产业向中国大陆转移的趋势增强。随着集成电路晶圆制程技术从 2000 年左右的 300nm 发展到目前的 7nm，凸块间距也发展到 100μm 以下的极细间距领域，单芯片上的金属凸块超过 1,500 个，需要每个凸块都同基板上的线路形成良好电气接触，高密度细间距凸块布局对封测企业的凸块制造技术提出了极高要求。目前凸块制造技术底层工艺专利已成为公开技术，国内外同行业公司凸块制造技术均在原有凸块制造底层工艺上进行各个环节的技术创新，以达到终端应用发展的需求。

④凸块制造技术是先进封装技术发展与演变的重要基础

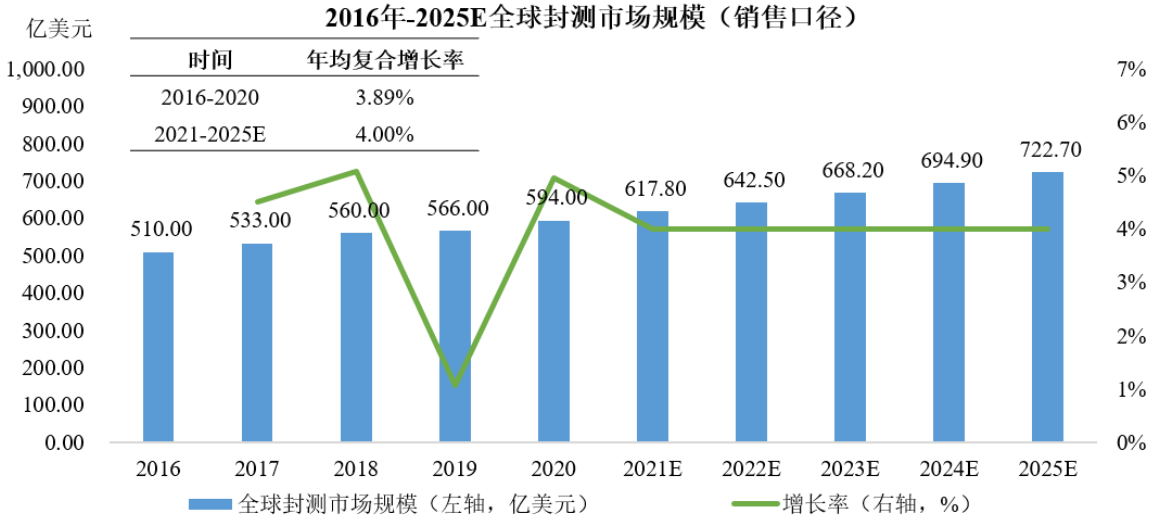
随着集成电路行业技术的进步与终端电子产品需求的提高，凸块制造技术也不断突破技术瓶颈、实现大规模产业化，并发展成为关键的高端先进封装技术之一。

凸块制造技术的重要性在于它是各类先进封装技术得以实现进一步发展演化的基础。倒装芯片（FC）技术、扇出型（Fan-out）封装技术、扇进型（Fan-in）封装技术、芯片级封装（CSP）、三维立体封装（3D）、系统级封装（SiP）等先进封装结构与工艺实现的关键技术均涉及凸块制造技术。硅通孔技术（TSV）、

晶圆级封装（WLP）、微电子机械系统封装（MEMS）等先进封装结构与工艺均是凸块制造技术的演化延伸。

（3）全球集成电路封装测试行业发展情况

全球封装测试市场行业销售额从 2016 年的 510.00 亿美元增长至 2020 年的 594.00 亿美元，保持着平稳增长；2020 年全球封测市场同比增速为 4.95%，高于 2019 年的 1.07%，主要由于以下几个原因：①全球由于贸易摩擦带来的芯片恐慌提高了芯片库存；②5G 的应用使得厂商加大了智能手机、电脑等的备货；③居家办公的政策刺激了电子产品的需求。



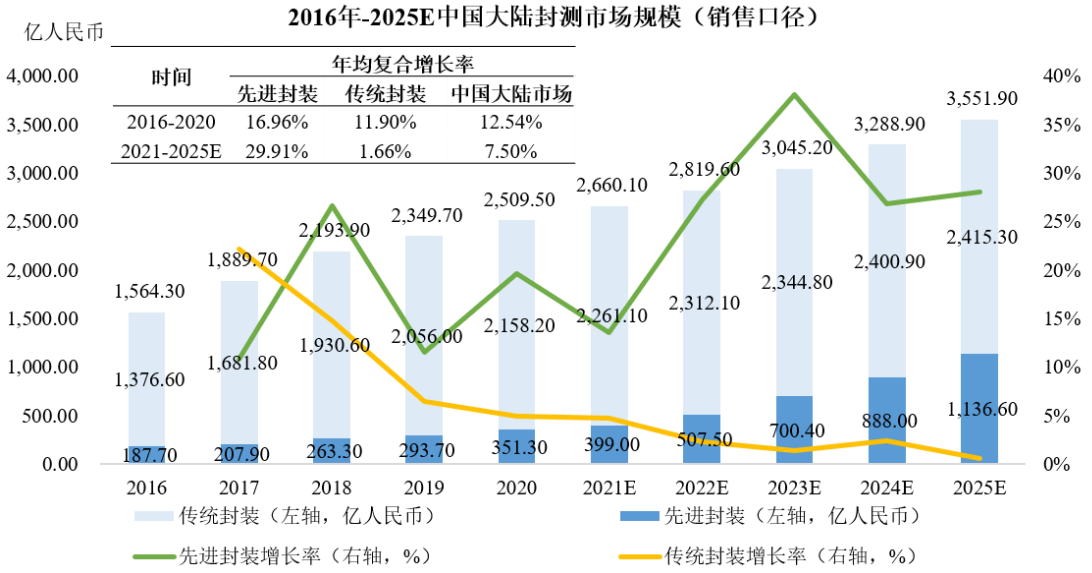
数据来源：Frost & Sullivan

未来，从供应端看，全球晶圆代工厂的持续扩产，将会有效缓解当前晶圆产能供不应求的状况。需求端来看，随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，封测行业也将受益，预计全球市场规模将在 2025 年达到 722.70 亿美元。同时，先进封装作为后摩尔时代的选择之一，将成为推动全球封测行业持续发展的新动力，预计将以 6.50%的年复合增长率快速增长，2025 年在全球封测市场约占一半份额。

（4）中国大陆集成电路封装测试行业发展情况

受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，境内封装测试市场跟随集成电路产业实现了高速发展。根据 Frost & Sullivan 数据，2016 年至 2020 年，中国大陆封测市场的年复合增长率为 12.54%，远高于全球封测市场 3.89%

的增长速度。从封测业务收入结构上来看，中国大陆封测市场依然主要以传统封装业务为主，但随着国内领先厂商不断通过海内外并购及研发投入，中国大陆先进封装业务有望快速发展。



数据来源：Frost & Sullivan

近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大，以及全球晶圆制造龙头企业也陆续在大陆建厂扩产，在此背景下，国内封装测试企业将会步入更为快速的发展阶段。同时，未来先进封装将为集成电路产业创造更多的价值，随着智能汽车、5G 手机等的先进封装需求增加，产能紧张，将会带动封测价格提升，国内提前布局先进封装业务的厂商将会受益。

根据 Frost & Sullivan 数据，中国大陆封测市场预计将保持增长，在 2025 年达到 3,551.90 亿元的市场规模，占全球封测市场比重约为 75.61%，其中先进封装将以 29.91%年复合增长率持续高速发展，在 2025 年占中国大陆封测市场比重将达到 32.00%。

（5）封装测试行业发展趋势分析

①后摩尔定律时代，先进封装成为行业主流

随着集成电路器件性能的要求不断提高，促进了如 Bumping、Flip Chip、WLCSP、2.5D、3D 等先进封装技术的快速发展。后摩尔定律时代，由于先进制

程的研发投入及难度不断提升，制程技术不能带来成本的有效降低，集成电路行业将更多依靠先进封装技术来实现硬件上的突破。先进封装在提升芯片性能方面具有巨大优势，可以在不依赖先进制程工艺前提下，提高芯片整体性能以及集成度，从而满足终端设备对于芯片体积、性能等不断提升的需求。

②产业链分工细化，专业封装测试企业市场地位稳固

随着产业规模的扩张、技术要求的提升，全球集成电路制造产业链分工进一步细化为 Fabless+Foundry+OSAT 的配合，每个环节的分工由此而明确。我国封装测试行业在全球产业链中占据重要地位，并且随着龙头企业的并购整合，市场份额将进一步扩大。另外，随着我国集成电路产业经历了低端制造承接、长期技术引进、高端人才培育等产业发展环节，我国集成电路产业结构逐步完善，形成了以芯片设计为龙头、封装测试为主体、晶圆制造重点统筹的产业布局。未来伴随中国大陆芯片设计业和晶圆制造业的逐步崛起，下游封装测试产业有望持续受益。

③产业政策扶持、集成电路产业重心转移带来进口替代巨大机遇

我国持续出台集成电路相关产业政策，将其列为国家重点战略产业，对集成电路企业在税收、人才、技术等多方面提供支持，在此政策红利下，我国集成电路企业逐渐转亏为盈并发展壮大，国际地位也有所提升。

目前，中国大陆拥有全球最大且增速最快的集成电路消费市场，集成电路产业发展重心正逐渐转移至中国大陆。巨大的下游市场配合积极的国家产业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多角度地支持集成电路行业发展。我国光伏、显示面板、LED 等高新技术行业经过多年发展已达到领先水平，也大力拉动了上游的功率半导体、显示驱动芯片、LED 驱动芯片等集成电路的国产化进程。随着集成电路产业链相关技术的不断突破，加之中国大陆在物联网、人工智能、新能源汽车等下游市场持续加大布局，中国大陆有望在集成电路封测等更多细分市场实现进口替代。

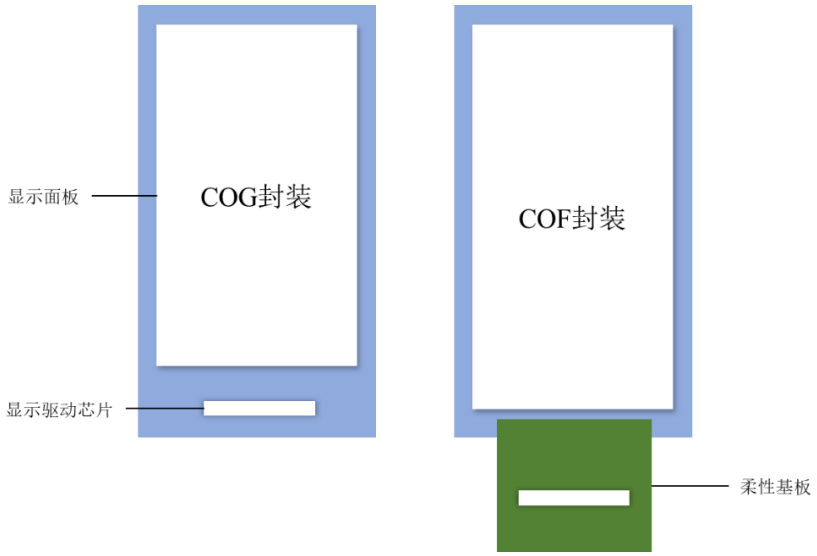
2、显示驱动芯片封装测试行业发展情况

（1）显示驱动芯片封装测试的基本情况

集成电路按照功能结构分类，可分为数字集成电路、模拟集成电路和数/模混合集成电路。数字集成电路的功能是运算、存储、传输及转换离散的数字信号；模拟集成电路的功能是处理光、声音、速度、温度等连续的自然模拟信号；数/模混合集成电路则兼具两者的功能。

显示驱动芯片属于数/模混合集成电路，其电信号经由芯片与基板的键合点、基板上的金属线路而到达被控制的像素点。随着对显示分辨率的要求越来越高，显示驱动芯片的 I/O 端口数越来越多，如此大规模的输入输出对芯片封装技术的要求很高，并且随着电子产品以轻薄短小为发展趋势，要求显示驱动芯片的体积进一步缩小，集成度进一步提高。

凸块制造工艺结合玻璃覆晶封装（COG）或薄膜覆晶封装（COF）凭借其多 I/O、高密度等特点，已经成为显示驱动芯片封装技术的主流，且其采用倒装芯片结构，无须焊线。玻璃覆晶封装主要用于小尺寸面板产品如手机、数码相机、平板电脑等，而薄膜覆晶封装将芯片封装在可弯曲的柔性基板上，故占用面积更小，主要应用于大尺寸面板产品如电视、电脑显示器等以及对边框要求更高的全面屏手机。



（2）显示驱动芯片封装测试行业的发展情况

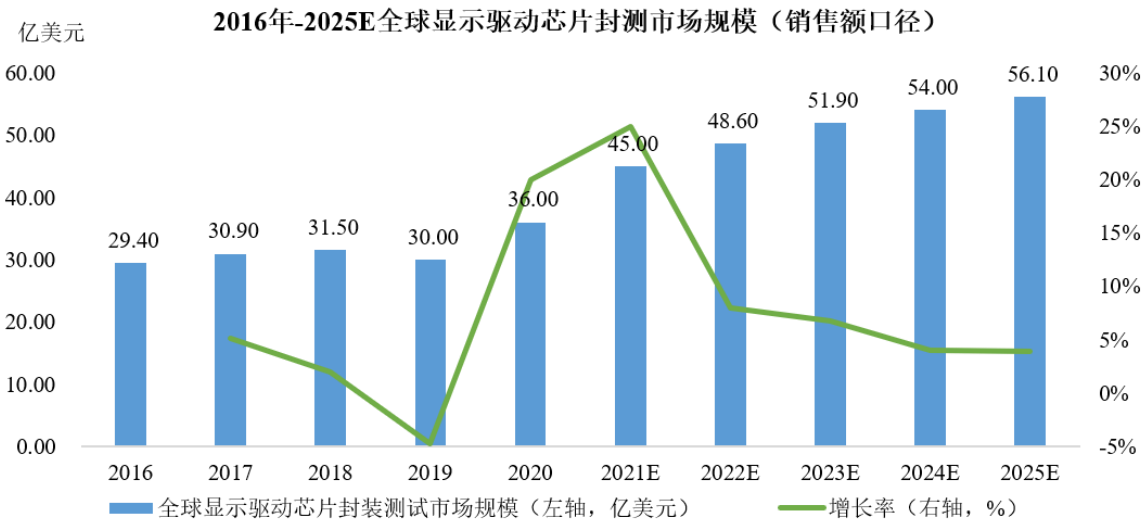
全球显示驱动芯片封测服务的产业格局中，中国台湾厂商占据主导地位，包括颀邦科技、南茂科技等。近些年，随着汇成股份等大陆厂商的崛起，中国大陆的市场份额有所提升。未来随着我国芯片设计的人才资源逐步丰富、晶圆制造业

的产能供给提升、封装测试技术的集成度进一步提高，预计 2025 年中国大陆的显示驱动芯片封测服务销售份额将进一步提升。

①全球显示驱动芯片封装测试行业市场发展情况

2015 年起，由于京东方等国内领先面板厂商突破显示面板核心技术，面板实现大宗商品化，整体面板及其零部件处于一个价格下行时期，因此该阶段显示驱动芯片封测市场规模没有显著增长。2020 年，由于晶圆代工厂产能紧张，整体芯片价格不断上涨，进一步带动了显示驱动芯片封测市场的增长，据 Frost & Sullivan 统计，全球显示驱动芯片封测市场规模于 2020 年达到 36.00 亿美元。

未来从需求端来看，依然将有新增的面板产能释放，对于显示驱动芯片的需求持续走高，进而推动显示驱动芯片封测市场的发展。据 Frost & Sullivan 预测，全球显示驱动芯片封测市场规模在 2025 年将达到 56.10 亿美元。



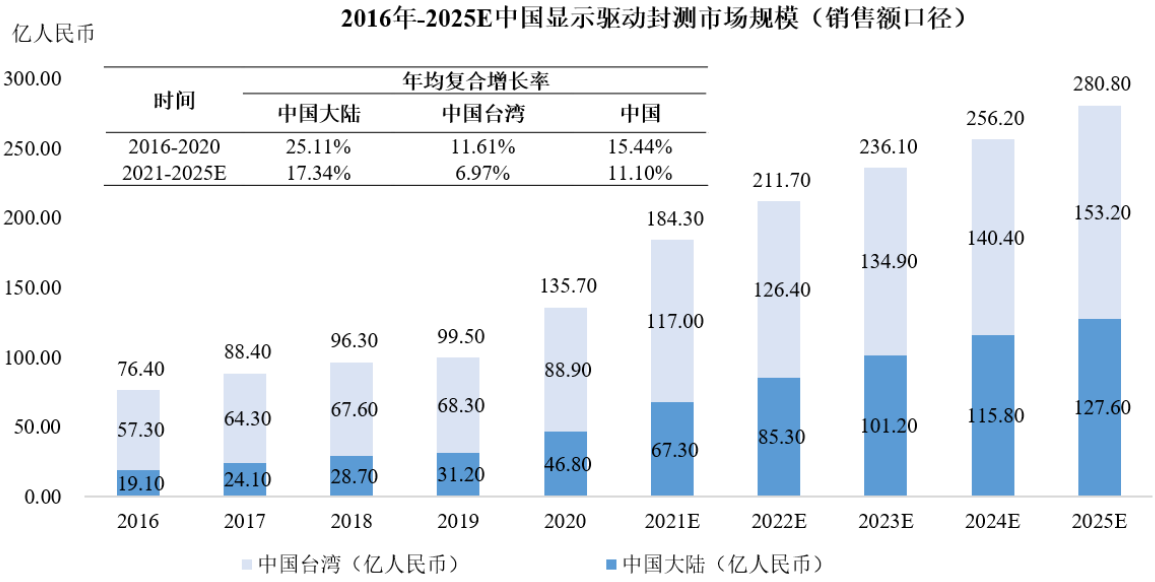
数据来源：Frost & Sullivan

②中国显示驱动芯片封装测试行业市场发展情况

中国显示驱动芯片封测行业涵盖中国大陆及中国台湾两个市场。得益于领先的晶圆代工厂及成熟的芯片设计产业，2016 年中国台湾的显示驱动芯片封测市场规模为 57.30 亿元，占据中国显示驱动芯片封测市场的 75.00%。2020 年，中国台湾显示驱动芯片封测行业在经过并购整合后，进一步增强了产业核心竞争力，市场规模达到了 88.90 亿元，年均复合增长率约为 11.61%。

相比之下，中国大陆相关厂商起步相对较晚，2016 年中国大陆的显示驱动芯片封测市场规模为 19.10 亿元。随着集成电路设计产业的快速成长和国内资本投入的提高，显示驱动芯片封测业务已逐渐开始转移至中国大陆。同时，受益于全球显示驱动芯片价格上涨，2020 年中国大陆显示驱动芯片封测市场规模达到 46.80 亿元，占中国显示驱动芯片封测市场的 34.49%。

未来随着国内芯片设计厂商的发展以及晶圆产能紧缺短期内难以改变的局面，中国显示驱动芯片封测行业的需求将快速增长。预计中国整体显示驱动芯片封测市场规模将持续增长，2025 年中国显示驱动芯片封测市场占全球市场比重将提升至 77.01%。



数据来源：Frost & Sullivan

（3）显示驱动芯片封装测试市场发展趋势分析

①行业呈现强者恒强的先发者优势

显示驱动芯片封测为集成电路封测行业内一个较为细分的市场，当前市场内主要企业均已具备成熟的工艺技术以及建立了长期而稳定的客户关系。相较于其他新兴市场，显示驱动芯片封测市场技术迭代相对较慢，前期设备研发投入较大，行业毛利率较低，需通过规模化生产来保证企业的健康发展。因此，行业内领先企业通过与显示驱动芯片设计公司的深度绑定，降低了研发周期，保证了订单的延续性，也增强了企业自身的核心竞争力。行业内新进入的竞争者需要较长时间

来获得芯片设计厂商的信任，导致前期的生产需求不足，加大了对于资金的需求。未来，随着行业领先企业继续加深与已有芯片设计厂商的合作，有望进一步扩大市场份额，并对新进入者保持技术及规模优势。

②随着显示技术的不断拓展，显示驱动芯片封测向高度集成化发展

近些年来，国家大力推进超高清视频产业及相关领域的发展和应用，4K 和 8K 电视对高动态范围、高色域、高对比度、高光效、高分辨率等方面提出了新的要求，因此发展出了 AMOLED、Mini LED、Micro LED 等新型显示技术。面对新型显示技术，显示驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题，因此显示驱动芯片的封测需要集成更多数量晶体管以提升芯片性能，而且还需要将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现多功能集成，整体显示驱动芯片的封测向高度集成化发展。

③新兴科技产业的发展带来新市场机遇

随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快。在显示面板领域，随着电视面板分辨率的提升，每台电视所需显示驱动芯片颗数几乎成倍增加，每台 4K 电视需使用 10-12 颗显示驱动芯片，而每台 8K 电视使用的显示驱动芯片高达 20 颗，新兴科技产业将成为行业新的市场推动力。

（三）行业整体竞争格局及市场集中情况，发行人产品或服务的市场地位、主要竞争对手、行业技术壁垒或主要进入障碍

1、行业整体竞争格局及市场集中情况

随着技术的创新发展，集成电路封装测试行业日益精细化，衍生出众多细分领域，公司目前聚焦于显示驱动芯片封测领域。在整个集成电路封测行业，主要公司有日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、利扬芯片与气派科技等。

全球显示驱动芯片封测行业集中度较高，头部效应明显，除部分专门提供对内显示驱动芯片封测服务的厂商集中在韩国外，行业龙头企业均集中在中国台湾

及大陆地区。中国台湾在经过行业整合后，中小型封测厂纷纷被大厂并购，目前仅剩颀邦科技、南茂科技两家全球领先的显示驱动芯片封测厂商。中国大陆起步相对较晚，且由于缺乏成熟的芯片设计厂商，市场需求不足，因此中国大陆地区的封测企业规模相对中国台湾地区的封测企业规模较小。随着中国大陆近年来对芯片设计企业的不断扶持和企业技术的不断成熟，急剧上升的显示驱动芯片封测需求将会推动现有显示驱动芯片封测厂商的持续扩产，并吸引更多领先的封测厂商进入行业。

全球显示驱动芯片封测行业中，独立对外提供服务且市场份额占比较高的企业包括颀邦科技、南茂科技、汇成股份、颀中科技与通富微电。其中，颀邦科技和南茂科技均为中国台湾上市公司；颀中科技原为颀邦科技境内子公司，后被境内其他股东收购，现为中国 A 股上市公司；通富微电为中国 A 股上市公司。

2、发行人产品或服务的市场地位

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的研究与应用，深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒，公司技术水平在行业中处于领先地位。

凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与出众的服务能力，公司积累了优质的客户资源，包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等知名芯片设计企业，公司产品服务质量已得到行业客户的高度认可，并曾获得全球领先的显示驱动 IC 设计公司联咏科技颁发的最佳品质供应商等荣誉。

3、主要竞争对手

在整个集成电路封测行业，主要公司有日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、甬矽电子、利扬芯片与气派科技等，其中，长电科技、通富微电、华天科技产品线横跨封测行业多个细分领域，晶方科技专注于 CMOS 图像传感器的封装和测试，甬矽电子聚焦集成电路封测业务中的先进封装领域，利扬芯片专注于集成电路测试领域，气派科技系华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一。

在细分行业显示驱动芯片封测领域，主要的公司有颀邦科技、南茂科技、汇成股份及颀中科技等，其中，颀邦科技和南茂科技均为中国台湾上市公司，颀中科技为中国 A 股上市公司。

行业内的主要企业情况如下：

公司名称	所属地区	上市地点及代码	成立时间	主营业务	2023 年度营业收入
日月光	中国台湾	台湾证券交易所（3711.TW）美国纳斯达克证券交易所（ASX.N）	1984 年	晶圆前段测试、晶圆针测至后段封装及成品测试的统包服务	58,191,447.10 万新台币
Amkor	美国	美国纳斯达克证券交易所（AMKR.O）	1968 年	半导体封装、设计和测试服务	650,306.50 万美元
颀邦科技	中国台湾	台湾证券交易所（6147.TWO）	1997 年	凸块的制造销售并提供后段的卷带式软板封装（TCP）、卷带式薄膜覆晶封装（COF）、玻璃覆晶封装（COG）等服务	2,005,638.80 万新台币
南茂科技	中国台湾	台湾证券交易所（8150.TW）	1997 年	高密度高层次的记忆体半导体、逻辑产品与混合信号产品的封装测试及后段的加工、配货服务	2,135,622.80 万新台币
长电科技	中国大陆	上海证券交易所（600584.SH）	1998 年	微系统集成封装测试一站式服务，包含集成电路的设计与特性仿真、晶圆中道封装及测试、系统级封装及测试服务	2,966,096.09 万元
通富微电	中国大陆	深圳证券交易所（002156.SZ）	1997 年	集成电路封装测试	2,226,928.32 万元
华天科技	中国大陆	深圳证券交易所（002185.SZ）	2003 年	半导体集成电路、MEMS 传感器、半导体元器件的封装测试	1,129,824.53 万元

公司名称	所属地区	上市地点及代码	成立时间	主营业务	2023 年度营业收入
晶方科技	中国大陆	上海证券交易所（603005.SH）	2005 年	专注于传感器领域的封装测试业务	91,328.89 万元
甬矽电子	中国大陆	上海证券交易所（688362.SH）	2017 年	主要从事集成电路的封装和测试业务	239,084.11 万元
利扬芯片	中国大陆	上海证券交易所（688135.SH）	2010 年	集成电路测试方案开发、晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务	50,308.45 万元
气派科技	中国大陆	上海证券交易所（688216.SH）	2006 年	芯片封装测试和自购芯片封装测试	55,429.63 万元
颀中科技	中国大陆	上海证券交易所（688352.SH）	2004 年	大规模集成电路产品和半导体专业材料的开发、生产、封装和测试，是国内驱动芯片封装测试主要服务商之一	162,934.00 万元

数据来源：上表公司年度报告、公司官网等公开信息披露渠道。

4、行业技术壁垒或主要进入障碍

（1）技术壁垒

公司从事的先进封测行业，具有较高的技术门槛和难点，如金凸块制造环节具有溅镀、光刻、蚀刻、电镀等多道环节，需要在单片晶圆表面制作数百万个极其微小的金凸块作为芯片封装的引脚，并且对凸块制造的精度、可靠性、微细间距均有较高的要求，因而目前中国大陆具备凸块制造能力的综合类封测企业较少；又如在 COF 封装环节，由于显示驱动芯片 I/O 接点间距最小仅数微米，需要在几十毫秒内同时将数千颗 I/O 接点一次性精准、稳定、高效地进行结合，难度较大，需要配备专门的技术团队进行持续研发。

综上所述，本行业对新进入者有较高的技术壁垒，并且随着技术升级，本行业的技术门槛将进一步提升。

（2）客户壁垒

就显示驱动芯片封测领域而言，一方面，显示驱动芯片封测厂商不仅需要通过 IC 设计公司的验证，也需要通过下游面板厂商的验证，甚至部分产品需要终端品牌商的认证；另一方面，由于显示驱动芯片封测领域下游客户集中度较高，且显示产业链已形成稳定的产业生态，新进入者面临的挑战较大。因此，从行业

发展历程来看，无论是境内还是境外，市场份额主要集中在少数显示驱动芯片封测领域的专业厂商。

综上所述，对于显示驱动芯片封测市场，新进入者面临着下游客户认证标准高、认证周期长等情况，市场进入壁垒较高。

（3）人才壁垒

显示驱动芯片封测行业是技术密集型行业，对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求，需要大量专业性人才对先进技术及工艺进行不断创新。在目前中国大陆集成电路行业快速发展阶段，具备丰富经验、高技术水平的人才缺口越来越大，培养相关人才需要大量时间和经济成本。

因此，本行业对新进入者有着较高的人才壁垒。

（4）资金壁垒

显示驱动芯片封测行业前期设备研发投入较大，需通过投入大量资金实现规模化生产，以保证企业的健康发展。因此，行业内领先企业通过与显示驱动芯片设计公司的深度绑定，降低研发周期、保证订单的延续性。行业内新进入的竞争者需要较长时间来获得芯片设计厂商的信任，导致前期的需求不足，加大了对于资金的需求。

因此，本行业对新进入者具有较高的资金壁垒。

5、发行人竞争优势

（1）领先的技术研发优势

显示驱动芯片封测行业属于技术密集型行业，公司所应用的封测技术均属于高端先进封装形式。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物

理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。

（2）知名客户的资源优势

显示驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、不断提升的量产能力、交付及时性等，公司获得了行业内知名客户的广泛认可，已经建立了较强的资源优势。

自成立以来，公司与联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，其中公司分别于 2020 年和 2021 年上半年获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，深厚的客户资源将为公司的长期发展带来源源动力。

（3）专业的管理团队优势

公司拥有专业的管理团队，部分核心管理成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备超过 15 年的技术研发或管理经验，具备行业内领先企业的发展视野。公司管理团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为深刻的认识，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力和开发新工艺提供了强有力的人力资源支持。

封测行业客户需求较为多样化，不同的产品需求往往需要不同的生产工艺、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳定性强、体积轻薄等客户需求的品质，产品良率高达 99.90%以上，得到行业客户的高度认可。

（4）全流程统包生产优势

公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有 8 吋和 12 吋产线的显示驱动芯片全流程封测企业，业务覆盖了金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全流程服务有效提高了生产效率、缩短了交付周期、降低了生产成本，并且避免了晶圆测试与封装流程中间长距离周转而导致晶圆被污染的风险。

（5）地理与产业集群优势

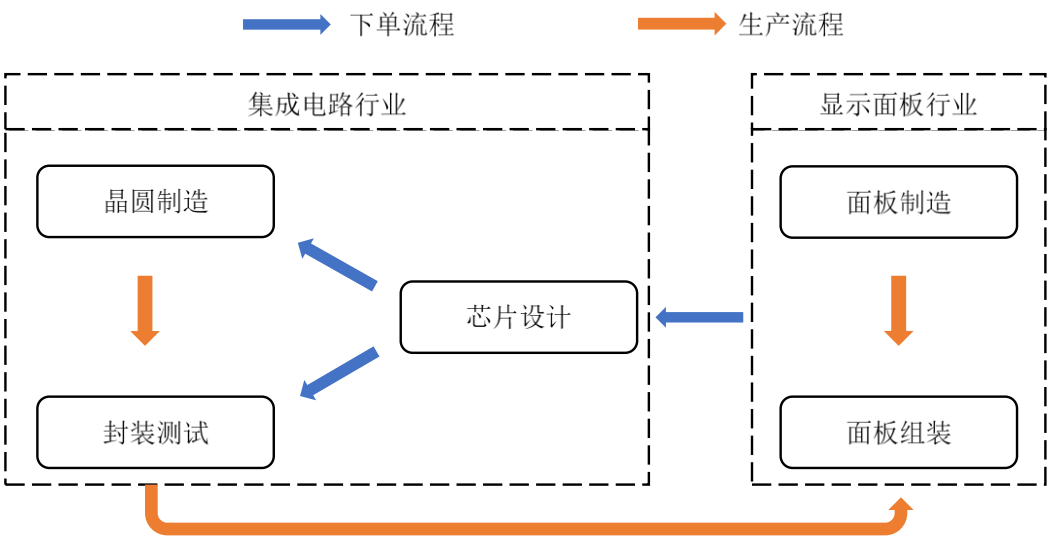
公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，也是长三角区域经济一体化重要城市。合肥市具有良好的产业基础和经营环境，政府大力推进集成电路产业的集群发展，着力打造以合肥为核心的“一核一弧”的集成电路产业空间分布格局。此外，长三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，具有较为显著的范围经济效益，公司立足长三角有利于更贴近客户和原辅材料供应商，产生协同作用。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业已初具规模，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于享受集成电路产业集群红利。

（四）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

1、公司与上下游行业之间的关联性

在显示驱动芯片产业链中，一般由显示面板企业向芯片设计公司提出设计需求，芯片设计公司在完成设计后分别向晶圆制造代工厂和封装测试企业下订单，晶圆制造企业将制造好的晶圆成品交由封装测试企业，最后封测企业在完成凸块制造、封装测试环节后，直接将芯片成品发货至显示面板或模组厂商进行组装。



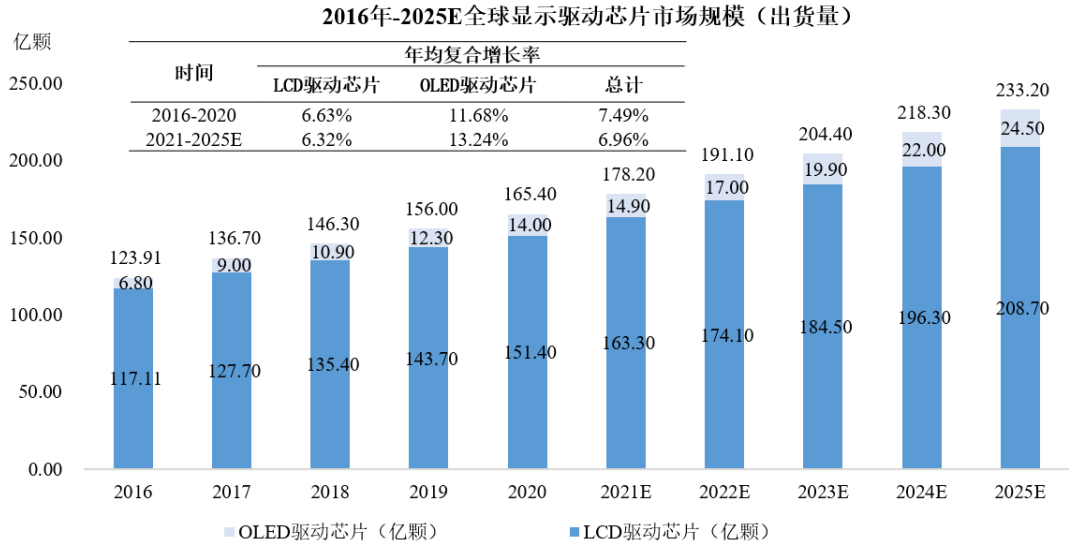
2、显示驱动芯片行业发展状况

全球显示驱动芯片的产业格局中，韩国厂商和中国台湾厂商占据主导地位，包括三星、联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技等。近些年，随着天德钰、爱协生、集创北方、中颖电子、格科微、明微电子等厂商的崛起，中国大陆的市场份额有所提升。未来随着我国芯片设计的人才资源逐步丰富、晶圆制造业的产能供给提升、封装测试技术的集成度进一步提高以及显示面板行业的持续快速发展，中国大陆的显示驱动芯片市场份额将持续增加。

（1）全球显示驱动芯片行业市场规模

受益于全球显示面板出货量的增长，显示驱动芯片市场规模也快速增长。根据 Frost & Sullivan 统计，全球显示驱动芯片出货量从 2016 年的 123.91 亿颗增长至 2020 年的 165.40 亿颗，年复合增长率为 7.49%。预计未来将持续增长，到 2025 年出货量增至 233.20 亿颗。

LCD 面板出货量稳步增长，带动 LCD 驱动芯片出货量逐步提升。2020 年，全球 LCD 驱动芯片出货量为 151.40 亿颗，预计未来将继续稳定在高出货量水平，到 2025 年增至 208.70 亿颗。得益于 OLED 屏幕的高速增长，OLED 驱动芯片出货量亦快速增长，预计到 2025 年将增至 24.50 亿颗。



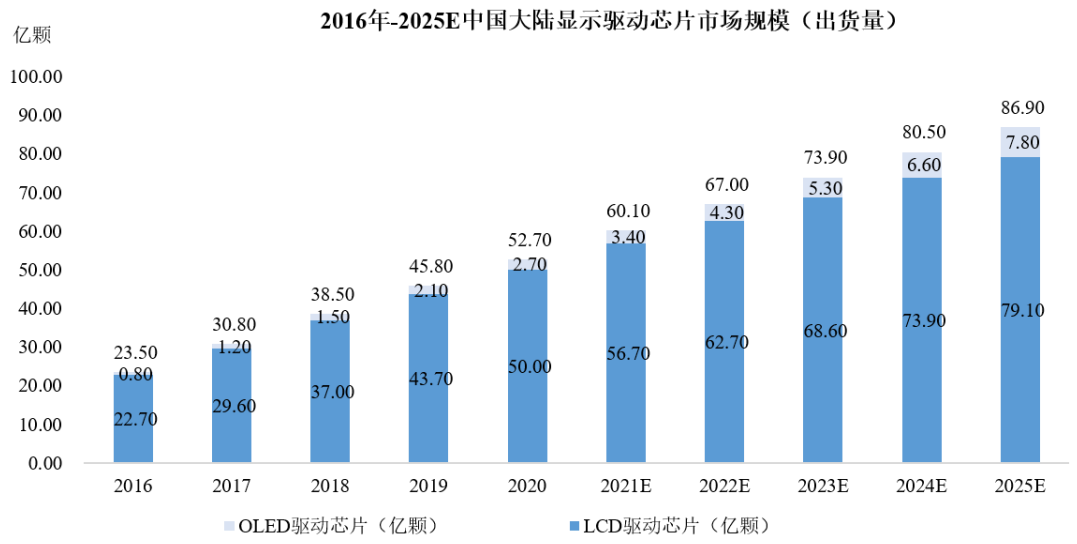
时间	年均复合增长率		
	LCD驱动芯片	OLED驱动芯片	总计
2016-2020	6.63%	11.68%	7.49%
2021-2025E	6.32%	13.24%	6.96%

数据来源：Frost & Sullivan

（2）中国大陆显示驱动芯片行业市场规模

受下游显示面板市场增长的驱动，叠加国家政策利好及大量资本投入，中国大陆显示驱动芯片以高于全球平均速度增长。据统计，2016 年中国大陆显示驱动芯片出货量仅为 23.50 亿颗，但 2020 年已增至 52.70 亿颗，年复合增长率高达 22.37%。其中，LCD 驱动芯片出货量从 2016 年的 22.70 亿颗增长至 2020 年的 50.00 亿颗，年复合增长率为 21.82%；OLED 驱动芯片从 2016 年的 0.80 亿颗增至 2020 年的 2.70 亿颗，年复合增长率为 35.54%。

预计 2025 年中国大陆显示驱动芯片出货量将达到 86.90 亿颗，其中 LCD 驱动芯片产量将增至 79.10 亿颗，OLED 驱动芯片产量将增至 7.80 亿颗。



数据来源：Frost & Sullivan

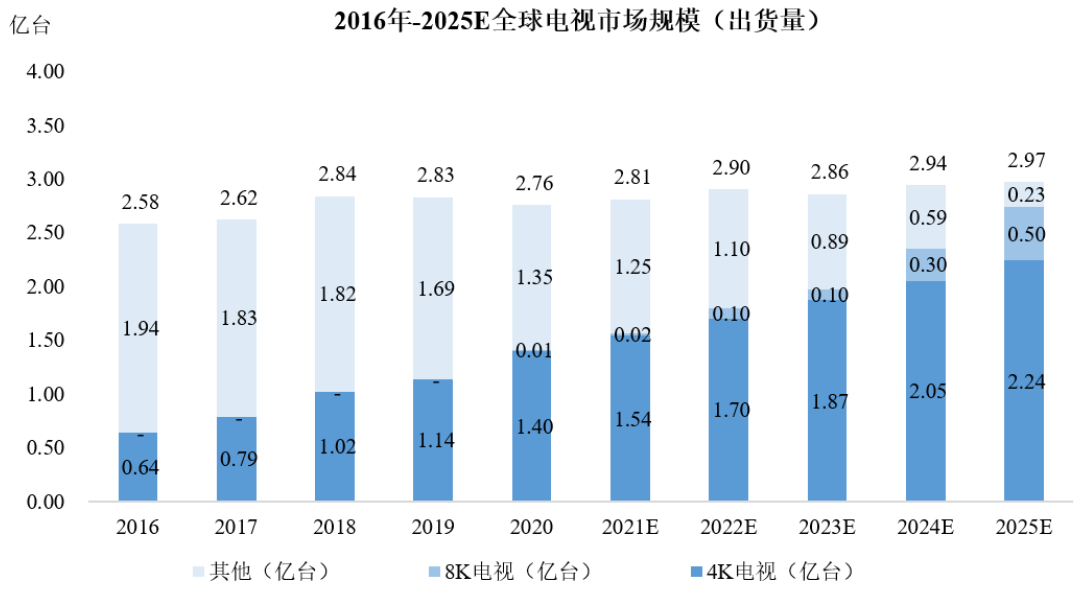
3、显示驱动芯片行业主要下游市场发展情况

显示驱动芯片行业的发展与面板行业及其终端消费市场发展情况密切相关，主要的终端消费市场集中在电视、笔记本电脑、智能手机等。

（1）全球电视市场

全球电视的发展趋势为：4K 电视逐渐普及，出货量不断攀升，2016 年出货量仅为 0.64 亿台，2020 年增长至 1.40 亿台，渗透率从 24.81%增至 50.72%；8K 电视因价格过高，市场接受度较小，2018 年开始有小幅出货，2020 年出货量为 100 万台。

随着显示技术的发展和 8K 电视成本的降低，电视将继续朝更高分辨率的方向发展。预计 2025 年电视出货量为 2.97 亿台，4K 电视出货量增至 2.24 亿台，渗透率达 75.42%，8K 电视出货量增至 0.50 亿台，渗透率达 16.84%。

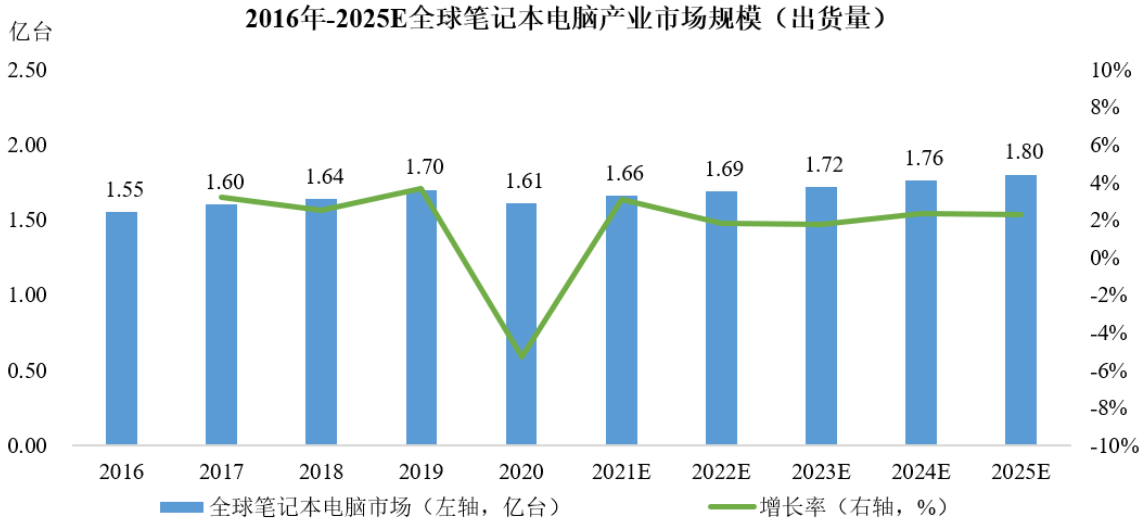


数据来源：Frost & Sullivan

随着电视面板分辨率的提升，每台电视所需显示驱动芯片颗数几乎成倍增加。每台高清、全高清或 2K 电视仅需 4-6 颗显示驱动芯片，但每台 4K 电视需使用 10-12 颗显示驱动芯片，而每台 8K 电视使用的显示驱动芯片高达 20 颗。因此，伴随着未来全球电视出货量的平稳增长以及更高分辨率电视渗透率比重的提升，所需显示驱动芯片数量将大幅增加。

（2）全球笔记本电脑市场

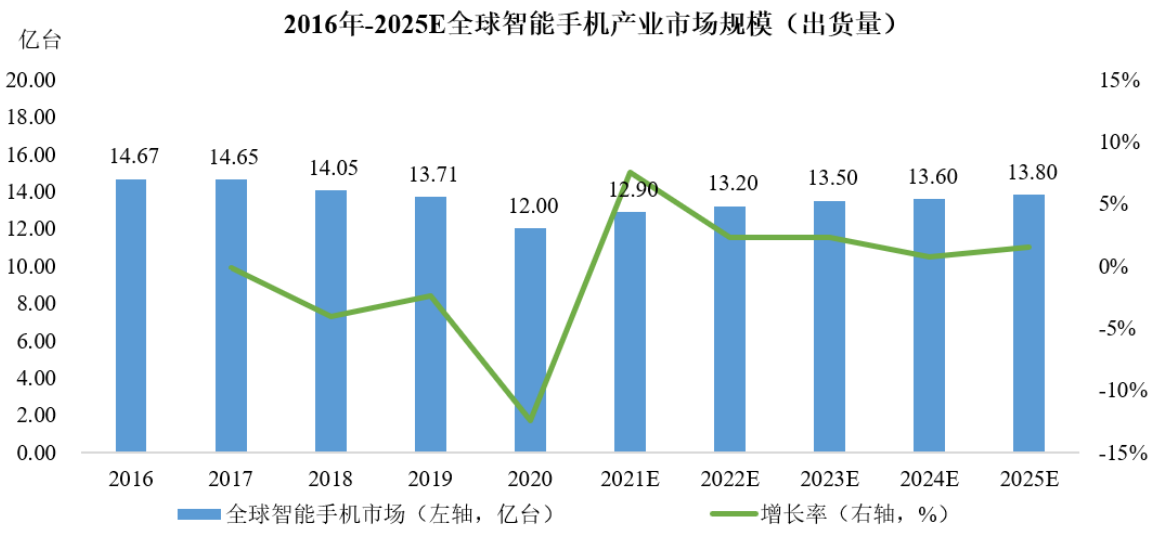
全球笔记本电脑市场规模近五年处于平稳增长状态，由于笔记本电脑新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，相对延长了笔记本电脑产品的生命周期。2020 年，笔记本电脑市场规模为 1.61 亿台，而随着折叠屏等技术发展，笔记本电脑有望迎来新的增长点，市场增长速度回暖，预计 2025 年将达到 1.80 亿台。



数据来源：Frost & Sullivan

（3）全球智能手机市场

全球智能手机市场规模近五年处于存量更换时代，2020 年智能手机的市场规模为 12.00 亿台，但随着 5G 应用的普及和新兴市场的需求增长，全球智能手机市场将有所转暖，未来全球智能手机市场将维持平稳增长态势，预计 2025 年出货量将稳步上升至 13.80 亿部。



数据来源：Frost & Sullivan

八、公司的主营业务情况

（一）主营业务及主要产品概况

1、主营业务

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

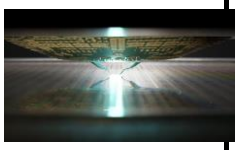
公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。

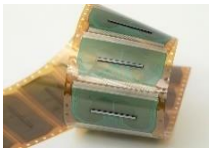
公司经过多年持续的研发投入及技术沉淀，形成了微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术等多项核心技术，在行业内具有技术领先优势。公司围绕集成电路封装测试的行业特性，在生产工艺及生产装置等环节持续研发改进，追求高精度、高良率、高可靠性的封装测试核心能力，为显示驱动芯片的大批量国产化应用奠定了坚实的技术基础。

公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路产业的全球竞争力为使命。未来，公司将积极扩充 12 吋大尺寸晶圆的先进封装测试服务能力，保持行业及产品的领先地位，同时将进行持续的研发投入，不断拓宽封测服务的产品应用领域，积极拓展以车载电子等为代表的新兴产品领域。

2、主要产品

公司目前主要所封装测试的产品应用于显示驱动领域，以提供全制程封装测试为目标，涉及的封装测试服务按照具体工艺制程包括金凸块制造（Gold Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），具体情况如下：

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域	完成相关制程后的产品图示
Gold Bumping	金凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程，在晶圆的焊垫上制作金凸块，可达到高效的电性传输，替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现金凸块宽度与间距最小至 6μm、单片 12 吋晶圆上制造 900 余万金凸块	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积，具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域，适用于覆晶封装（FC）技术	
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性，对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识，在切割环节被淘汰，不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片，直接计算出良率，还可以减少后续不必要的操作，有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序	

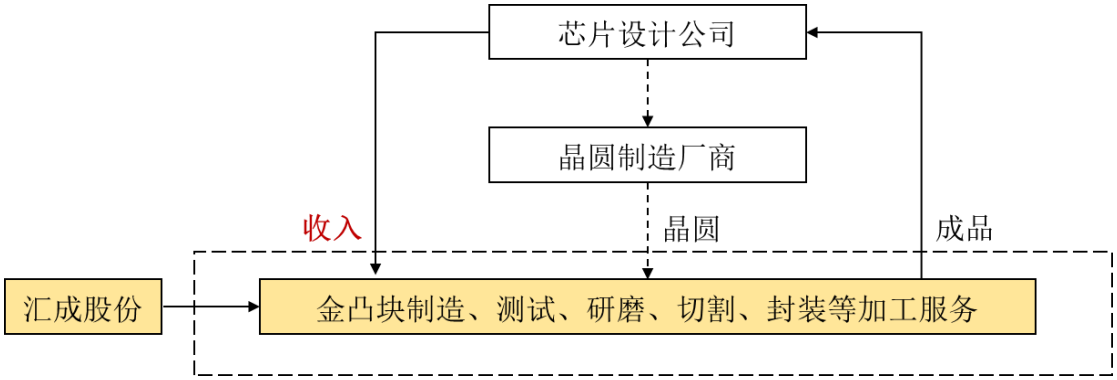
工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域	完成相关制程后的产品图示
COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术，由封装厂商负责切割成型，面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺，也是最具有性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板，如手机、平板电脑、数码相机等	
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的金凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等	

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业，采用行业惯用的 OSAT（半导体封装测试外包）模式，在 OSAT 模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行金凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司系根据所提供服务收取加工服务费的方式以获取收入和利润。具体图示如下：



2、采购模式

公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单并签约。具体的采购情况如下：

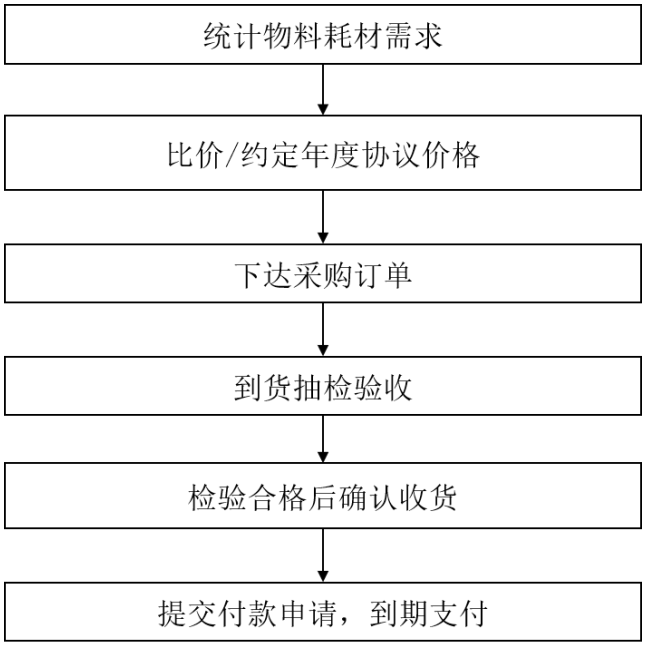
（1）各工艺制程的主要采购内容

工艺制程	采购的原材料种类
Gold Bumping	电镀液、金盐、金靶、钛钨靶、光刻胶、蚀刻液等
CP	墨水等
COG	切割刀片、蓝色胶带、UV 胶带、Tray 盘、研磨轮等
COF	COF 胶材等

（2）采购流程

对于主要采购材料，公司一般会与供应商约定年度协议价格，未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款，由物料采购部根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后，到期支付款项。

采购材料到货后由品质保障部进行验收，品质保障部核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在系统中制作验收单，经系统签核后确认收货。



（3）设备采购

根据公司生产以及扩产需求，相关请购部门提出设备采购申请，经批准后，由物料采购部统计采购需求统一下达正式订单给供应商，供应商安排生产、交货。

（4）供应商管理制度

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。

公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制，以销定产”受托加工生产模式，即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料，公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料，接着根据客户需求完成相应工艺制程，而后将成品交付予客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务，拥有专业的工程技术和生产管理团队，并配备了专业的高精度自动化生产设备，可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度，具体的销售流程和定价策略如下：

（1）销售流程

作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务，并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

（2）定价策略

基于定制化的受托加工模式，公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点，整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下，与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

金凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定，含金原

料是金凸块制造环节的主要材料成本，定价结合黄金的市场价格及不同规格芯片所需耗用的黄金用量确定。

晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下，与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒，并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势，进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段，具体情况如下：

（1）项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道：一是研发中心会定期调研行业发展趋势，结合公司发展战略及现有技术基础，选择相应的新工艺、新产品的研发立项；二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息，形成对市场需求的综合判断，针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

（2）项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后，将先进行初步论证，如初步论证可行，则会同公司管理层共同讨论立项建议，根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判，确定具体研发内容，进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署，形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

（3）工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求，开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组，积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后，将召开评审会议，对项目取得相应的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果，对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善，并及时反馈给研发中心相关负责人。

（4）样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制，专项课题小组辅以监督和技术指导，试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的，则样品还需经过客户验证。

（5）研发结项

在验证合格后，研发中心将召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过后专项课题小组提交研发结项报告，项目研发工作结束。

（三）生产、销售情况和主要客户

1、主要产品的产能、产量及销量

（1）金凸块制造及封装的产能、产量、销量及产能利用率情况

公司测试服务可分为两类：第一类为封测全流程统包服务，即封测一体，完成封装和测试整个流程；第二类为产品单独测试，即仅进行测试服务。公司非独立的测试企业，核心业务为封装服务且绝大部分产品均为封测一体，因此通过分析金凸块制造及封装产品数量来体现公司的产销情况。

报告期内，公司金凸块制造及封装的产能利用率、产销率情况如下：

项目			2023 年度	2022 年度	2021 年度
Gold Bumping	8 吋	产能（万片）	39.60	39.72	44.37
		产量（万片）	17.61	22.07	32.65
		销量（万片）	19.04	20.52	32.90
		产能利用率	44.48%	55.56%	73.58%
		产销率	108.07%	92.97%	100.78%
	12 吋	产能（万片）	39.01	28.88	21.44
		产量（万片）	39.41	28.75	18.41
		销量（万片）	39.14	27.55	17.16
		产能利用率	101.01%	99.53%	85.87%
		产销率	99.32%	95.82%	93.18%
COG		产能（千颗）	1,235,369.36	983,141.84	908,824.60

项目		2023 年度	2022 年度	2021 年度
	产量（千颗）	1,063,565.90	753,532.91	677,809.08
	销量（千颗）	1,034,925.54	730,697.73	675,918.65
	产能利用率	86.09%	76.65%	74.58%
	产销率	97.31%	96.97%	99.72%
COF	产能（千颗）	390,224.64	375,297.14	350,292.37
	产量（千颗）	334,629.04	209,960.51	294,386.85
	销量（千颗）	326,391.55	215,088.29	285,081.43
	产能利用率	85.75%	55.95%	84.04%
	产销率	97.54%	102.44%	96.84%

注 1：制程 i 年度产能=∑（第 j 月（日工作时间÷设备 k 标准产出时间×设备 k 标准产出数量×设备 k 利用率×月工作日），i 属于 I，I 包括 Gold Bumping、COG、COF 等主要制程；j=1，2，3……12；公司各制程产能由各设备协同作用决定，k 为制程 i 重要生产设备；
注 2：制程 i 当期产能利用率= 产量 / 产能；
注 3：制程 i 当期产销率= 销量 / 产量。

（2）晶圆测试的产能情况

公司为客户提供的晶圆测试服务是高度定制化、个性化的生产活动，不同客户、不同产品单片测试时长不一致，故使用测试机工作时长计算产能情况。

报告期内，公司晶圆测试的产能利用率情况如下：

项目		2023 年度	2022 年度	2021 年度
CP	额定工时（h）	1,822,137.60	1,309,593.60	1,085,440.80
	实际工时（h）	1,534,246.20	1,048,941.48	1,012,266.00
	产能利用率	84.20%	80.10%	93.26%

注 1：额定工时=∑（i 月末测试机数量*设备利用率*24 小时*当月工作天数）,i=1,2,3…12；
注 2：当期产能利用率=实际工时/额定工时。

2、报告期内前五大客户情况

报告期内，公司对前五大客户主营业务销售情况如下：

单位：万元

2023 年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	联咏科技	39,176.75	33.53%
2	天钰	24,142.93	20.66%

3	集创北方	11,520.20	9.86%
4	奕力科技	7,949.51	6.80%
5	爱协生	6,289.40	5.38%
合计		**89,078.78**	**76.24%**
2022 年度			
序号	**客户名称**	**销售金额**	**占主营业务收入比例**
1	联咏科技	24,874.63	28.13%
2	天钰	22,200.11	25.10%
3	奕力科技	10,038.69	11.35%
4	集创北方	8,613.47	9.74%
5	爱协生	4,804.86	5.43%
合计		**70,531.76**	**79.75%**
2021 年度			
序号	**客户名称**	**销售金额**	**占主营业务收入比例**
1	天钰	23,155.67	30.23%
2	联咏科技	19,771.02	25.81%
3	瑞鼎	5,104.24	6.66%
4	奕力科技	4,386.96	5.73%
5	集创北方	3,866.62	5.05%
合计		**56,284.51**	**73.48%**

注：上表中，客户按照同一控制下合并口径披露：①天钰包括天钰科技股份有限公司、合肥捷达微电子有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司；②瑞鼎包括瑞鼎科技股份有限公司、昆山瑞创芯电子有限公司；③集创北方包括北京集创北方科技股份有限公司、集创北方（香港）有限公司、OLED VICTORY INTERNATIONAL LIMITED；④爱协生包括深圳市爱协生科技股份有限公司、马鞍山爱协生科技有限公司、东莞市爱协生智能科技有限公司、烨溢科技（香港）有限公司、华科供应链（香港）有限公司；⑤奕力科技包括奕力科技股份有限公司和合肥豪迪微电子有限公司。

按照客户受同一控制合并口径，2021 年、2022 年度以及 2023 年度，公司向前五名客户合计销售金额占当期主营业务收入的比例分别为 73.48%、79.75%和 76.24%，公司客户集中度较高主要是由显示驱动芯片行业格局所决定的。

报告期内，公司向联咏科技、天钰的销售金额占主营业务收入比例存在超过 30%的情形，主要系下游显示驱动芯片设计公司具备较高的技术门槛，行业集中度较高，而且联咏科技与天钰均为全球排名前列的显示驱动芯片设计公司，市场地位较高。因此，上述情形符合行业特性，具有合理性。

（四）原材料、能源采购情况和主要供应商

1、主要原材料采购情况

报告期内，公司封装测试显示驱动芯片所采购的原材料主要包括含金电镀液、金盐、金靶等含金原料以及 Tray 盘、光刻胶等，具体情况如下：

单位：万元

类别	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	采购金额	占材料采购总额比	采购金额	占材料采购总额比	采购金额	占材料采购总额比
金盐	27,418.87	55.26%	17,034.03	45.73%	12,154.37	36.30%
含金电镀液	4,901.16	9.88%	7,538.40	20.24%	11,129.79	33.24%
金靶	4,911.99	9.90%	3,475.54	9.33%	2,234.16	6.67%
Tray 盘	2,396.59	4.83%	1,862.81	5.00%	1,553.63	4.64%
光刻胶	1,189.77	2.40%	1,154.82	3.10%	907.98	2.71%
总计	**40,818.38**	**82.26%**	**31,065.61**	**83.40%**	**27,979.93**	**83.57%**

2、主要能源采购情况

报告期内，公司主要采购能源为电，具体情况如下：

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
用电量（万度）	8,593.91	6,919.14	6,114.00
金额（万元）	5,695.61	4,670.39	4,062.50
平均单价（元/度）	0.66	0.67	0.66

报告期内，公司用电价格基本保持稳定，用电量呈逐年增加趋势，主要系显示驱动芯片封装测试量持续增加所致。

3、公司报告期内主要供应商情况

报告期内，公司向前五大原材料供应商的采购情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占原材料采购总额比例	主要采购内容
2023 年度				
1	光洋科技	31,867.14	64.22%	金盐、金靶

2	田中	5,084.04	10.25%	含金电镀液等
3	怡康化工	1,052.20	2.12%	光刻胶
4	昇云半导体	989.71	1.99%	COG 胶带
5	原津工业	860.81	1.73%	Tray 盘
合计		**39,853.89**	**80.32%**	**-**
2022 年度				
1	光洋科技	20,533.63	55.13%	金盐、金靶
2	田中	7,750.58	20.81%	含金电镀液等
3	怡康化工	1,046.45	2.81%	光刻胶
4	利机股份	887.45	2.38%	Tray 盘
5	昇云半导体	721.51	1.94%	COG 胶带
合计		**30,939.63**	**83.07%**	**-**
2021 年度				
1	光洋科技	14,388.53	42.98%	金盐、金靶
2	田中	11,342.49	33.88%	含金电镀液等
3	利机股份	1,016.15	3.04%	Tray 盘
4	怡康化工	752.76	2.25%	光刻胶
5	昇云半导体	553.60	1.65%	COG 胶带
合计		**28,053.53**	**83.79%**	**-**

注：上表中，供应商按照同一控制下合并口径披露：①光洋科技包括光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司、光洋新材料科技（昆山）有限公司；②田中包括田中贵金属（上海）有限公司和美泰乐科技（苏州）有限公司。

2021 年、2022 年和 2023 年度，公司向前五名供应商合计的采购额占当期原材料采购额的比例分别为 83.79%、83.07%和 80.32%，供应商集中度较高。

报告期内，公司向光洋科技、田中的采购金额占原材料采购总额比例存在超过 30%的情形，主要系含金电镀液、金盐、金靶等原材料市场集中度较高。报告期内，光洋科技是公司的第一大原材料供应商，公司主要向其采购金凸块制造制程所需的金盐、金靶。光洋科技系中国台湾上市公司（股票代码：1785.TWO），是全球领先的贵金属与稀有金属回收精炼、特殊成型、加工厂商，产品在半导体制造等领域拥有较高市场占有率。报告期内，田中是公司第二大原材料供应商，公司主要向其主要采购含金电镀液用于显示驱动芯片前段的金凸块制造工艺制程。田中创立于 1885 年，是全球知名贵金属制造企业，在该领域位居前列，近

年来产品在半导体制造等领域亦拥有较高市场占有率。因此，上述情形符合行业特性，具有合理性。

（五）发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有发行人 5%以上股份的股东在上述供应商或客户中所占的权益

截至本募集说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有发行人百分之五以上股份的股东未在上述客户或供应商中持有权益。

（六）贸易政策的影响

报告期内，发行人境外收入占主营业务收入的比例分别为 75.52%、63.96%和 61.97%，整体处于较高水平。发行人的主要客户为全球知名的显示驱动芯片设计公司，其中大部分位于中国台湾和中国香港。中国台湾与中国大陆之间签署了《两岸经济合作架构协议》，其中对相关产品无进口限制等贸易政策，目前两岸关系稳定，贸易政策未发生重大变化。中国香港是我国的特别行政区，为自由贸易港，对相关产品亦无进口限制等贸易政策，且未发生重大变化。

报告期内，发行人 30%左右原材料采购自境外（具体以原材料原产地为统计口径），境外供应商主要位于日本、中国台湾，目前对发行人采购的含金电镀液等原材料不存在特殊的贸易限制，且未发生重大变化。

（七）安全生产和环境保护情况

公司严格执行安全生产和环境保护相关法律法规及公司内部相关制度和要求，落实企业主体责任。公司建立、健全了安全生产和环境保护相关规章制度，规定了生产过程的安全注意事项和防范措施等，保证生产的安全顺利进行，确保企业环境安全。

公司不属于重污染行业企业。公司日常生产经营中会产生一定的废气、废水、固体废弃物和噪声，为此建立了严格的环境管理体制，并购置了相应的主要处理设施，能够及时有效地处理产出的环境污染物，公司及子公司均通过了环境管理体系认证，并取得相应排污许可证。

报告期内，公司及下属子公司严格遵守安全生产和环境保护相关法律法规，

在生产经营过程中未发生过重大安全生产或环境保护违法违规行为，也未受到过安全生产或环境保护相关的重大行政处罚。

（八）现有业务发展安排及未来发展战略

公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路半导体产业的全球竞争力为使命。公司深耕于显示驱动芯片的封装测试领域，在保证产品良率的同时，提升产品技术水平和生产效率，提供的产品与服务在市场上具备较强的竞争力。

未来，公司将不断提升先进封装技术水平，学习引进不同的封装工艺、优化并提高现有工艺的流程与效率；积极扩充 12 吋晶圆的先进封装测试服务能力，保持行业及产品的领先地位，同时将进行持续的研发投入，不断拓宽封测服务的产品应用领域，积极拓展以车载电子等为代表的新兴产品领域；加强市场开拓和品牌建设，夯实领先的成本管控和质量管理优势；逐步实现集成电路先进封装测试领域的进口替代，提高中国大陆集成电路先进封装测试行业的自主产研水平。

九、与产品有关的技术情况

（一）报告期内研发投入的构成及占营业收入的比例

为了保证持续的技术和产品创新，保持产品和服务的技术领先水平和市场竞争优势，公司一贯重视研发的投入。报告期内公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
研发费用	7,885.72	6,514.01	6,060.30
营业收入	123,829.30	93,965.28	79,569.99
研发费用率	6.37%	6.93%	7.62%

（二）重要专利及非专利技术及其应用情况

1、核心技术基本情况

公司核心技术主要集中在金凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等环节。公司基于微间距驱动芯片凸块制造技术等实现了显示驱动芯片的高密度细间距倒装封装。高密度细间距倒装封装是实现显示屏幕全面屏、薄型化和轻量化的关

键性技术，极大地促进了下游显示面板市场的发展，在显示面板整体发展中起到重要作用。

公司金凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装的基本情况如下：

①金凸块制造（Gold Bumping）：金凸块制造是一种在晶圆上形成微小的焊球或金柱的制造工艺，为满足凸块侧壁垂直度、表面平整性与强度，以及凸块下金属层（UBM）的粘附性等指标要求，晶圆凸块的制造过程需要物理气相沉积（溅镀）、光刻与电镀工艺的紧密结合。首先基于物理气相沉积技术在晶圆表面形成 UBM，然后利用厚胶光刻技术在晶圆上刻画出凸块线路图，再采用电镀工艺获得一定高度的凸块。相较于传统打线、引脚封装等技术，通过凸块与电路板电气相连可实现更小线宽，大幅减小芯片模组体积，具备高密度、低电阻、低成本、散热能力强等优势。

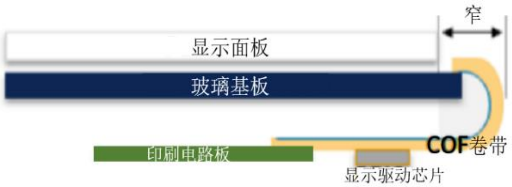
②玻璃覆晶封装（COG）：一种显示驱动芯片封装工艺，将芯片直接对准玻璃基板上的电极，利用异性导电膜材料作为接合的介面材料，使垂直方向的电极导通。由于玻璃基板不可弯折，因此使用 COG 技术封装的设备面板均保留了一定边框。目前，COG 封装技术主要应用于小尺寸面板，如手机、平板电脑、数码相机等。

③薄膜覆晶封装（COF）：一种显示驱动芯片封装工艺，利用 COG 技术的特点，将芯片贴装于卷带上，由于卷带具备可弯折性，因此可实现高密度、高屏占比、轻薄化。目前，COF 封装技术主要应用于液晶电视和全面屏手机等电子设备，是显示驱动芯片封装中应用最广、发展前景最好的技术之一。

COG 与 COF 封装工艺差异具体如下所示：

COG（玻璃覆晶封装）

COF（薄膜覆晶封装）



2、核心技术来源及应用情况

作为技术密集型企业，自有的技术基础和持续的研发实力是核心竞争力，公司深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在长期的自主研发以及生产实践过程中，积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业内具有领先地位。

公司目前主要聚焦于显示驱动芯片领域，申请专利的技术多为显示驱动芯片封装测试过程中某一具体环节技术突破或对某些生产装置的研发改进。对于公司生产研发过程中形成的如驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高精度高效内引脚接合工艺等涉及公司产品重要性能优势的核心技术，公司一方面将部分技术工艺申请专利作为防护措施，另一方面将其他核心工艺与技术要点作为公司专有工艺与技术进行保密管理。

公司核心技术来源均为公司自主研发，不存在侵权或者可能涉及侵权纠纷的情形，核心技术具体情况如下：

序号	核心技术名称	技术先进性	主要用途	涉及的主要专利	来源
1	驱动芯片可靠性工艺	通过多段溅射沉积以及改变每层钛钨合金保护层的厚度，改善保护层承受应力的可靠性，增加保护层与铝垫以及导电层的结合力，同时有效阻挡金跟铝形成合金，与单层钛钨合金保护层相比在相同应力下厚度可大幅减少。	生产工艺改进、生产装置改进	多段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构（201420706075.7）等专利	自主研发
2	微间距驱动芯片凸块制造技术	通过设计与排布让金凸块能够上下交错排列以缩小间距，螺旋涂布方式提升光刻胶分辨率，调适高精密度光刻机参数以改善曝光方式，将金凸块宽度与间距最小可缩至6μm。	生产工艺改进、生产装置改进	一种微间距驱动芯片金凸块结构（201620159958.X）等专利	自主研发
3	凸块高可靠性结构及工艺	创新出两段式金凸块电镀技术增加了产品的可靠性，与单段式相比可靠性试验时间提高近 50%，同时可以进一步防止铝垫裸露。	生产工艺改进、生产装置改进	一种半导体晶圆湿法蚀刻装置（201821708415.4）等专利	自主研发

序号	核心技术名称	技术先进性	主要用途	涉及的主要专利	来源
4	高精度晶圆研磨薄化技术	（1）通过定位、合框、切割、重组等操作将缺失的晶圆拼接填补全再固定进行研磨，有效地提升了产品良率；（2）采用高精度激光研磨装置微量控制 0.10μm 等级的抛磨技术，可完成高精度的硅晶薄化作业。	生产工艺改进、生产装置改进	一种晶圆研磨前裂片异常的处理方法（202010434613.1）等专利	自主研发
5	高稳定性晶圆切割技术	公司的晶圆切割装置可实现多设备统一控制、协同运作，有效提高切割效率、降低人工操作失误、大幅提升切割精度，切割出来的芯片更加圆润无毛边。	生产工艺改进、生产装置改进	一种应对真空异常的晶圆切割处理方法（201911051044.6）等专利	自主研发
6	高精度高效内引脚接合工艺	通过高精度高可靠的芯片识别与挑拣、微米级的凸块定位与键合等技术，实现在长约 30mm、宽约 1mm 的单颗芯片上，数千颗宽度与间隔仅为 6μm 的凸块与柔性基板（卷带）上对应的内引脚精准高效键合。	生产装置改进	一种可降低 Tape Bonding 工艺过程中抖动的机构（202011335523.3）等专利	自主研发
7	高精度柔性基板封装工艺中微尘防护技术	有效提升了防护覆盖率并避免晶粒裸露于环境中遭受污染，稳定生产良率。	生产装置改进	COF 覆晶结合前柔性电路板及芯片表面微尘清除器（201420008630.9）等专利	自主研发
8	晶圆清洁技术	有效提升了清洁流程的效率与产出效益、简化工序以缩短生产周期，且可以节约水资源、避免二次污染。	生产工艺改进、生产装置改进	洗除氧化钨的洗液及清洗附着有氧化钨生产工具的方法（201810093214.6）等专利	自主研发
9	集成电路封装微尘管理技术	保障产品免受污染，确保良率稳定。	生产工艺改进、生产装置改进	一种硅片封装结构（201920223070.1）等专利	自主研发
10	晶圆高精度稳定性测试技术	具备测试设备改造升级能力，可满足客户芯片测试的多样化需求。	生产工艺改进、生产装置改进	晶圆测试探针卡（201210527894.0）等专利	自主研发

（三）核心技术人员、研发人员情况

1、研发人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司在职员工 1,439 人，其中研发人员 212 人，研发人员占比 14.73%。

2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员共 4 名，包括林文浩、钟玉玄、许原诚和陈汉宗。报告

期内，公司的核心技术人员未发生变动。公司核心技术人员简历信息及变动情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”。

十、与业务相关的主要固定资产及无形资产

（一）主要固定资产情况

1、固定资产整体情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的主要固定资产包括房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具，其账面价值及成新率情况如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	38,757.76	11,462.63	27,295.13	70.42%
通用设备	2,253.74	1,413.91	839.83	37.26%
专用设备	303,571.07	92,345.05	211,226.02	69.58%
运输工具	306.59	156.25	150.33	49.03%
合计	**344,889.16**	**105,377.85**	**239,511.30**	**69.45%**

2、房屋建筑物

截至本募集说明书签署日，公司自有的房屋建筑物具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	坐落位置	用途	房屋建筑面积（m^2）	他项权利
1	汇成股份	皖（2021）合肥市不动产权第11223227号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期厂房新建工程 1 幢厂房 101/201/301	工业	8,225.99	无
2		皖（2021）合肥市不动产权第11223228号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期新建工程仓库 101/201		1,719.56	
3		皖（2021）合肥市不动产权第11223229号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期新建工程门卫 101		112.84	
4		皖（2021）合肥市不动产权第11223230号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期新建工		4,963.16	

序号	权利人	证书编号	坐落位置		用途	房屋建筑面积（m^2）	他项权利
			程动力楼-101/101/201				
5		皖（2021）合肥市不动产权第11223231号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期厂房新建工程 2 幢厂房 101/201			19,393.55	
6	江苏汇成	扬房权证邗江字第2012015390号	邗江区兴农路 1 号	1 幢	厂房	5,678.44	已抵押
				2 幢	厂房	19,640.56	
				3 幢	动力楼	3,454.95	
				4 幢	仓库	590.49	
				5 幢	门卫	127.70	

3、租赁房屋建筑物情况

截至 2024 年 5 月 13 日，公司正在租赁的房产情况如下：

序号	承租人	出租人	承租房产坐落	租赁期限	面积（m^2）	租赁用途	是否备案
1	汇成股份	合肥市住房租赁发展股份有限公司	新站区龙子湖路369号平板显示基地公租房 8#706、709、710、810、902、904、906、907、908 室	2024.01.01-2024.12.31	366.69	员工宿舍	是
2			新站区龙子湖路369号平板显示基地公租房 8#1001、1004、1005、1008、1009、1010 室	2024.01.23-2025.01.22	244.46		是
3			新站区龙子湖路369号平板显示基地公租房 8#1007、1101、1102、1103、1104、1105、1106、1107、1108、1109、1201、1202、1208 室	2024.02.27-2025.02.26	561.13		是
4			合肥市新站区龙子湖路369号平板显示基地公租房 8#705、707、708、805、807、808 室	2023.05.18-2024.05.17	263.34		是
5			合肥市新站区龙子湖路369号平板显示基地公租房 8#701-704、901、905 室	2023.04.18-2024.05.17	263.34		是
6			新站区龙子湖路369号平板显示基地公租房 8#802、1306、1901-1903、2001-2003、2006、2008 室	2024.01.25-2025.01.24	438.90		是
7		合肥鑫城	新站区平板基地公租房（66 间）	2021.09.01-2024.08.31	3,402.34	员工宿舍	是
8			新站区平板基地公租房（30 间）	2021.12.01-2024.11.30	1,260.06	员工宿舍	是

序号	承租人	出租人	承租房产坐落	租赁期限	面积（m^2）	租赁用途	是否备案
9		合肥蓝科投资有限公司	合肥综合保税区仓库厂房一期项目房屋 G 幢二层 201 室	2023.09.10-2024.09.09	2,551.25	仓库	否
10			合肥综合保税区仓库厂房一期项目房屋 G 幢一层 101 室	2024.01.02-2025.01.01	2,241.76	仓库	否
11	江苏汇成	扬州高新技术产业开发区管理委员会	扬州高新区南园生活配套区“青年公寓”二期 13 号公寓 201-216、301-316	2024.04.15-2025.04.14	1,760.00	员工宿舍	是
12			扬州高新区南园生活配套区青年路 3 号（青年公寓）13 幢 4 层、5 层	2023.07.01-2024.06.30	1,718.90	员工宿舍	是
13			扬州高新区南园生活配套区“青年公寓”二期 13 号公寓 601-610	2024.01.01-2024.12.31	550.00	员工宿舍	是

（二）主要无形资产情况

1、商标

截至本募集说明书签署日，公司共拥有 2 项注册商标，具体如下：

序号	权利人	注册号	商标	核定类别	有效期限	取得方式	他项权利
1	汇成股份	51359090		第 9 类	2021.08.07-2031.08.06	原始取得	无
2	江苏汇成	63552394		第 9 类	2022.09.21-2032.09.20	原始取得	无

2、专利

截至 2024 年 5 月 13 日，公司共拥有国内专利 442 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 409 项，专利权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，具体情况参见“附件一、专利”。

3、软件著作权

截至本募集说明书签署日，发行人共拥有 2 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	首次发表日期	著作权保护期限	取得方式	他项权利
1	汇成股份	缺陷检测结果的考核系统 V1.0	2019SR0156112	软著登字第 3576869 号	2018.05.11	首次发表之日起 50 年	原始取得	无

2	汇成股份	排货系统V1.0	2020SR0587316	软著登字第5466012号	2020.03.17	首次发表之日起50年	原始取得	无

注：软件著作权保护期限为首次发表之日起50年。

4、土地使用权

截至本募集说明书签署日，发行人拥有的土地使用权权属清晰，不存在纠纷或潜在纠纷，具体情况如下：

序号	权利人	证书编号	坐落位置	用途	面积（m^2）	使用期限至	他项权利
1	汇成股份	皖（2021）合肥市 不动产权第11223227号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期厂房新建工程1幢厂房101/201/301	工业用地	26,666.69	2067.3.10	无
2		皖（2021）合肥市 不动产权第11223228号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期新建工程仓库101/201				
3		皖（2021）合肥市 不动产权第11223229号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期新建工程门卫101				
4		皖（2021）合肥市 不动产权第11223230号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期新建工程动力楼-101/101/201				
5		皖（2021）合肥市 不动产权第11223231号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期厂房新建工程2幢厂房101/201				
6		皖（2024）合肥市不动产权第1033192号	新站区铜陵北路与项王东路交口西北角	工业用地	38,006.34	2074.1.11	无
7	江苏汇成	扬邗国用（2012）第2012004号	扬州市邗江区经济开发区南园	工业用地	39,821.00	2062.7.30	已抵押

（三）主要经营资质

截至本募集说明书签署日，发行人与生产经营相关的资质情况如下：

1、进出口经营权

序号	证书名称	海关注册编码	核发日期	注册海关	持证人
1	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3401660010	2016.09.23	合肥海关	汇成股份
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3210932605	2015.06.23	扬州海关	江苏汇成

注：发行人上述证书长期有效。

2、高新技术企业证书

序号	公司	证书名称	证书编号	颁发日期	有效期	颁发单位
1	江苏汇成	高新技术企业证书	GR202132011450	2021.12.15	三年	江苏省科学技术厅、财政厅、税务局
2	汇成股份	高新技术企业证书	GR202234004596	2022.10.18	三年	安徽省科学技术厅、财政厅、税务局

3、排污许可证

序号	公司	证书名称	证书编号	颁发日期	有效期至	颁发单位
1	汇成股份	排污许可证	91340100MA2MRF2E6D001Q	2021.11.11	2026.11.10	合肥市生态环境局
2	江苏汇成	排污许可证	91321000581042566E001U	2022.09.27	2027.09.26	扬州市生态环境局

截至本募集说明书签署日，除上述主要业务许可或资质情况，公司取得的管理体系认证情况如下：

序号	公司	证书名称	编号	认证标准	适用产品或服务	有效期
1	汇成股份	环境管理体系认证	EMS 772562	ISO 14001:2015	提供晶圆凸块测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2022.08.19-2025.08.18
2	汇成股份	质量管理体系认证	FM 772603	ISO 9001:2015	提供晶圆凸块制造、研磨、切割、封装及测试服务	2023.09.26-2026.09.25
3	汇成股份	职业健康安全管理体系认证	OHS 734174	ISO 45001:2018	提供晶圆凸块测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2023.12.21-2026.12.20
4	江苏汇成	环境管理体系认证	EMS 772562	ISO 14001:2015	提供晶圆凸块测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2022.08.19-2025.08.18
5	江苏汇成	质量管理体系认证	FM 772604	ISO 9001:2015	提供晶圆凸块制造、研磨、切割、封装及测试服务	2023.09.26-2026.09.25
6	江苏汇成	职业健康安全管理体系认证	OHS 734174	ISO 45001:2018	提供晶圆凸块测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2023.12.21-2026.12.20

十一、上市以来的重大资产重组情况

截至本募集说明书签署日，公司自首次公开发行股票并在科创板上市以来，未发生重大资产重组情况。

十二、境外经营情况

截至本募集说明书签署日，公司未在境外从事生产经营活动。

十三、发行人报告期内的分红情况

（一）股利分配政策

根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等相关法规对于利润分配政策的规定以及《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，公司的利润分配政策如下：

1、利润分配原则

公司的利润分配应兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。在公司具备现金分红条件的情况下，公司应优先采用现金分红进行利润分配。

3、利润分配的时间间隔

原则上公司利润分配的期间间隔为每年进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

4、现金分红条件及比例

在公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告，当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数，且无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司应当进行现金分红，公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：

（1）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；

（2）公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

（3）中国证监会或者证券交易所规定的其他情况。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

5、股票股利分配条件

在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

6、差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，制定以下差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

7、公司年度报告期内满足《公司章程》利润分配及现金分红的条件但董事会未做出利润分配预案或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）低于最低现金分红比例的，公司应当在年报中披露以下事项：

（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；

（2）留存未分配利润的确切用途以及使用计划；

（3）董事会会议的审议和表决情况；

（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立意见。

8、利润分配决策机制

（1）公司制定利润分配政策时，应当履行《公司章程》规定的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究论证，听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见，制定明确、清晰的股东回报规划，并详细说明规划安排的理由等情况。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。

（2）董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经1/2以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。独立董事可以征集中小股东的意见，提出有关制订或修改利润分配政策的提案，并直接提交董事会审议。

（3）公司监事会应当对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过。

（4）股东大会审议制定或修改利润分配政策时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上表决通过，并且相关股东大会

会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东和公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

（5）股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

9、公司年度或中期利润分配方案审议程序

（1）公司董事会在公司利润分配政策范围内提出的年度或中期利润分配预案，应经全体董事过半数表决通过且经二分之一以上独立董事表决通过，独立董事还应对利润分配方案发表独立书面意见；

（2）董事会批准利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会审议利润分配预案时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过；

（3）公司当年满足《公司章程》利润分配及现金分红的条件但不进行分红的，董事会应就不进行分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及使用计划等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后严格按上述程序经董事会审议，并提交股东大会审议；

（4）若公司无特殊原因无法按照《公司章程》规定的现金分红政策及最低现金分红比例确定分红方案或者确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整、变更的，应当经过详细论证、独立董事发表独立意见，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过，公司同时应向股东提供网络投票方式。

10、公司利润分配政策的变更机制

如遇到战争、自然灾害等不可抗力事件，并对公司生产经营造成重大影响，或者公司自身经营状况发生重大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。公司调整利润分配政策，必须由董事会进行专项讨论，详细论证说明理由，独立董事应在董事会召开前发表明确意见。公司应充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。董事会和监事会审议通过利润分配政策修改方案后，提交股东大会并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东大会审议利润分配政策变更事项时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为中小股东和公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

11、利润分配监督约束机制

公司董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。董事会在决策和形成利润分配预案时，需要形成书面记录作为公司档案妥善保存。

12、利润分配的执行及信息披露

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。公司应当严格执行《公司章程》确定的利润分配政策以及股东大会审议批准的利润分配具体方案。确有必要对《公司章程》确定的利润分配政策进行调整或者变更的，应当满足《公司章程》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对相关事项进行专项说明：

（1）是否符合《公司章程》的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。公司董事会未作出现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，独立董事需发表明确意见。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东本应分配的现金股利，以偿还其占用的资金。

（二）发行人最近三年分红情况

2021 年度和 2022 年度，发行人未进行现金分红，主要系发行人处于持续扩产阶段，固定资产投资规模较大，并且为布局新产品需要持续研发投入，需要充

足的资金以保证公司的正常运营与长远发展。

2023 年度，公司拟以股本总数 834,853,281 股为基数，扣减回购专用证券账户中的股数 10,447,004 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 8,244.06 万元（含税），占公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 42.06%，实际分红的股本基数将以利润分配股权登记日登记在册的总股数为准，上述利润分配预案已经 2023 年年度股东大会批准，并已于 2024 年 6 月 6 日发放。

十四、发行人的最近三年发行的债券情况

最近三年内，公司未发行过任何形式的公司债券。截至本募集说明书签署日，公司不存在任何形式的公司债券。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节引用的财务会计数据中，公司 2021 年、2022 年和 2023 年财务会计数据均引自经审计的财务报告。投资者欲对本公司的财务状况、经营成果和现金流量等进行更详细的了解，还应阅读审计报告和财务报告全文，以获取全部的财务资料。

一、会计师事务所的审计意见类型及重要性水平

（一）审计意见类型

公司已聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度的财务报表进行审计，并出具了“天健审〔2022〕278 号”、“天健审〔2023〕2878 号”和“天健审〔2024〕2278 号”无保留意见的审计报告。

天健会计师认为：发行人的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的经营成果和现金流量。

（二）重要性水平

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为当年营业收入金额的 0.5%，或者虽未达到当年营业收入金额的 0.5%，但公司认为较为重要的相关事项。

二、发行人财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
货币资金	11,014.13	12,978.32	4,636.23
交易性金融资产	2,019.23	60,144.17	-
应收账款	23,124.61	10,891.96	17,517.42

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
预付款项	114.33	582.18	288.63
其他应收款	39.47	136.79	19.49
存货	23,699.77	20,568.76	17,063.90
一年内到期的非流动资产	1,044.94	-	-
其他流动资产	4,198.15	12,279.52	7,015.43
流动资产合计	**65,254.63**	**117,581.70**	**46,541.09**
其他非流动金融资产	5,000.00	-	-
固定资产	239,511.30	174,795.26	146,287.78
在建工程	18,068.39	7,797.22	3,259.23
使用权资产	398.31	409.53	-
无形资产	2,574.61	1,773.22	1,711.90
递延所得税资产	373.01	1,788.41	-
其他非流动资产	28,449.43	15,417.91	5,992.01
非流动资产合计	**294,375.06**	**201,981.55**	**157,250.92**
资产总计	**359,629.70**	**319,563.25**	**203,792.02**
短期借款	18,559.36	-	36,760.64
应付票据	399.60	-	-
应付账款	14,132.99	8,362.18	8,406.27
合同负债	290.64	5,037.65	47.11
应付职工薪酬	2,606.78	1,697.63	1,145.71
应交税费	163.02	156.59	76.59
其他应付款	64.74	24.32	36.53
一年内到期的非流动负债	236.17	188.75	2,503.22
其他流动负债	35.29	646.54	-
流动负债合计	**36,488.59**	**16,113.67**	**48,976.08**
长期借款	-	-	5,387.14
租赁负债	126.85	217.71	-
递延收益	9,811.19	11,405.66	10,068.68
递延所得税负债	-	1,455.62	-
非流动负债合计	**9,938.04**	**13,078.99**	**15,455.82**
负债合计	**46,426.63**	**29,192.66**	**64,431.90**
股本	83,485.33	83,485.33	66,788.26
资本公积	213,563.65	210,282.67	93,738.76

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
其他综合收益	-	47.00	-
盈余公积	5,125.59	3,020.85	1,233.81
未分配利润	11,028.50	-6,465.26	-22,400.72
归属于母公司股东权益合计	313,203.07	290,370.59	139,360.11
股东权益合计	**313,203.07**	**290,370.59**	**139,360.11**
负债和股东权益总计	**359,629.70**	**319,563.25**	**203,792.02**

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业收入	**123,829.30**	**93,965.28**	**79,569.99**
二、营业总成本	**106,315.45**	**79,888.49**	**67,173.00**
其中：营业成本	91,077.63	66,978.21	56,001.84
税金及附加	444.67	436.08	228.55
销售费用	840.96	904.06	549.42
管理费用	6,666.60	5,216.50	4,055.28
研发费用	7,885.72	6,514.01	6,060.30
财务费用	-600.12	-160.36	277.62
其中：利息费用	-0.48	873.63	27.17
利息收入	210.23	223.42	83.97
加：其他收益	2,202.13	2,065.51	1,909.22
投资收益（损失以“-”号填列）	1,021.27	266.47	-5.74
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	155.50	-	-5.74
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	424.28	144.17	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-639.70	338.79	-111.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,015.75	-1,440.82	-907.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	335.06	1,473.23	330.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	**19,841.15**	**16,924.14**	**13,612.63**
加：营业外收入	84.63	536.04	423.16
减：营业外支出	367.49	70.48	3.98

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	**19,558.29**	**17,389.70**	**14,031.82**
减：所得税费用	-40.21	-332.80	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	**19,598.50**	**17,722.50**	**14,031.82**
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,598.50	17,722.50	14,031.82
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	19,598.50	17,722.50	14,031.82
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	**-47.00**	**47.00**	**-**
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47.00	47.00	-
七、综合收益总额	**19,551.51**	**17,769.49**	**14,031.82**
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,551.51	17,769.49	14,031.82
八、每股收益			
（一）基本每股收益	0.23	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.24	0.21

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金	111,966.09	111,654.87	78,935.26
收到的税费返还	6,108.08	11,689.65	1,769.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,200.74	4,625.64	4,105.80
经营活动现金流入小计	119,274.91	127,970.16	84,810.83
购买商品、接受劳务支付的现金	64,268.61	50,764.99	41,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,437.69	13,535.38	11,567.06
支付的各项税费	460.19	498.92	269.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,962.45	3,056.70	2,071.18
经营活动现金流出小计	84,128.95	67,855.99	55,270.94
经营活动产生的现金流量净	**35,145.96**	**60,114.17**	**29,539.89**

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
额			
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金	169,800.00	83,000.00	-
取得投资收益收到的现金	1,221.39	200.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589.42	2,316.31	1,041.36
投资活动现金流入小计	171,610.81	85,516.83	1,041.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,819.17	58,261.58	39,632.75
投资支付的现金	107,800.00	165,000.00	-
投资活动现金流出小计	226,619.17	223,261.58	39,632.75
投资活动产生的现金流量净额	**-55,008.35**	**-137,744.76**	**-38,591.39**
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金	-	135,142.95	9,995.28
取得借款收到的现金	18,542.33	38,349.92	52,998.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-	250.00	3,085.00
筹资活动现金流入小计	18,542.33	173,742.87	66,079.05
偿还债务支付的现金	-	82,763.98	46,920.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73.10	1,534.70	1,756.66
支付其他与筹资活动有关的现金	569.63	3,850.68	8,404.15
筹资活动现金流出小计	642.73	88,149.35	57,080.83
筹资活动产生的现金流量净额	**17,899.60**	**85,593.52**	**8,998.22**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	**49.23**	**329.00**	**-262.34**
五、现金及现金等价物净增加额	**-1,913.56**	**8,291.93**	**-315.61**
加：期初现金及现金等价物余额	12,877.43	4,585.50	4,901.11
六、期末现金及现金等价物余额	**10,963.87**	**12,877.43**	**4,585.50**

三、财务报表的编制基础

公司以持续经营假设为基础，按照财政部颁布的《企业会计准则》以及各项

具体会计准则及相关规定编制财务报表。

四、合并财务报表范围及变化情况

（一）子公司情况

单位：万元

公司名称	主营业务	注册资本	持股比例
江苏汇成光电有限公司	从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务	56,164.02	100.00%

（二）报告期内合并财务报表范围变化情况

报告期内，发行人合并财务报表范围未发生变化。

五、公司报告期内的主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标

报告期内，公司主要财务指标如下表：

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.79	7.30	0.95
速动比率（倍）	1.14	6.02	0.60
资产负债率（合并）	12.91%	9.14%	31.62%
资产负债率（母公司）	9.72%	7.48%	26.17%
项目	**2023 年度**	**2022 年度**	**2021 年度**
应收账款周转率（次）	6.92	6.28	4.58
存货周转率（次）	3.95	3.40	3.66
息税折旧摊销前利润（万元）	47,730.24	39,909.84	31,195.48
利息保障倍数（倍）	/	20.91	517.42
每股经营活动现金流量（元）	0.42	0.72	0.44
每股净现金流量（元）	-0.02	0.10	-

注 1：上述财务指标计算公式如下：

（1）流动比率＝流动资产/流动负债

（2）速动比率＝（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

（4）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均余额

（5）存货周转率＝营业成本/存货平均余额

（6）每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
（7）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
（8）利息保障倍数=（利润总额＋利息费用）/利息费用
注 2：2023 年度公司利息费用为负，因此未计算利息保障倍数，下同。

（二）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订），公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

1、加权平均净资产收益率

报告期内，公司加权平均净资产收益率如下表所示：

利润项目	加权平均净资产收益率		
	2023 年度	**2022 年度**	**2021 年度**
归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	6.49	9.19	10.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的加权平均净资产收益率（%）	5.57	6.54	7.17

2、基本每股收益及稀释每股收益

报告期内，公司基本每股收益及稀释每股收益如下表所示：

利润项目	基本每股收益（元/股）			稀释每股收益（元/股）		
	2023 年度	**2022 年度**	**2021 年度**	**2023 年度**	**2022 年度**	**2021 年度**
归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.24	0.21	0.23	0.24	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.17	0.14	0.20	0.17	0.14

注：上述指标的计算公式如下：

1、加权平均净资产收益率=$P_0 \div (E_0+NP \div 2+E_i \times M_i \div M_0-E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P_0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E_0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M_0 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益=$P_0 \div S=P_0 \div (S_0+S_1+S_i \times M_i \div M_0-S_j \times M_j \div M_0-S_k)$

其中：P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S_0 为期初股份总数；S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M_0 报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益=P_1÷（$S_0+S_1+S_i\times M_i\div M_0-S_j\times M_j\div M_0-S_k$+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

（三）公司最近三年一期的非经常性损益明细表

1、注册会计师鉴证的非经常性损益情况

报告期内，公司经天健会计师鉴证后的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	261.96	1,404.61	330.96
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	1,569.16	2,979.05	4,296.13
委托他人投资或管理资产的损益	155.50	77.30	-
债务重组损益	-	-	-5.74
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	1,290.05	333.33	-
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-250.88	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-246.77	70.18	20.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	239.85	-2.92
小计	**2,779.03**	**5,104.33**	**4,638.63**
减：所得税影响数	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	**2,779.03**	**5,104.33**	**4,638.63**
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	**16,819.47**	**12,618.17**	**9,393.19**

2、非经常性损益对经营成果的影响

报告期各期，公司非经常性损益分别为 4,638.63 万元、5,104.33 万元和 2,779.03 万元。公司非经常性损益主要为股份支付、政府补助、非流动资产处置损益和投资收益等。

公司作为从事显示驱动芯片的先进封测业务的领先企业，持续得到政府部门的重点支持。报告期内，计入当期损益的政府补助较多，因此非经常性损益金额较大。

随着公司生产规模逐年扩大，公司自 2021 年起持续盈利，公司经营活动产生的现金流量情况良好，非经常性损益对经营成果的影响逐渐降低。

六、报告期内会计政策变更、会计估计变更和会计差错更正

（一）会计政策变更

1、新租赁准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

3、公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

4、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

5、公司自 2022 年 11 月 30 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

6、公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

7、公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

公司报告期内无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

公司报告期内无会计差错更正事项。

七、适用税率及享受的主要财政税收优惠政策

（一）主要的税种和税率

报告期内，公司适用的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%

税种	计税依据	税率
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%

报告期内，不同纳税主体企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	企业所得税税率		
	2023 年度	2022 年度	2021 年度
汇成股份	15%	15%	15%
江苏汇成	15%	15%	15%

（二）重要税收优惠政策及其依据

1、汇成股份税收优惠

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局公示《关于公布安徽省2019 年第二批高新技术企业认定名单的通知》，汇成股份在 2019 年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201934001917），按税法规定 2019-2021 年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局公示《关于公布安徽省2022 年第一批高新技术企业认定名单的通知》。汇成股份在 2022 年第一批中被认定为高新技术企业（证书编号：GR202234004596），按税法规定 2022-2024年度减按 15%的税率计缴企业所得税。

根据《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、发展改革委、工业和信息化部公告 2020 年第 45 号），国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税〔2023〕17 号)，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。

2、江苏汇成企业税收优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示《关于对江苏省2021年认定的第四批高新技术企业进行备案公示的通知》。江苏汇成在2021年第四批中被认定为高新技术企业（证书编号：GR202132011450），按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》(财税〔2023〕17号)，自2023年1月1日至2027年12月31日，允许集成电路设计、生产、封测、装备、材料企业，按照当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额。

八、财务状况分析

（一）资产结构及变动分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	65,254.63	18.14%	117,581.70	36.79%	46,541.09	22.84%
非流动资产	294,375.06	81.86%	201,981.55	63.21%	157,250.92	77.16%
合计	**359,629.70**	**100.00%**	**319,563.25**	**100.00%**	**203,792.02**	**100.00%**

报告期各期末，公司总资产分别为203,792.02万元、319,563.25万元和359,629.70万元，公司的资产规模随着生产规模的扩大而增加。

报告期各期末，公司流动资产分别为46,541.09万元、117,581.70万元和65,254.63万元，占总资产的比例分别为22.84%、36.79%和18.14%。2022年末，公司流动资产规模较2021年度大幅度增长，主要系公司于2022年下半年完成首次公开发行股票并上市，募集资金的到位使得公司流动资产增加；2023年末，公司流动资产规模2022年度有所降低，主要系公司持续购买机器设备，赎回了较多理财产品所致。

报告期各期末，公司的非流动资产分别为157,250.92万元、201,981.55万元

和 294,375.06 万元，占总资产的比例分别为 77.16%、63.21%和 81.86%。2022 年，随着公司募集资金到位，购买机器设备的支出持续增加，使得 2022 年末和 2023 年末的非流动资产金额较以前年度大幅增加。

1、流动资产分析

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	11,014.13	16.88%	12,978.32	11.04%	4,636.23	9.96%
交易性金融资产	2,019.23	3.09%	60,144.17	51.15%	-	-
应收账款	23,124.61	35.44%	10,891.96	9.26%	17,517.42	37.64%
预付款项	114.33	0.18%	582.18	0.50%	288.63	0.62%
其他应收款	39.47	0.06%	136.79	0.12%	19.49	0.04%
存货	23,699.77	36.32%	20,568.76	17.49%	17,063.90	36.66%
一年内到期的非流动资产	1,044.94	1.60%	-	-	-	-
其他流动资产	4,198.15	6.43%	12,279.52	10.44%	7,015.43	15.07%
合计	**65,254.63**	**100.00%**	**117,581.70**	**100.00%**	**46,541.09**	**100.00%**

报告期各期末，公司流动资产分别为 46,541.09 万元、117,581.70 万元和 65,254.63 万元，主要构成为货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货和其他流动资产等。报告期内，公司流动资产规模整体呈先上升后下降的趋势，2022 年末公司流动资产较 2021 年末有所增长主要系随着公司资本实力的增强和经营规模的扩大，货币资金、交易性金融资产、存货等资产相应有所增加；2023 年末公司流动资产较 2022 年末有所减少主要系公司持续购买机器设备，赎回了较多理财产品。

（1）货币资金

报告期各期末，公司货币资金明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31

	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
库存现金	7.05	0.06	1.70	0.01	3.28	0.07
银行存款	10,956.83	99.48	12,875.73	99.21	4,582.22	98.84
其他货币资金	50.26	0.46	100.88	0.78	50.73	1.09
合计	**11,014.13**	**100.00**	**12,978.32**	**100.00**	**4,636.23**	**100.00**

报告期各期末，公司货币资金余额分别为 4,636.23 万元、12,978.32 万元和 11,014.13 万元，占各期末流动资产比例分别为 9.96%、11.04%和 16.88%。2022 年，公司首次公开发行股票并上市募集资金到账且经营规模持续增长，客户付款情况良好，导致 2022 年末和 2023 年末货币资金规模较 2021 年末有所增加。

（2）交易性金融资产

报告期各期末，公司交易性金融资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,019.23	60,144.17	-
其中：债务工具投资	-	36,049.90	-
权益工具投资	2,019.23	24,094.26	-
合计	**2,019.23**	**60,144.17**	**-**

2022 年末和 2023 年末，公司交易性金融资产金额分别为 60,144.17 万元和 2,019.23 万元。2022 年，公司完成首次公开发行股票并上市，由于募集资金到账且公司经营活动现金持续流入，使得公司资金规模大幅增加。为提高募集资金及自有资金的使用效率，公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司持有的交易性金融资产均为保本型理财产品。

（3）应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
应收账款余额	24,341.70	11,465.22	18,439.39
坏账准备	1,217.08	573.26	921.97

应收账款账面价值	**23,124.61**	**10,891.96**	**17,517.42**
应收账款账面余额占营业收入比例	**19.66%**	**12.20%**	**23.17%**

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为 17,517.42 万元、10,891.96 万元和 23,124.61 万元。2022 年末，公司应收账款余额有所减少，主要系 2022 年度公司预收部分主要客户货款金额较大，导致应收账款期末余额较少；2023 年末，公司应收账款余额增长，主要系 2023 年二季度起显示面板市场需求有所回暖，公司 2023 年下半年销售情况良好导致应收账款期末余额增长。

1）应收账款坏账准备计提情况

报告期内，公司根据新金融工具准则的规定确认应收账款坏账准备，应收账款余额分类情况如下：

单位：万元

类别	2023.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	24,341.70	100.00	1,217.08	5.00	23,124.61
其中：账龄组合	24,341.70	100.00	1,217.08	5.00	23,124.61
合计	**24,341.70**	**100.00**	**1,217.08**	**5.00**	**23,124.61**
类别	**2022.12.31**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	11,465.22	100.00	573.26	5.00	10,891.96
其中：账龄组合	11,465.22	100.00	573.26	5.00	10,891.96
合计	**11,465.22**	**100.00**	**573.26**	**5.00**	**10,891.96**
类别	**2021.12.31**				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备	18,439.39	100.00	921.97	5.00	17,517.42

其中：账龄组合	18,439.39	100.00	921.97	5.00	17,517.42
合计	**18,439.39**	**100.00**	**921.97**	**5.00**	**17,517.42**

2）应收账款按账龄划分

报告期各期末，公司应收账款按账龄组合计提坏账准备的明细如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占比（%）	坏账准备	计提比例（%）
2023.12.31				
1 年以内	24,341.70	100.00	1,217.08	5.00
合计	**24,341.70**	**100.00**	**1,217.08**	**5.00**
2022.12.31				
1 年以内	11,465.22	100.00	573.26	5.00
合计	**11,465.22**	**100.00**	**573.26**	**5.00**
2021.12.31				
1 年以内	18,439.39	100.00	921.97	5.00
合计	**18,439.39**	**100.00**	**921.97**	**5.00**

报告期各期末，公司应收账款均为 1 年以内。公司制定的应收账款坏账计提政策符合公司实际情况，不存在因应收账款金额过大而影响公司持续经营能力的情形。

（4）预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

账龄	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比（%）	金额	占比（%）	金额	占比（%）
1 年以内	114.33	100.00	582.18	100.00	288.63	100.00
合计	**114.33**	**100.00**	**582.18**	**100.00**	**288.63**	**100.00**

报告期各期末，公司预付账款金额分别为 288.63 万元、582.18 万元和 114.33 万元，主要为预付的供应商货款、租金等，占流动资产的比例较低。

（5）其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 19.49 万元、136.79 万元和

39.47 万元，主要为应收设备退货款和押金保证金等，金额较小。

（6）存货

报告期各期末，公司存货结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比（%）
2023.12.31				
原材料	15,128.09	212.28	14,915.82	62.94
在产品	791.07	138.35	652.72	2.75
库存商品	7,986.25	438.96	7,547.29	31.85
发出商品	572.66	30.16	542.50	2.29
低值易耗品	41.45	-	41.45	0.17
合计	**24,519.52**	**819.75**	**23,699.77**	**100.00**
2022.12.31				
原材料	13,049.94	349.30	12,700.63	61.75
在产品	774.89	125.08	649.81	3.16
库存商品	7,526.60	552.68	6,973.92	33.91
发出商品	226.46	18.43	208.03	1.01
低值易耗品	36.37	-	36.37	0.18
合计	**21,614.25**	**1,045.49**	**20,568.76**	**100.00**
2021.12.31				
原材料	12,400.60	439.08	11,961.51	70.10
在产品	690.33	86.12	604.21	3.54
库存商品	4,462.15	173.74	4,288.41	25.13
发出商品	175.30	6.21	169.10	0.99
低值易耗品	40.67	-	40.67	0.24
合计	**17,769.05**	**705.15**	**17,063.90**	**100.00**

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 17,063.90 万元、20,568.76 万元和 23,699.77 万元，占流动资产的比例分别为 36.66%、17.49%和 36.32%。随着公司生产经营规模持续增长，报告期各期末公司存货账面价值整体呈上升趋势。

报告期各期末，公司存货主要由原材料及库存商品构成，原材料账面余额分别为 12,400.60 万元、13,049.94 万元和 15,128.09 万元，库存商品账面余额分别

为 4,462.15 万元、7,526.60 万元和 7,986.25 万元，总体呈上升趋势，主要系随着业务规模扩大，公司整体原材料备货规模和库存规模相应增加。

公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 705.15 万元、1,045.49 万元和 819.75 万元，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
存货账面余额	24,519.52	21,614.25	17,769.05
存货跌价准备	819.75	1,045.49	705.15
存货账面价值	**23,699.77**	**20,568.76**	**17,063.90**
存货跌价准备计提比例	**3.34%**	**4.84%**	**3.97%**

报告期各期末，公司存货跌价准备存在一定规模，存货跌价准备计提比例总体相对平稳，主要系：1）公司原材料中含金成分较高，黄金价格的波动会影响公司账面持有含金原料的市场价值，公司各期末根据黄金价格测算跌价影响；2）2022 年下半年公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，存货跌价准备规模略有增长；2023 年第二季度起，显示面板市场需求有所回暖，公司产品产销量增长，2023 年末存货跌价准备规模随之下降。公司存货跌价准备计提充分，符合《企业会计准则》的有关规定。

（7）一年内到期的非流动资产

2023 年末，公司一年内到期的非流动资产为 1,044.94 万元，系公司持有的一年内到期的大额存单。

（8）其他流动资产

报告期各期末，公司其他流动资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
理财产品	-	12,077.30	-
待抵扣进项税额	4,041.85	202.22	6,676.78
预付 IPO/可转债相关中介费用	142.92	-	256.98

待摊费用	13.38	-	81.67
合计	**4,198.15**	**12,279.52**	**7,015.43**

报告期各期末，公司其他流动资产分别为 7,015.43 万元、12,279.52 万元和 4,198.15 万元。2022 年末，公司其他流动资产中理财产品金额有所增加，主要系公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理购买理财产品所致；其他流动资产中待抵扣进项税额金额大幅减少，主要系公司于 2022 年度收到大额存量留抵税额返还所致；2023 年末，公司其他流动资产中理财产品金额减少主要系部分理财产品到期赎回所致；其他流动资产中待抵扣进项税额金额增加，主要系公司于 2023 年度持续购置机器设备所致。

2、非流动资产分析

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
其他非流动金融资产	5,000.00	1.70%	-	-	-	-
固定资产	239,511.30	81.36%	174,795.26	86.54%	146,287.78	93.03%
在建工程	18,068.39	6.14%	7,797.22	3.86%	3,259.23	2.07%
使用权资产	398.31	0.14%	409.53	0.20%	-	-
无形资产	2,574.61	0.87%	1,773.22	0.88%	1,711.90	1.09%
递延所得税资产	373.01	0.13%	1,788.41	0.89%	-	-
其他非流动资产	28,449.43	9.66%	15,417.91	7.63%	5,992.01	3.81%
非流动资产合计	**294,375.06**	**100.00%**	**201,981.55**	**100.00%**	**157,250.92**	**100.00%**

报告期各期末，公司非流动资产分别为 157,250.92 万元、201,981.55 万元和 294,375.06 万元，主要构成为固定资产、在建工程和其他非流动资产等。报告期内，公司非流动资产规模持续增长，主要系随着业务规模扩大和资本实力增强，公司持续购置专用设备所致。

（1）其他非流动金融资产

2023 年末，公司其他非流动金融资产为 5,000.00 万元，系公司参与设立产

业基金晶汇聚芯形成的权益性投资。

（2）固定资产

1）固定资产构成情况

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
房屋及建筑物	27,295.13	26,799.22	25,548.72
通用设备	839.83	380.28	426.48
专用设备	211,226.02	147,588.56	120,268.42
运输工具	150.33	27.20	44.17
合计	**239,511.30**	**174,795.26**	**146,287.78**

报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 146,287.78 万元、174,795.26 万元和 239,511.30 万元，占非流动资产的比例分别为 93.03%、86.54%和 81.36%，主要由专用设备和房屋及建筑物构成。其中专用设备增长较快，主要系报告期内公司持续购置先进专用设备扩充产能所致。

2）固定资产折旧及减值情况

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
2023.12.31				
房屋及建筑物	38,757.76	11,462.63	-	27,295.13
通用设备	2,253.74	1,413.91	-	839.83
专用设备	303,571.07	92,345.05	-	211,226.02
运输工具	306.59	156.25	-	150.33
合计	**344,889.16**	**105,377.85**	**-**	**239,511.30**
2022.12.31				
房屋及建筑物	36,849.94	10,050.72	-	26,799.22
通用设备	1,617.26	1,236.98	-	380.28
专用设备	215,254.40	67,665.84	-	147,588.56
运输工具	166.67	139.47	-	27.20
合计	**253,888.26**	**79,093.01**	**-**	**174,795.26**
2021.12.31				
房屋及建筑物	34,297.90	8,749.18	-	25,548.72

通用设备	1,494.35	1,067.87	-	426.48
专用设备	169,861.44	49,593.03	-	120,268.42
运输工具	182.23	138.07	-	44.17
合计	**205,835.92**	**59,548.15**	**-**	**146,287.78**

公司于资产负债表日对各项固定资产进行减值测试，经测试未发现减值迹象，未计提减值准备。

（3）在建工程

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 3,259.23 万元、7,797.22 万元和 18,068.39 万元，占非流动资产的比例分别为 2.07%、3.86%和 6.14%，均为在安装设备。报告期内，公司持续扩产并购置专用设备，部分专用设备于报告期末尚处于安装调试阶段。公司在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

（4）使用权资产

公司于 2021 年起适用新租赁准则，将租赁的房屋及建筑物确认为使用权资产。2022 年末和 2023 年末，发行人使用权资产账面价值分别为 409.53 万元和 398.31 万元，占非流动资产的比例较低。

（5）无形资产

报告期各期末，公司无形资产情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
土地使用权	1,434.54	1,469.22	1,503.90
软件	1,140.07	304.00	208.01
合计	**2,574.61**	**1,773.22**	**1,711.90**

报告期各期末，公司无形资产账面价值分别为 1,711.90 万元、1,773.22 万元和 2,574.61 万元，占非流动资产的比例分别为 1.09%、0.88%和 0.87%，主要为土地使用权和软件。2023 年末，公司无形资产账面价值较 2022 年末有所增长，主要系 2023 年度公司购置软件金额较大所致。报告期各期末，公司土地使用权不存在减值迹象，故未计提减值准备。

（6）递延所得税资产

2022 年末和 2023 年末，公司递延所得税资产主要系可抵扣亏损和递延收益等原因所致，占非流动资产的比例较小。

（7）其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
大额存单	12,449.34	10,047.00	-
预付设备工程款	15,005.33	5,245.17	5,791.87
预付软件款	694.76	125.74	200.14
预付土地出让款	300.00	-	-
合计	**28,449.43**	**15,417.91**	**5,992.01**

报告期各期末，公司其他非流动资产账面价值分别为 5,992.01 万元、15,417.91 万元和 28,449.43 万元，占非流动资产的比例分别为 3.81%、7.63%和 9.66%，主要为预付的高端测试机、探针台等专用设备款和购买的大额存单等。2022 年末和 2023 年末，公司其他非流动资产中大额存单金额有所增加，主要系公司对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理购买大额存单所致；2023 年末，公司其他非流动资产中预付设备工程款金额大幅增加，主要系公司为扩充产能而预付供应商设备款金额增加所致。

（二）负债结构及变动分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	36,488.59	78.59%	16,113.67	55.20%	48,976.08	76.01%
非流动负债	9,938.04	21.41%	13,078.99	44.80%	15,455.82	23.99%
合计	**46,426.63**	**100.00%**	**29,192.66**	**100.00%**	**64,431.90**	**100.00%**

报告期各期末，公司负债总额分别为 64,431.90 万元、29,192.66 万元和 46,426.63 万元。2022 年末，公司负债金额大幅减少，主要系 2022 年公司完成首

次公开发行股票并上市，使用募集的补流资金归还全部银行借款所致；2023 年末，公司负债金额有所增加，主要系公司持续购置机器设备进行扩产，基于资金需求新增银行借款所致。

1、流动负债分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
短期借款	18,559.36	50.86%	-	-	36,760.64	75.06%
应付票据	399.60	1.10%	-	-	-	-
应付账款	14,132.99	38.73%	8,362.18	51.89%	8,406.27	17.16%
合同负债	290.64	0.80%	5,037.65	31.26%	47.11	0.10%
应付职工薪酬	2,606.78	7.14%	1,697.63	10.54%	1,145.71	2.34%
应交税费	163.02	0.45%	156.59	0.97%	76.59	0.16%
其他应付款	64.74	0.18%	24.32	0.15%	36.53	0.07%
一年内到期的非流动负债	236.17	0.65%	188.75	1.17%	2,503.22	5.11%
其他流动负债	35.29	0.10%	646.54	4.01%	-	-
流动负债合计	**36,488.59**	**100.00%**	**16,113.67**	**100.00%**	**48,976.08**	**100.00%**

公司流动负债主要由短期借款、应付账款、合同负债、应付职工薪酬和一年内到期的非流动负债等组成。

（1）短期借款

报告期各期末，公司短期借款明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
保证借款	-	-	14,096.38
抵押及保证借款	-	-	22,451.40
信用借款	18,542.33	-	-
应付利息	17.03	-	212.86

合计	**18,559.36**	**-**	**36,760.64**

2021 年末和 2023 年末，公司短期借款余额分别为 36,760.64 万元和 18,559.36 万元，主要由保证借款、抵押及保证借款和信用借款等构成。2022 年，公司使用首次公开发行募集的补流资金归还全部银行借款，2022 年末公司无短期借款余额；2023 年，公司持续购置机器设备进行扩产，基于资金需求新增信用借款，导致 2023 年末短期借款余额有所增加。

（2）应付票据

2023 年末，公司应付票据余额为 399.60 万元，系公司开具的信用证，占流动负债的比例较小。

（3）应付账款

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 8,406.27 万元、8,362.18 万元和 14,132.99 万元，占各期末流动负债的比例分别为 17.16%、51.89%和 38.73%。报告期各期末，公司应付账款主要为应付材料货款及设备工程款。2021 年起，公司为满足生产需求持续购置设备扩产，期末应付设备工程款保持较高水平，2023 年下半年，公司开始逐步建设本次发行募投项目，导致 2023 年末应付设备工程款金额进一步增加。

（4）合同负债

根据新收入准则，自 2020 年 1 月 1 日起，公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。报告期各期末，公司合同负债期末余额分别为 47.11 万元、5,037.65 万元和 290.64 万元，占流动负债的比例分别为 0.10%、31.26%和 0.80%。2022 年末，公司合同负债金额有所增长，主要系 2022 年度上半年行业景气度较好，公司部分主要客户为预先锁定公司产能，向公司预付了部分货款所致。

（5）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬分别为 1,145.71 万元、1,697.63 万元和 2,606.78 万元，占各期末流动负债的比例分别为 2.34%、10.54%和 7.14%。公司应付职工薪酬主要为应付职工的工资、奖金、津贴、补贴及福利费等，总体呈上

涨趋势，系公司人员数量随公司业务发展而增加；2022 年末和 2023 年末公司应付职工薪酬余额较大，主要系截至期末已计提未发放的年终奖金金额较大所致。

（6）应交税费

报告期各期末，公司应交税费分别为 76.59 万元、156.59 万元和 163.02 万元，占各期末流动负债的比例较低，主要由应交房产税、代扣代缴个人所得税、增值税和印花税等构成。

（7）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款分别为 36.53 万元、24.32 万元和 64.74 万元，金额较小，主要为押金保证金等。

（8）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债余额分别为 2,503.22 万元、188.75 万元和 236.17 万元，占流动负债的比例分别为 5.11%、1.17%和 0.65%，主要为一年内到期的长期借款、长期应付款和租赁负债。2021 年起，公司持续进行股权融资并优化负债结构，2022 年公司完成首次公开发行，使用募集的补流资金归还全部银行借款，一年内到期的非流动负债金额大幅下降。

（9）其他流动负债

2022 年末和 2023 年末，公司其他流动负债金额分别为 646.54 万元和 35.29 万元，占流动负债的比例较低，均系待转销项税额。

2、非流动负债分析

报告期各期末，公司非流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
长期借款	-	-	-	-	5,387.14	34.86%
租赁负债	126.85	1.28%	217.71	1.66%	-	-
递延收益	9,811.19	98.72%	11,405.66	87.21%	10,068.68	65.14%

递延所得税负债	-	-	1,455.62	11.13%	-	-
合计	**9,938.04**	**100.00%**	**13,078.99**	**100.00%**	**15,455.82**	**100.00%**

公司非流动负债主要由长期借款、递延收益和递延所得税负债等组成。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款明细情况如下：

单位：万元

项目	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
保证借款	-	-	4,150.00
抵押、质押及保证借款	-	-	1,231.68
应付利息	-	-	5.46
合计	-	-	**5,387.14**

2021 年末，公司长期借款余额为 5,387.14 万元，占非流动负债的比例为 34.86%。2022 年度，公司使用首次公开发行募集的补流资金偿还了全部银行贷款，导致 2022 年末和 2023 年末公司无长期借款余额。

（2）租赁负债

2021 年起，公司执行新租赁准则，2022 年末和 2023 年末公司租赁负债分别为 217.71 万元和 126.85 万元。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益金额分别为 10,068.68 万元、11,405.66 万元和 9,811.19 万元，占非流动负债的比例分别为 65.14%、87.21%和 98.72%，均为与资产相关的政府补助。

（4）递延所得税负债

2022 年末，公司递延所得税负债主要系固定资产折旧税法与会计准则差异所致。

（三）偿债能力分析

报告期内，公司与偿债有关的财务指标如下表：

财务指标	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	1.79	7.30	0.95
速动比率（倍）	1.14	6.02	0.60
资产负债率（合并）	12.91%	9.14%	31.62%
财务指标	**2023 年度**	**2022 年度**	**2021 年度**
息税折旧摊销前利润（万元）	47,730.24	39,909.84	31,195.48
利息保障倍数（倍）	/	20.91	517.42
经营活动产生的现金流量净额（万元）	35,145.96	60,114.17	29,539.89

1、偿债能力指标分析

2022 年末，公司流动比率和速动比率较 2021 年度大幅增长，资产负债率大幅下降，主要系：一方面，发行人完成首次公开发行，使用首次公开发行募集的补流资金归还全部银行借款，流动负债规模下降；另一方面，公司收入持续增长，下游客户回款良好，流动资产有所增长；2023 年末，公司流动比率和速动比率较 2022 年度有所降低，资产负债率有所上升，主要系 2023 年公司持续购置机器设备进行扩产，货币资金及交易性金融资产余额有所减少，导致流动资产规模下降，且公司基于资金需求新增短期银行借款，导致流动负债有所增加。

报告期内，公司盈利能力较强，息税折旧摊销前利润分别为 31,195.48 万元、39,909.84 万元和 47,730.24 万元，整体呈上升趋势。

2021 年度和 2022 年度，公司利息保障倍数分别为 517.42 倍和 20.91 倍。2021 年起，随着公司资本结构不断优化，盈利能力稳步提升，公司利润可以较好地覆盖公司的利息支出，付息能力较强；2023 年，由于公司收到财政贴息 110.22 万元冲减财务费用导致利息支出为负，因此未计算利息保障倍数。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 29,539.89 万元、60,114.17 万元和 35,145.96 万元。报告期内，公司经营规模持续扩大，公司经营活动产生的现金流量情况良好；2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较大，主要系公司收到退回的留抵进项税额以及客户为锁定产能预付的货款金额较大所致。

综上所述，公司盈利能力较强，具有较好的偿债能力。

2、偿债能力同行业比较分析

报告期内，公司偿债能力与同行业对比如下：

指标	公司	2023.12.31	2022.12.31	2021.12.31
流动比率（倍）	颀中科技	3.06	1.76	1.87
	通富微电	0.94	0.96	0.89
	利扬芯片	0.87	1.51	2.42
	晶方科技	5.69	5.90	7.36
	气派科技	0.43	0.62	0.91
	颀邦科技	2.45	1.99	1.74
	南茂科技	3.42	2.90	2.30
	平均值	2.41	2.23	2.50
	发行人	**1.79**	**7.30**	**0.95**
速动比率（倍）	颀中科技	2.65	1.26	1.33
	通富微电	0.70	0.70	0.69
	利扬芯片	0.82	1.42	2.26
	晶方科技	5.46	5.64	6.92
	气派科技	0.29	0.44	0.74
	颀邦科技	2.08	1.70	1.54
	南茂科技	3.06	2.37	1.83
	平均值	2.15	1.93	2.19
	发行人	**1.14**	**6.02**	**0.60**
资产负债率（合并口径，%）	颀中科技	18.50	33.17	34.10
	通富微电	57.87	59.13	59.33
	利扬芯片	45.26	35.84	16.61
	晶方科技	14.56	12.36	11.58
	气派科技	60.03	50.24	45.72
	颀邦科技	11.09	19.75	22.54
	南茂科技	46.16	44.79	42.65
	平均值	36.21	36.47	33.22
	发行人	**12.91**	**9.14**	**31.62**

注：同行业可比公司数据均取自于公开披露数据。

2021 年，公司通过短期借款等方式筹措资金用于购置专用设备进行扩产，

导致流动比率和速动比率低于同行业平均水平；2022 年，公司完成首次公开发行，使用募集的补流资金归还了全部银行借款，使得公司 2022 年末的偿债能力优于同行业可比公司平均水平。2023 年，公司流动比率和速动比率有所下降，低于同行业可比公司平均水平，主要系 2023 年公司持续购置机器设备进行扩产，货币资金及交易性金融资产余额有所减少，导致流动资产规模下降，且公司基于资金需求新增短期银行借款，导致流动负债有所增加。

（四）营运能力分析

报告期内公司主要营运能力指标如下：

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	6.92	6.28	4.58
存货周转率（次）	3.95	3.40	3.66

1、营运能力指标分析

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率总体情况良好，存货周转率指标较为稳定。2022 年度和 2023 年度公司应收账款周转率有所提升，主要系 2022 年度公司部分主要客户为锁定公司产能预付部分货款，导致应收账款期末余额相对减少所致。

2、营运能力同行业比较分析

报告期内，公司营运能力与同行业对比如下：

指标	公司	2023 年度	2022 年度	2021 年度
应收账款周转率（次）	颀中科技	13.43	10.60	9.10
	通富微电	5.13	6.10	7.60
	利扬芯片	3.17	3.65	4.65
	晶方科技	9.75	11.64	12.25
	气派科技	4.83	4.72	6.99
	颀邦科技	4.65	4.42	4.95
	南茂科技	4.40	4.38	4.68
	平均值	6.48	6.50	7.17
	发行人	**6.92**	**6.28**	**4.58**

存货周转率（次）	颀中科技	2.65	2.31	2.92
	通富微电	5.75	6.36	6.99
	利扬芯片	15.29	12.41	14.31
	晶方科技	3.49	3.81	5.25
	气派科技	5.06	4.37	5.78
	颀邦科技	8.59	9.72	12.75
	南茂科技	5.87	5.60	7.31
	平均值	6.67	6.37	7.90
	发行人	**3.95**	**3.40**	**3.66**

注：同行业可比公司数据均取自于公开披露数据。

2021 年度，公司应收账款周转率低于同行业平均水平，但与境外同行业可比公司接近；2022 年和 2023 年，公司部分主要客户为锁定公司产能预付了部分货款，公司 2022 年末应收账款余额有所下降，公司应收账款周转率有所提升，接近同行业可比公司平均水平。

报告期内，公司存货周转率处于同行业可比公司区间内，低于同行业可比公司平均水平，主要系：一方面，利扬芯片仅从事测试业务，主营业务成本主要由机器设备折旧、直接人工和制造费用组成，原材料使用量较少，存货周转率远高于同行业可比公司；另一方面，中国台湾同行业可比公司颀邦科技和南茂科技以完工进度确认收入，确认收入的同时相应结转成本，期末存货主要为原物料，收入确认方式不同导致其存货余额相对较少，存货周转率较高。

（五）财务性投资分析

1、公司最近一期末的财务性投资情况

截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，发行人持有的财务性投资金额均为 5,000.00 万元，拟持有的财务性投资金额为 130.00 万元，系公司参与设立产业基金形成的权益性投资，具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“3、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资”。

截至 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日，公司已持有和拟持有的财务性投资金额合计均为 5,130.00 万元，占 2023 年 12 月 31 日和 2024 年 3 月 31 日

公司合并报表归属于母公司净资产的比例分别为 1.64%和 1.66%，占比较小，不存在已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十的情形，公司最近一期末不存在金额较大的财务性投资。

2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资

（1）2023 年末

截至 2023 年末，公司持有的金融产品具体情况如下：

单位：万元

序号	机构名称	产品名称	类型	起息日/受让日	到期日	本金余额
1	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 10 期浮动收益凭证	本金保障型	2023/6/19	2024/1/4	2,000.00
2	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2024/8/25	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/6/10	5,000.00
4	杭州银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2023/1/18	2025/6/24	3,000.00
5	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/7/7	3,000.00
6	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2025/7/28	1,000.00
合计						**15,000.00**

如上表所示，截至 2023 年末发行人持有的金融产品风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，不属于财务性投资。

（2）2024 年 3 月末

截至 2024 年 3 月末，公司持有的金融产品具体情况如下：

单位：万元

序号	机构名称	产品名称	类型	起息日/受让日	到期日	本金余额
1	国元证券股份有限公司	国元证券元聚利 52 期浮动收益凭证	本金保障型	2024/3/25	2024/6/25	2,000.00
2	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2024/8/25	1,000.00
3	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/6/10	5,000.00
4	杭州银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2023/1/18	2025/6/24	3,000.00

5	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/11/23	2025/7/7	3,000.00
6	兴业银行股份有限公司	可转让大额存单	保本固定收益型	2022/9/30	2025/7/28	1,000.00
合计						**15,000.00**

如上表所示，截至 2024 年 3 月末发行人持有的金融产品风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，不属于财务性投资。

3、自本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资

发行人本次发行的董事会决议日为 2023 年 6 月 16 日，决议日前六个月至本募集说明书签署日，公司已实施或拟实施的财务性投资为 5,130.00 万元，具体情况如下：

2023 年 11 月 1 日，发行人召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过《关于对外投资参与设立产业基金的议案》，发行人作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯出资人民币 5,000 万元，并作为有限合伙人以自有资金认缴晶汇聚芯普通合伙人晶合汇信出资人民币 130 万元。基于谨慎性原则，发行人已将前述合计 5,130.00 万元投资认定为本次发行相关董事会决议日前六个月至今新增的财务性投资。经发行人第一届董事会第二十二次会议审议，前述财务性投资金额 5,130.00 万元已从本次募集资金总额中扣除。截至 2023 年末和 2024 年 3 月末，公司认缴的晶汇聚芯出资额 5,000.00 万元已全部实缴，认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元尚未实缴；截至本募集说明书签署日，前述认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元已全部实缴。

4、可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表项目情况

截至 2024 年 3 月 31 日，公司可能涉及财务性投资（包括类金融业务）的相关报表项目情况如下：

单位：万元

序号	科目	截至 2024 年 3 月 31 日账面价值
1	交易性金融资产	2,002.15
2	其他应收款	49.29

3	其他流动资产	7,738.10
4	一年内到期的非流动资产	1,053.89
5	其他非流动金融资产	5,000.00
6	其他非流动资产	25,316.33

（1）交易性金融资产

截至 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产账面价值为 2,002.15 万元，均系公司购买的本金保障型金融产品，具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资”之“（2）2024 年 3 月末”之序号 1 的金融产品。相关金融产品主要投资范围为银行存款和衍生金融工具，衍生金融工具包括但不限于商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。截至 2024 年 3 月末发行人持有的金融产品均为挂钩利率、商品价格等金融市场指标的产品，风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，因此不属于财务性投资。

（2）其他应收款

截至 2024 年 3 月末，公司其他应收款具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	是否属于财务性投资	说明
押金保证金	100.19	否	生产经营相关
减：坏账准备	50.90	/	/
合计	**49.29**	**/**	**/**

截至 2024 年 3 月末，公司其他应收款账面价值为 49.29 万元，主要系押金保证金等，不属于财务性投资。

（3）其他流动资产

截至 2024 年 3 月末，公司其他流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	是否属于财务性投资	说明
待抵扣进项税额	7,560.26	否	生产经营相关
预付可转债中介费用	142.92	否	本次发行相关

待摊租赁费	34.92	否	生产经营相关
合计	**7,738.10**	/	/

截至 2024 年 3 月末，公司其他流动资产账面价值为 7,738.10 万元，主要系待抵扣进项税额、预付可转债中介费用和待摊租赁费等，不属于财务性投资。

（4）一年内到期的非流动资产

截至 2024 年 3 月末，公司一年内到期的非流动资产账面价值为 1,053.89 万元，系公司购买的将于一年内到期的可转让大额存单，具体情况参见本节之“八、财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资”之“（2）2024 年 3 月末”之序号 2 的金融产品，风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，因此不属于财务性投资。

（5）其他非流动金融资产

2024 年 3 月末，公司其他非流动金融资产为 5,000.00 万元，系公司参与设立产业基金晶汇聚芯形成的权益性投资。截至 2024 年 3 月末，公司认缴的晶汇聚芯出资额 5,000.00 万元已全部实缴，认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元尚未实缴；截至本募集说明书签署日，前述认缴的晶合汇信出资额 130.00 万元已全部实缴。前述合计 5,130.00 万元投资属于财务性投资。

（6）其他非流动资产

截至 2024 年 3 月末，公司其他非流动资产具体情况如下：

单位：万元

项目	金额	是否属于财务性投资	说明
大额存单	12,553.16	否	金融产品，风险性较小
预付设备工程款	12,655.54	否	生产经营相关
预付软件款	107.63	否	生产经营相关
合计	**25,316.33**	/	/

截至 2024 年 3 月末，公司其他非流动资产账面价值为 25,316.33 万元，主要系大额存单、预付设备工程款和预付软件款等。其中，预付设备工程款和预付软件款均为生产经营相关，不属于财务性投资；大额存单的具体情况参见本节之“八、

财务状况分析”之“（五）财务性投资分析”之“2、公司最近一期末持有的金融产品不属于财务性投资”之“（2）2024 年 3 月末”之序号 3-6 的金融产品，风险性较小，不属于购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形，因此不属于财务性投资。

九、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占收入比	金额	占收入比	金额	占收入比
营业收入	123,829.30	100.00%	93,965.28	100.00%	79,569.99	100.00%
营业成本	91,077.63	73.55%	66,978.21	71.28%	56,001.84	70.38%
营业利润	19,841.15	16.02%	16,924.14	18.01%	13,612.63	17.11%
利润总额	19,558.29	15.79%	17,389.70	18.51%	14,031.82	17.63%
净利润	19,598.50	15.83%	17,722.50	18.86%	14,031.82	17.63%

（一）营业收入分析

1、营业收入构成

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	116,845.37	94.36%	88,438.82	94.12%	76,593.90	96.26%
其他业务收入	6,983.94	5.64%	5,526.46	5.88%	2,976.09	3.74%
合计	**123,829.30**	**100.00%**	**93,965.28**	**100.00%**	**79,569.99**	**100.00%**

公司主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务。报告期内，公司主营业务收入分别为 76,593.90 万元、88,438.82 万元和 116,845.37 万元，占营业收入的比例均在 90%以上，主营业务突出。公司其他业务收入主要系出售含金废液等所产生的收入，占营业收入的比例较低。

报告期内，公司主营业务收入持续增长，主要原因如下：

（1）境内显示面板的高速发展及显示驱动芯片产业向境内的转移推动公司收入增长

随着国家产业政策的扶持鼓励以及终端应用领域的需求提升，境内显示面板行业实现了高速发展。受益于此，境内显示驱动芯片及其封装测试需求相应增长。

此外，显示驱动芯片的引脚众多且排列紧密，对封装测试的技术要求也更高，金凸块制造技术实现了“以点代线”的技术跨越，可以显著提高产品性能。公司是中国境内较早具备金凸块制造能力并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，拥有合肥与扬州两座封测基地，随着全球显示驱动芯片产业逐渐向境内转移，公司报告期内的收入增长迅速。

（2）公司 12 吋封装测试服务持续扩产迎合客户需求，订单快速增长

报告期内，公司 12 吋封装测试服务持续扩产，收入增长迅速。由于 12 吋晶圆较 8 吋晶圆具备更高的经济效益，下游客户对 12 吋晶圆的需求快速增长，但其对生产工艺、产品良率管理的要求也更高。公司凭借稳定可控的 12 吋晶圆加工良率与优质的服务能力，12 吋晶圆封测服务订单快速增长。

（3）集成电路产业集聚优势带来公司收入规模攀升

报告期内，合肥封测基地凭借集成电路产业集聚优势，收入规模攀升。一方面，合肥封测基地与部分客户所合作的晶圆制造商同位于合肥产业集聚群，对显示驱动芯片设计公司而言，封测厂商靠近晶圆制造厂可以缩短晶圆从制造厂到封装测试厂的交付周期、降低生产运输成本；另一方面，公司可以提供 12 吋晶圆的封测全制程统包服务，能提高封装测试环节的生产效率，缩短交付周期。

2、主营业务收入产品构成及分析

报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例

显示驱动芯片	116,845.37	100.00%	88,438.82	100.00%	76,593.90	100.00%
合计	**116,845.37**	**100.00%**	**88,438.82**	**100.00%**	**76,593.90**	**100.00%**

公司对客供晶圆在完成客户约定的工艺制程并交付后确认收入。其中，主营业务收入若按工艺制程划分，可分属于金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装。公司的四个工艺制程实质上是四项独立的业务，公司根据四个制程进行独立核算。报告期内，公司主营业务收入按工艺制程划分的具体情况如下：

单位：万元

工艺制程	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	53,459.55	45.75%	41,032.11	46.40%	33,138.84	43.27%
CP	31,452.66	26.92%	25,095.22	28.38%	19,690.71	25.71%
COG	14,861.05	12.72%	11,333.52	12.82%	9,295.91	12.14%
COF	17,072.11	14.61%	10,977.97	12.41%	14,468.45	18.89%
合计	**116,845.37**	**100.00%**	**88,438.82**	**100.00%**	**76,593.90**	**100.00%**

公司以提供显示驱动芯片的全制程统包服务为目标。报告期内，公司围绕核心工序金凸块制造形成了完整的封装测试体系，带动公司主营业务收入持续增长。

3、主营业务收入按照销售区域划分

报告期内，公司主营业务收入的地区构成情况如下：

单位：万元

区域	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	**44,432.24**	**38.03%**	**31,871.18**	**36.04%**	**18,750.60**	**24.48%**
华东地区	17,991.78	15.40%	10,061.88	11.38%	11,887.41	15.52%
华南地区	14,586.47	12.48%	13,866.58	15.68%	6,466.87	8.44%
其他地区	11,853.98	10.15%	7,942.72	8.98%	396.33	0.52%
境外	**72,413.13**	**61.97%**	**56,567.64**	**63.96%**	**57,843.30**	**75.52%**
中国台湾	70,615.76	60.44%	52,994.11	59.92%	52,703.36	68.81%
中国香港	1,797.36	1.54%	3,573.53	4.04%	5,139.94	6.71%
合计	**116,845.37**	**100.00%**	**88,438.82**	**100.00%**	**76,593.90**	**100.00%**

注：境内外划分以直接交易客户注册地址的境内外归属作为标准。

报告期内，公司主要客户大多为中国台湾地区的知名显示驱动芯片设计公司，境外客户实现主营业务收入分别为 57,843.30 万元、56,567.64 万元和 72,413.13 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 75.52%、63.96%和 61.97%；2022 年起，公司境外客户收入占比有所下降，主要系公司报告期内天德钰、爱协生、集创北方等中国大陆地区客户需求增加，销售规模持续增长。

4、主营业务收入季节性波动情况

报告期内，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
第一季度	23,197.66	19.85%	22,179.02	25.08%	15,202.50	19.85%
第二季度	28,884.92	24.72%	21,430.53	24.23%	19,785.31	25.83%
第三季度	32,074.32	27.45%	23,286.31	26.33%	20,649.64	26.96%
第四季度	32,688.47	27.98%	21,542.96	24.36%	20,956.45	27.36%
合计	**116,845.37**	**100.00%**	**88,438.82**	**100.00%**	**76,593.90**	**100.00%**

2021 年度和 2023 年度，公司收入存在季节性变动，第三、四季度收入占比高，主要系受终端行业需求和生产周期的影响。一方面，公司所封装测试的显示驱动芯片主要应用于日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品，上述终端产品的需求旺季集中在第四季度与次年的第一季度；另一方面，受春节假期等因素影响，显示驱动设计公司一般会安排在第三、四季度提前备货生产以保证供应稳定，相应带动显示驱动芯片的封装测试需求。2022 年度，公司第四季度收入占比较低，主要系 2022 年下半年至 2023 年一季度，受全球经济下行影响，智能手机、高清电视等终端应用市场消费需求有所下滑所致。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	85,101.81	93.44%	61,743.70	92.18%	53,131.91	94.88%
其他业务成本	5,975.82	6.56%	5,234.51	7.82%	2,869.93	5.12%
合计	**91,077.63**	**100.00%**	**66,978.21**	**100.00%**	**56,001.84**	**100.00%**

注：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将与合同履约直接相关的运费与保险费计入成本，报表列示为营业成本，本节营业成本分析均包含运费与保险费。

报告期内，公司主营业务成本分别为 53,131.91 万元、61,743.70 万元和 85,101.81 万元，占营业成本的比例均在 90%以上，与主营业务收入结构匹配。

2、主营业务成本产品构成及分析

报告期内，公司主营业务成本均为显示驱动芯片封装测试的成本，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
显示驱动芯片	85,101.81	100.00%	61,743.70	100.00%	53,131.91	100.00%
合计	**85,101.81**	**100.00%**	**61,743.70**	**100.00%**	**53,131.91**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本按工艺制程划分情况如下：

单位：万元

工艺制程	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	40,867.25	48.02%	30,146.08	48.82%	27,149.95	51.10%
CP	20,786.51	24.43%	14,095.45	22.83%	10,512.03	19.78%
COG	11,921.94	14.01%	8,591.49	13.91%	6,542.25	12.31%
COF	11,526.11	13.54%	8,910.68	14.43%	8,927.69	16.80%
合计	**85,101.81**	**100.00%**	**61,743.70**	**100.00%**	**53,131.91**	**100.00%**

报告期内，随着公司业务规模持续增长，各工艺制程的成本整体呈上涨趋势。报告期内，金凸块制造成本占比分别为 51.10%、48.82%和 48.02%，占比较高，主要系金凸块制造工序主要原材料为含金原料，含金原料价值较高导致直接材料

成本较高。

3、主营业务成本构成分析

报告期内，公司主营业务成本构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
直接材料	38,269.33	44.97%	26,958.12	43.66%	25,052.10	47.15%
直接人工	11,430.82	13.43%	8,227.16	13.32%	7,220.44	13.59%
制造费用	34,355.78	40.37%	25,730.49	41.67%	19,930.07	37.51%
运费保险费	1,045.87	1.23%	827.93	1.34%	929.30	1.75%
合计	**85,101.81**	**100.00%**	**61,743.70**	**100.00%**	**53,131.91**	**100.00%**

报告期内，公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运费保险费构成，其中直接材料和制造费用占主营业务成本的比例合计超过 80%，是最主要的构成部分。

报告期内，公司直接材料成本分别为 25,052.10 万元、26,958.12 万元和 38,269.33 万元。公司的直接材料成本主要来自于金凸块制造环节，直接材料主要包括含金原料（含金电镀液、金盐和金靶等）、Tray 盘和光刻胶等。直接材料占主营业务成本比例高，主要系金凸块制造使用的含金原料价值较高所致。

报告期内，公司直接人工分别为 7,220.44 万元、8,227.16 万元和 11,430.82 万元。报告期内，随着公司业务规模增长，公司为满足生产需求招聘生产人员，直接人工金额持续增长。

报告期内，公司制造费用分别为 19,930.07 万元、25,730.49 万元和 34,355.78 万元。报告期内，公司制造费用金额持续增长，主要系公司为扩充产能，持续购置生产设备，折旧规模不断增加所致。

报告期内，公司运费保险费分别为 929.30 万元、827.93 万元和 1,045.87 万元，2022 年运费保险费金额有所下降主要系公司运输至境内的产品占比提升所致，2023 年运费保险费金额随公司业务规模扩张有所增加。

（三）毛利及毛利率分析

1、毛利构成及毛利率情况

报告期内，公司毛利构成及毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
主营业务毛利	31,743.56	27.17%	26,695.12	30.18%	23,462.00	30.63%
其他业务毛利	1,008.12	14.43%	291.96	5.28%	106.16	3.57%
合计	**32,751.68**	**26.45%**	**26,987.07**	**28.72%**	**23,568.16**	**29.62%**

报告期内，公司毛利分别为 23,568.16 万元、26,987.07 万元和 32,751.68 万元，综合毛利率分别为 29.62%、28.72%和 26.45%；其中主营业务毛利分别为 23,462.00 万元、26,695.12 万元和 31,743.56 万元，主营业务毛利率分别为 30.63%、30.18%和 27.17%。

2021 年和 2022 年，公司主营业务毛利率保持较高水平，主要系公司整体产能利用率较高，规模效应导致单位固定成本较低，带动公司主营业务毛利率保持较高水平。2023 年度，公司主营业务毛利率较 2021 年和 2022 年有所下降，主要系 2022 年下半年至 2023 年第一季度，公司产品终端应用市场消费需求有所下滑，销售单价有所降低，而订单饱和度有所下降，单位固定成本有所上升导致；2023 年第二季度起，显示面板市场需求有所回暖，销售单价和订单饱和度情况均已有所好转。

2、主营业务毛利构成及毛利率变化情况

报告期内，公司主营业务毛利均来源于显示驱动芯片封装测试业务，具体情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
显示驱动芯片	31,743.56	27.17%	26,695.12	30.18%	23,462.00	30.63%
合计	**31,743.56**	**27.17%**	**26,695.12**	**30.18%**	**23,462.00**	**30.63%**

报告期内，公司主营业务毛利和毛利率按工艺制程划分情况如下：

单位：万元

工艺制程	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	毛利率	金额	毛利率	金额	毛利率
Gold Bumping	12,592.31	23.55%	10,886.03	26.53%	5,988.89	18.07%
CP	10,666.15	33.91%	10,999.77	43.83%	9,178.69	46.61%
COG	2,939.11	19.78%	2,742.03	24.19%	2,753.66	29.62%
COF	5,545.99	32.49%	2,067.29	18.83%	5,540.76	38.30%
合计	**31,743.56**	**27.17%**	**26,695.12**	**30.18%**	**23,462.00**	**30.63%**

（1）金凸块制造

2021 年至 2022 年，公司金凸块制造业务毛利率有所上升，主要系：一方面，公司 12 吋晶圆金凸块制造业务产能持续扩充，整体产能利用率较高，产销量增长形成的规模效应带动单位固定成本降低，公司高附加值的 12 吋晶圆金凸块制造业务占比有所上升，带动金凸块制造业务毛利率整体有所上升；另一方面，公司生产人员整体熟练度提高，公司对人员结构进行优化，单位人工成本有所降低。

2023 年，公司金凸块制造业务毛利率较 2022 年有所下降，主要系 2023 年度受终端应用市场消费需求下降及黄金价格市场价格有所上涨影响，导致金凸块制造业务单位成本上涨幅度高于销售单价上涨幅度。

（2）晶圆测试

2021 年和 2022 年，公司晶圆测试业务毛利率保持较高水平，主要系：一方面，2021 年和 2022 年客户对封装测试服务需求量较高，同时公司高阶智能手机测试业务占比相对提高，导致公司对主要客户的服务单价有所提高；另一方面，公司的晶圆测试产量较高，规模效应导致 12 吋晶圆测试的单位固定成本较低，公司高附加值的 12 吋晶圆金凸块制造业务占比保持较高水平。

2023 年，公司晶圆测试业务毛利率较 2022 年有所下滑，主要系：公司 2022 年四季度至 2023 年一季度受终端需求波动影响，晶圆测试业务销售单价有所降低；此外，公司晶圆测试业务规模效应有所减弱，导致单位固定成本增加，2023 年二季度起，显示面板市场需求有所回暖，晶圆测试业务毛利率有所回升。

（3）玻璃覆晶封装

2022 年，公司玻璃覆晶封装毛利率较 2021 年度小幅降低，主要系 2022 年四季度起，公司玻璃覆晶封装业务量受终端需求影响有所减少，单位固定成本增加导致毛利率降低；2023 年，同样受终端市场消费需求影响，公司玻璃覆晶封装单位固定成本保持较高水平，导致 2023 年玻璃覆晶封装业务毛利率较低。

（4）薄膜覆晶封装

2022 年，受大尺寸显示面板市场景气度波动的影响，公司薄膜覆晶封装业务产销量有所下滑，单位固定成本和单位直接人工成本增加，导致毛利率水平较低。

2023 年，随着大尺寸显示面板市场需求有所回暖，公司薄膜覆晶封装业务产销量有所提升，单位固定成本和单位直接人工成本大幅降低，推动毛利率水平较 2022 年度增长。

3、与可比公司毛利率的比较情况

（1）同行业可比公司的选择依据、选取范围及合理性

公司考虑了行业属性、封测产品种类、技术路径、经营规模、财务数据可比性等因素，基于全面性和可比性原则，选取了集成电路封装测试行业的国内 A 股上市公司颀中科技、通富微电、晶方科技、利扬芯片和气派科技以及境外上市公司颀邦科技和南茂科技作为同行业可比公司。

①颀中科技

颀中科技系专业从事集成电路高端先进封装测试的科创板上市公司，产品覆盖显示驱动芯片、电源管理芯片、射频前端芯片等多类产品，2023 年度主营业务收入为 15.93 亿元。颀中科技业务以显示驱动芯片封测为主，因此公司将其纳入可比范围。

②通富微电

通富微电专业从事集成电路封装测试，在行业内具备知名度，2023 年度其集成电路封装测试业务收入达到 211.35 亿元。同时，目前 A 股上市公司中通富

微电已布局显示驱动芯片金凸块制造业务，因此公司将其纳入可比范围。

③晶方科技

晶方科技专业从事晶圆级芯片封装测试，2023 年度主营业务收入为 9.13 亿元，与公司同属高端先进封装领域，均具备 8 吋与 12 吋晶圆的封装测试能力，因此公司将其纳入可比范围。

④利扬芯片

利扬芯片系专业从事晶圆测试与芯片测试服务的科创板上市公司，能同时提供 8 吋晶圆与 12 吋晶圆的测试服务，2023 年度的主营业务收入为 4.85 亿元。公司同样具备 8 吋与 12 吋晶圆的测试能力，因此公司将其纳入可比范围。

⑤气派科技

气派科技系专业从事集成电路的封装、测试业务的科创板上市公司，其业务范围中亦提供部分显示驱动芯片的封装测试服务，2023 年度的主营业务收入为 5.21 亿元，整体业务规模与公司接近，因此公司将其纳入可比范围。

⑥颀邦科技

颀邦科技为中国台湾上市公司，系全球领先的显示驱动芯片封测厂商，2023 年度的营业收入为 2,005,638.80 万新台币，主要从事凸块制造以及后段封装测试业务，封测产品涵盖显示驱动芯片、功率放大器、射频驱动芯片等半导体元件。其显示驱动芯片封测业务中的金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装与公司业务类似，因此公司将其纳入可比范围。

⑦南茂科技

南茂科技为中国台湾上市公司，系全球领先的显示驱动芯片封测厂商，2023 年度的营业收入为 2,135,622.80 万新台币。主要从事凸块制造以及后段封装测试业务，封测产品涵盖显示驱动芯片、记忆体芯片和逻辑芯片等半导体元件。其显示驱动芯片封测业务中的金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装与公司业务类似，因此公司将其纳入可比范围。

（2）同行业可比公司的毛利率数据比较

报告期内，公司与同行业可比公司的毛利率比较情况如下：

公司名称	主营业务	2023 年度	2022 年度	2021 年度
颀中科技	显示驱动芯片封装测试	36.04%	39.71%	40.76%
通富微电	集成电路封装测试	11.50%	13.58%	16.97%
晶方科技	集成电路封装测试	38.12%	44.11%	52.45%
利扬芯片	集成电路测试	29.93%	37.59%	53.00%
气派科技	集成电路封装测试	-16.94%	1.04%	30.47%
平均值（中国大陆可比公司）		**19.73%**	**27.21%**	**38.73%**
颀邦科技	显示驱动芯片封装测试	25.56%	32.63%	32.32%
南茂科技	显示驱动芯片封装测试	16.62%	20.89%	26.47%
平均值（中国台湾可比公司）		**21.09%**	**26.76%**	**29.40%**
发行人	**显示驱动芯片封装测试**	**27.17%**	**30.18%**	**30.63%**
其中：Gold Bumping		23.55%	26.53%	18.07%
CP		33.91%	43.83%	46.61%
COG		19.78%	24.19%	29.62%
COF		32.49%	18.83%	38.30%

注 1：数据来源于同行业可比公司公开披露数据；

注 2：上表中中国台湾可比公司数据系综合毛利率。

中国大陆同行业可比公司中，公司与通富微电、晶方科技、利扬芯片和气派科技等毛利率存在一定差异，主要系上述同行业可比公司的业务类型与公司的主营业务不完全一致：通富微电除先进封装业务还有较大规模的传统封装业务；晶方科技主要从事 CMOS 影像传感器的封装测试服务；利扬芯片主营晶圆测试与芯片测试服务，不涉及封装业务；气派科技主营业务中传统封装占比较高。

颀中科技专业从事集成电路高端先进封装测试，产品以显示驱动芯片封测为主，与公司具备一定的可比性。报告期内，公司毛利率变化趋势与颀中科技相似，但略低于颀中科技，主要系：一方面，公司高阶产品产能相对较少，且产品结构中毛利率较高的薄膜覆晶封装业务占比较低；另一方面，公司整体业务规模相对颀中科技较小，规模效应相对较弱导致单位成本较高所致。

2021 年，公司毛利率低于中国大陆同行业可比公司平均水平，主要系公司金凸块制造工艺制程占公司主营业务收入比重较高，但其直接材料主要为含金原料，材料成本占比较高，导致该工艺制程毛利率相对较低，从而拉低了公司整体

毛利率。2022 年和 2023 年度，公司毛利率水平高于中国大陆同行业可比公司平均水平，主要系气派科技主营业务中传统封装占比较高，受手机、计算机等终端应用市场需求波动影响较大，叠加其自身募投项目和自有资金扩产等因素，毛利率水平大幅降低所致。

中国台湾的颀邦科技和南茂科技均为全球领先的封测厂商，业务涵盖凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等显示驱动芯片封测服务，与公司具备一定的可比性。报告期内，公司毛利率水平与中国台湾同行业可比公司相近，略高于中国台湾同行业可比公司平均水平，主要系显示驱动芯片封测产业呈现向中国大陆转移的趋势，中国台湾同行业可比公司规模效应有所减弱所致。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用构成如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	840.96	0.68%	904.06	0.96%	549.42	0.69%
管理费用	6,666.60	5.38%	5,216.50	5.55%	4,055.28	5.10%
研发费用	7,885.72	6.37%	6,514.01	6.93%	6,060.30	7.62%
财务费用	-600.12	-0.48%	-160.36	-0.17%	277.62	0.35%
合计	**14,793.16**	**11.95%**	**12,474.21**	**13.28%**	**10,942.62**	**13.75%**

报告期内，公司期间费用合计分别为 10,942.62 万元、12,474.21 万元和 14,793.16 万元，占营业收入的比例分别为 13.75%、13.28%和 11.95%。报告期内，随着公司业务规模扩大，期间费用支出逐年有所增长。

1、销售费用

报告期内，公司销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	423.41	50.35%	510.15	56.43%	344.26	62.66%

股份支付	238.16	28.32%	252.86	27.97%	139.79	25.44%
业务招待费	98.88	11.76%	75.94	8.40%	43.42	7.90%
办公差旅费	59.61	7.09%	27.48	3.04%	18.67	3.40%
其他费用	20.90	2.49%	37.64	4.16%	3.29	0.60%
合计	**840.96**	**100.00%**	**904.06**	**100.00%**	**549.42**	**100.00%**

公司销售费用主要由职工薪酬、股份支付、业务招待费等组成。报告期内，随着公司业务规模扩大，公司业务招待费以及办公差旅费等费用逐年增加。2023 年，公司销售人员职工薪酬有所降低，主要系 2022 年度公司向销售人员发放的奖金金额较大所致。公司于 2019 年、2020 年和 2023 年分别对核心员工进行了股权激励，报告期内确认的股份支付费用计入销售费用的金额分别为 139.79 万元、252.86 万元和 238.16 万元。

2、管理费用

报告期内，公司管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬及补偿款	2,279.62	34.19%	1,940.22	37.19%	1,596.54	39.37%
折旧摊销费	794.01	11.91%	876.88	16.81%	761.58	18.78%
股份支付	1,606.63	24.10%	404.87	7.76%	321.33	7.92%
中介机构费	633.64	9.50%	823.38	15.78%	336.71	8.30%
物业服务费	154.06	2.31%	129.62	2.48%	113.66	2.80%
办公差旅费	610.96	9.16%	330.18	6.33%	286.43	7.06%
其中：保险费-财产险	150.38	2.26%	-	-	-	-
业务招待费	261.35	3.92%	400.55	7.68%	281.82	6.95%
环安费、维修费	268.17	4.02%	213.77	4.10%	293.69	7.24%
其他费用	58.17	0.87%	97.03	1.86%	63.52	1.57%
合计	**6,666.60**	**100.00%**	**5,216.50**	**100.00%**	**4,055.28**	**100.00%**

公司管理费用主要由职工薪酬、折旧摊销费、股份支付、中介机构费、办公差旅费、业务招待费以及环安费、维修费等组成。报告期内，随着公司生产经营规模持续扩大，公司各类管理费用整体呈增长趋势。2022 年度管理费用较 2021

年度有所增长，主要原因是：1）2022 年度公司规模有所增长，公司基于经营需求招聘了一定数量的管理人员，管理人员数量有所增加，管理人员职工薪酬费用有所增长；2）公司于 2022 年完成首次公开发行工作，相关中介机构费用和业务招待费用有所增长；2023 年度管理费用较 2022 年度有所增长，主要系 2023 年度公司通过限制性股票方式对核心员工实施股权激励，导致股份支付金额较大所致。

3、研发费用

报告期内，公司研发费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
人工费用	3,135.34	39.76%	2,960.98	45.46%	2,420.07	39.93%
折旧费用	2,232.37	28.31%	1,992.48	30.59%	2,009.09	33.15%
直接投入费用	1,213.05	15.38%	907.60	13.93%	1,084.16	17.89%
股份支付	977.85	12.40%	411.52	6.32%	320.31	5.29%
其他费用	327.12	4.15%	241.42	3.71%	226.67	3.74%
合计	**7,885.72**	**100.00%**	**6,514.01**	**100.00%**	**6,060.30**	**100.00%**

报告期内，公司研发费用分别为 6,060.30 万元、6,514.01 万元和 7,885.72 万元，占营业收入的比例分别为 7.62%、6.93%和 6.37%。报告期内，公司高度重视技术研发投入和产品应用开发，持续开展高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片、图像处理芯片等领域的研发项目，研发费用金额逐年增长。公司持续加大研发技术人员储备，并于 2019 年、2020 年和 2023 年对核心人员进行股权激励，研发费用中人工薪酬和股份支付费用金额逐年增长。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用明细及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
利息支出	-0.48	-0.00%	873.63	0.93%	27.17	0.03%

其中：租赁利息支出	19.62	0.02%	17.71	0.02%	-	-
减：利息收入	210.23	0.17%	223.42	0.24%	83.97	0.11%
银行手续费	22.36	0.02%	24.11	0.03%	22.21	0.03%
汇兑损益	-411.77	-0.33%	-680.49	-0.72%	70.20	0.09%
融资担保手续费	-	-	-154.18	-0.16%	242.00	0.30%
合计	**-600.12**	**-0.48%**	**-160.36**	**-0.17%**	**277.62**	**0.35%**

报告期内，公司财务费用分别为 277.62 万元、-160.36 万元和-600.12 万元。2022 年，公司使用首次公开发行募集的补流资金归还了全部银行借款，且受人民币汇率波动影响，汇兑损益金额变动较大，导致 2022 年财务费用为负；2023 年，公司收到财政贴息 110.22 万元冲减财务费用，且受人民币汇率波动影响，汇兑损益金额变动较大，导致 2023 年利息支出和财务费用为负。

（五）其他损益项目分析

1、税金及附加

报告期内，公司税金及附加分别为 228.55 万元、436.08 万元和 444.67 万元。2022 年和 2023 年，公司税金及附加金额有所增长，主要系公司所缴纳的房产税和印花税有所增加。

2、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
与资产相关的政府补助	1,721.07	1,608.42	1,564.66
与收益相关的政府补助	475.31	453.09	332.47
其他	5.75	4.00	12.08
合计	**2,202.13**	**2,065.51**	**1,909.22**

报告期内，公司其他收益分别为 1,909.22 万元、2,065.51 万元和 2,202.13 万元，主要为政府补助。

3、投资收益

报告期内，公司投资收益分别为-5.74 万元、266.47 万元和 1,021.27 万元。2022 年和 2023 年，公司投资收益金额较大，主要系公司使用闲置的募集资金和自用资金购买理财产品所获取的收益。

4、公允价值变动损益

2022 年和 2023 年，公司公允价值变动损益分别为 144.17 万元和 424.28 万元，系公司持有的交易性金融资产所致。

5、信用减值损失/资产减值损失

报告期内，公司信用减值损失、资产减值损失明细情况如下：

单位：万元

项目	类型	2023 年度	2022 年度	2021 年度
信用减值损失	坏账损失	-639.70	338.79	-111.38
资产减值损失	存货跌价损失	-1,015.75	-1,440.82	-907.42
合计		**-1,655.44**	**-1,102.03**	**-1,018.80**

报告期内，公司信用减值损失分别为-111.38 万元、338.79 万元和-639.70 万元，均为坏账损失。公司根据企业会计准则的相关规定，将应收账款、其他应收款等项目的坏账准备计入信用减值损失；存货跌价损失分别为-907.42 万元、-1,440.82 万元和-1,015.75 万元，随着公司存货规模持续增长，公司报告期各期存在一定存货跌价损失。

6、资产处置收益

报告期内，公司资产处置收益分别为 330.96 万元、1,473.23 万元和 335.06 万元，主要系报告期内公司对部分专用设备等固定资产进行处置产生的收益。

7、所得税费用

2022 年和 2023 年，公司所得税费用分别为-332.80 万元和-40.21 万元，系递延所得税费用。报告期内，公司所得税费用金额较少，主要系：一方面，报告期初期公司累计未弥补亏损金额较大；另一方面，公司享受高新技术企业购置设备器具加速折旧以及研发费用加计扣除政策所致。

8、营业外收支

报告期内，公司营业外收支明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
政府补助	37.00	464.00	399.00
无需支付款项	0.84	0.23	0.50
其他	46.79	71.81	23.66
营业外收入合计	**84.63**	**536.04**	**423.16**
非流动资产处置损失	73.09	68.62	-
对外捐赠	-	-	3.98
其他	294.40	1.86	0.00
营业外支出合计	**367.49**	**70.48**	**3.98**

报告期内，公司营业外收入分别为 423.16 万元、536.04 万元和 84.63 万元。2021 年和 2022 年，公司营业外收入金额较大，主要系收到的企业上市奖励款，属于与公司日常活动无关的政府补助，故计入营业外收入。报告期内，公司营业外支出分别为 3.98 万元、70.48 万元和 367.49 万元，2023 年度，营业外支出金额较大，主要系公司向少数客户支付了赔偿款所致。

（六）存在累计未弥补亏损的影响

报告期内，公司营业收入、息税折旧摊销前利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和累计未分配利润/未弥补亏损如下：

单位：万元

项目	2023 年度/2023.12.31	2022 年度/2022.12.31	2021 年度/2021.12.31
营业收入	123,829.30	93,965.28	79,569.99
息税折旧摊销前利润	47,730.24	39,909.84	31,195.48
净利润	19,598.50	17,722.50	14,031.82
扣除非经常性损益后的净利润	16,819.47	12,618.17	9,393.19
累计未分配利润/未弥补亏损	11,028.50	-6,465.26	-22,400.72

截至 2023 年末，公司累计未分配利润为 11,028.50 万元，公司累计未弥补亏损情况已消除。

1、报告期内存在未弥补亏损的原因

公司报告期内存在未弥补亏损主要系前期亏损较多所致，主要原因如下：

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，通常需要经历相对较长的达产期。因此，在达产期前期，长期资产折旧与摊销等固定成本较高，收入规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，导致公司早期形成的累计未弥补亏损金额较大。

母公司股改后，其账面累计未弥补亏损已消除。截至最近一期末，公司累计未弥补亏损情况已消除。

2、累计未弥补亏损的影响分析

随着显示面板下游市场需求的增加和公司生产工艺的优化、产能的持续释放，公司技术水平和产品质量得到市场认可，收入规模快速增长，经营状况持续向好。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 29,539.89 万元、60,114.17 万元和 35,145.96 万元，公司经营状况整体良好；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 9,393.19 万元、12,618.17 万元和 16,819.47 万元，报告期内公司均实现盈利。

报告期内，公司的经营规模和营业收入均实现了快速增长，在销售业绩及各渠道融资的支持下，公司在报告期内各经营环节运作良好，截至最近一期末，公司累计未弥补亏损情况已消除。公司报告期内存在累计未弥补亏损的情形不会对公司的现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、经营可持续性等方面产生重大不利影响。

十、现金流量分析

报告期内，公司的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
经营活动产生的现金流量净额	35,145.96	60,114.17	29,539.89

投资活动产生的现金流量净额	-55,008.35	-137,744.76	-38,591.39
筹资活动产生的现金流量净额	17,899.60	85,593.52	8,998.22
汇率变动对现金的影响	49.23	329.00	-262.34
现金及现金等价物净增加额	-1,913.56	8,291.93	-315.61
现金及现金等价物余额	10,963.87	12,877.43	4,585.50

（一）经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	111,966.09	111,654.87	78,935.26
收到的税费返还	6,108.08	11,689.65	1,769.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,200.74	4,625.64	4,105.80
经营活动现金流入小计	**119,274.91**	**127,970.16**	**84,810.83**
购买商品、接受劳务支付的现金	64,268.61	50,764.99	41,362.77
支付给职工以及为职工支付的现金	16,437.69	13,535.38	11,567.06
支付的各项税费	460.19	498.92	269.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,962.45	3,056.70	2,071.18
经营活动现金流出小计	**84,128.95**	**67,855.99**	**55,270.94**
经营活动产生的现金流量净额	**35,145.96**	**60,114.17**	**29,539.89**

报告期内，随着公司经营规模逐年扩大，经营活动产生的现金流量持续净流入，经营活动现金净流量情况良好。2022 年度，公司经营活动产生的现金流量净额较大，主要系预收部分主要客户货款金额较大及收到大额存量留抵税额返还所致。

（二）投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
收回投资收到的现金	169,800.00	83,000.00	-

取得投资收益收到的现金	1,221.39	200.52	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	589.42	2,316.31	1,041.36
投资活动现金流入小计	**171,610.81**	**85,516.83**	**1,041.36**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,819.17	58,261.58	39,632.75
投资支付的现金	107,800.00	165,000.00	-
投资活动现金流出小计	**226,619.17**	**223,261.58**	**39,632.75**
投资活动产生的现金流量净额	**-55,008.35**	**-137,744.76**	**-38,591.39**

报告期内，公司持续扩充产能，购置先进专用设备，导致投资活动现金净流出金额较大。2021 年度、2022 年度以及 2023 年度，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为39,632.75万元、58,261.58万元和118,819.17万元。2022年和2023年，公司收回投资收到的现金和投资支付的现金金额较大，主要系公司为提高资金使用效率，对暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理，购买和赎回理财产品所致。

（三）筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量明细情况如下：

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
吸收投资收到的现金	-	135,142.95	9,995.28
取得借款收到的现金	18,542.33	38,349.92	52,998.77
收到其他与筹资活动有关的现金	-	250.00	3,085.00
筹资活动现金流入小计	**18,542.33**	**173,742.87**	**66,079.05**
偿还债务支付的现金	-	82,763.98	46,920.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73.10	1,534.70	1,756.66
支付其他与筹资活动有关的现金	569.63	3,850.68	8,404.15
筹资活动现金流出小计	**642.73**	**88,149.35**	**57,080.83**
筹资活动产生的现金流量净额	**17,899.60**	**85,593.52**	**8,998.22**

2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额处于较低水平，主要系公司当年度股权融资金额较少并且归还了部分银行借款所致；公司归还了转贷借款以及通过短期借款置换长期借款以降低借款利率，导致当期取得借款收到的现金与

偿还债务支付的现金发生额较大。

2022 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额较 2021 年度大幅增长，主要系公司首次公开发行募集资金到账所致；公司使用募集的补流资金偿还了全部银行借款，导致当期偿还债务支付的现金发生额较大。

2023 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额和发生额较少，主要系公司已于 2022 年度归还了以前年度全部银行借款，且 2023 年度新增银行借款金额较少且无其他融资事项所致。

十一、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司实际支付的资本性支出分别为 39,632.75 万元、58,261.58 万元和 118,819.17 万元。

公司属于先进封装测试服务商，集成电路封装测试行业对生产设备有较高要求，因此公司的生产设备投入规模大、占资产比重高。报告期内，公司的资本性支出主要用于购置先进的生产设备，用以扩充产能。

（二）公司已公布或可预见将实施的重大资本性支出情况

截至本募集说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目和汇成二期项目第一阶段的投资支出。

公司本次募集资金投资项目支出内容、支出目的及资金需求的解决方式参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”的相关内容。

2023 年 9 月，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签署项目投资合作协议的议案》，汇成二期项目第一阶段预计总投资 100,000.00 万元。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

公司资本性支出不涉及跨行业投资。

公司主要从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务，是中国境内最早

具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的研究与应用，深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目、本次募集资金投资项目和“新建车载显示芯片项目”为公司主营业务及延伸的相关产品的产能扩张项目和研发中心建设项目，是科技创新的实施项目。

十二、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

公司始终将技术创新作为价值创造的源动力，在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺。公司的技术先进性及具体表现参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、与产品有关的技术情况”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术、产品创新作为核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。

截至 2023 年末，公司正在研发的主要项目如下表所示：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
1	先进封装领域高晶圆吸附可靠性的结构及工艺研发	导入量产	提升台盘吸附性与对晶圆的保护作用，避免等待时间过长导致晶圆被刮伤、污染	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
2	高阶影像封装技术研发	项目结案	掌握高阶影像传感器封测技术，成功批量封测高阶影响类产品	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
3	先进晶圆测试设备自动除尘降温机构设计	导入量产	通过设置洁净装置，达到测试环境优化，提高良率	显示驱动芯片等领域
4	先进领域封装一种金凸块空洞检测方式	导入量产	通过研究新空洞检测工序技术，提高效率，新产品研发中的空洞可靠度流程大幅缩短，缩短研发时间	显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
5	超高硬度金凸块工艺研发	导入量产	通过调整添加剂的比重与成分，通过生产过程中的优化调整，提金凸块的硬度，提高良率	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
6	先进封装领域一种双面散热贴贴附工艺研发	申请专利并导入量产	双面散热贴贴附机构设计，提高散热效果增加产品良率	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
7	一种载盘固定校正机构设计	导入量产	降低翻盘次数，提升固定杆稳定性.提升晶粒转置良率	高阶显示驱动芯片、CMOS 影像传感器芯片和新能源车载芯片等领域
8	一种高温测试环境的快速降温设计	申请专利	提升测试环境温度稳定性，能快速达到降温目的	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
9	高深宽比线路金凸块生长工艺的研发	工艺设计与开发	解决了现有金凸块制造工艺中在高深宽比线路区产生空洞无法填充完整的问题	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
10	高解析密集驱动封装技术研发	产品验证	高密度金凸块生产工艺技术,越高的驱动芯片控制与分辨率能力考验生产稳定度，稳定生产良率	显示驱动芯片等领域
11	先进封装领域一种黏轮机构工艺研发	申请专利并导入量产	导入黏轮机构至生产工艺内，降低 particle 影响并提升产品良率	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
12	凹型金凸块工艺研发	工艺设计与开发	提升 ACF 中导电粒子捕获数	显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
13	先进封装领域一种测试分类机传送机构工艺研发	工艺设计与开发	通过设计新式传送机构，提升产品传送稳定度及品质，使产品大幅降低芯片崩缺/隐裂风险及强化抗静电能力	高阶显示驱动芯片、新能源车载芯片等领域
14	提高驱动芯片封装压合效果工艺的研发	导入量产	改善驱动芯片封装压合效果	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
15	显示驱动芯片捡晶技术改善与品质安全防呆技术及装置的研发	导入量产	确保机械手臂移动稳定性，避免晶粒表面受力不均	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
16	久储晶圆凸块再生工艺研发	导入量产	降低芯片封装及封装成本	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
17	柔性基板封装工艺散热技术的研发与应用	导入量产	解决柔性基板封装 IC 散热难题	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
18	多段式光阻去除工艺的研发	小批量生产	降低产品异常发生率，提高产品品质及良率	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
19	柔性基板(FILM)双芯封装技术的研发与应用	小批量生产	提升芯片集成度，扩展芯片功能及品质稳定性	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
20	一种减少负胶蚀刻气泡异常的结构及工艺研发	工艺设计与开发	减少蚀刻药液气泡产生，提升蚀刻效果，降低蚀刻异常发生率，提升产品品质及良率	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域
21	显示驱动封装磨划技术工艺的研发与应用	小批量生产	解决产品破损问题，提升产品可靠性与良率	高阶显示驱动芯片、图像处理芯片、新能源车载芯片等领域

（三）保持持续技术创新的机制和安排

公司自成立以来，高度重视技术创新工作，经过多年的实践与积累，已建立了一套以自身研发实力为基础、以客户市场需求为导向、以高端人才为核心的技术创新机制，为公司的技术进步和工艺水平提升提供了制度保障。公司保持持续技术创新的机制和安排具体参见本募集说明书“第四节发行人基本情况”之“二、公司科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”之“（二）公司保持科技创新能力的机制或措施”。

十三、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项对发行人的影响

经 2024 年 4 月 18 日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《合肥新汇成微电子股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以股本总数 834,853,281 股为基数，扣减回购专用证券账户中的股数 10,447,004 股，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），上述利润分配预案已经 2023 年年度股东大会批准，并已于 2024 年 6 月 6 日发放。

除上述事项外，截至本募集说明书签署日，公司不存在重大对外担保、诉讼、或有事项或其他重大期后事项。

十四、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次发行完成后，公司将获得长期发展资金，且随着未来可转换公司债券持有人陆续转股，公司债务结构将更加合理。如未来实际经营需要，公司将合理制定资产整合计划，并积极履行信息披露义务。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目是建立在公司现有业务基础上的产能扩充。未来随着募集资金投资建设项目的实施，将进一步提升公司的生产能力；补充流动资金将提升公司营运资金规模、缓解流动资金压力，为提高经营业绩及盈利能力提供充足的资金保障。综上，募投项目的实施，将有利于提升公司各项业务竞争力，并为公司业务升级打下坚实基础。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化情况

本次发行完成后，公司的实际控制人仍为郑瑞俊和杨会，公司控制权不会发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、发行人及其子公司报告期内与生产经营相关的重大违法违规行为及受到处罚的情况

报告期内，发行人不存在与生产经营相关的重大违法违规行为，亦不存在因生产经营方面重大违法违规行为而受到行政处罚的情况。

二、发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况

报告期内，发行人及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均不存在被中国证监会行政处罚或采取监管措施、被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况。

三、发行人资金占用和对外担保情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

报告期内，发行人曾为控股股东扬州新瑞连提供担保，具体情况参见本节之“五、关联方及关联交易情况”之“（二）关联交易情况”之“2、偶发性关联交易”之“（1）关联担保”。截至本募集说明书签署日，上述担保已解除，发行人不存在对外担保的情况。

四、同业竞争

（一）公司与控股股东及实际控制人不存在同业竞争

截至本募集说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的

除纳入发行人合并报表范围内的其他企业情况如下：

序号	企业名称	主营业务
1	扬州新瑞连	对外投资
2	合肥芯成	发行人员工持股平台
3	合肥宝芯	发行人员工持股平台
4	合肥汇芯	发行人员工持股平台
5	香港宝信	发行人员工持股平台
6	瑞成建筑	建筑装饰、工业与民用建筑、市政土木工程，室内外装饰设计
7	汇成投资	对外投资
8	瑞成投资	对外投资
9	香港瑞仕	对外投资
10	百瑞发投资	对外投资

发行人主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的除纳入发行人合并报表范围内的其他企业与发行人主营业务不同，相关企业主要从事投资、建筑工程等业务，与发行人不构成同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

发行人上市以来，不存在发生新的同业竞争的情况，发行人控股股东和实际控制人不存在违反同业竞争相关承诺的情况。

1、控股股东承诺

发行人控股股东扬州新瑞连就关于避免同业竞争事项承诺如下：

（1）截至本承诺出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业未直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的任何业务或活动，未持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益；

（2）本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的业务及活动，将不以任何形式持有与汇成股份及其控股子公司所

从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，将不会向与汇成股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；

（3）本企业承诺，本企业将不利用对汇成股份的控制关系进行损害汇成股份及汇成股份其他股东利益的经营活动；

（4）如果本企业违反上述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成汇成股份或其他股东经济损失的，本企业将对汇成股份及其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本企业不再为汇成股份控股股东或者汇成股份终止在科创板上市时为止。本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

2、实际控制人承诺

发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就关于避免同业竞争事项承诺如下：

（1）截至本承诺出具之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业未直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的任何业务或活动，未持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，未在该公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员等职务；

（2）本人及本人直接或间接控制的其他企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的业务及活动，将不以任何形式持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，将不会向与汇成股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；

（3）本人承诺，本人将不利用对汇成股份的控制关系进行损害汇成股份及汇成股份其他股东利益的经营活动；

（4）如果本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成汇成股份或其他股东经济损失的，本人将对汇成股份及其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本人不再为汇成股份实际控制人或者汇成股份终止在科创板上市时为止。本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

五、关联方及关联交易情况

（一）关联方及关联关系

根据《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，发行人的关联方、关联关系情况如下：

1、控股股东、实际控制人相关

（1）控股股东、实际控制人

截至 2024 年 5 月 13 日，公司控股股东为扬州新瑞连，实际控制人为郑瑞俊、杨会夫妇。

（2）控股股东、实际控制人及其近亲属控制的其他企业

截至 2024 年 5 月 13 日，公司控股股东扬州新瑞连除持有发行人股份外无其他对外投资。

除扬州新瑞连、汇成股份及其控制的子公司江苏汇成以外，截至 2024 年 5 月 13 日，公司实际控制人及其近亲属控制的其他主要企业情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	合肥芯成	郑瑞俊担任执行事务合伙人
2	合肥宝芯	郑瑞俊担任执行事务合伙人
3	合肥汇芯	郑瑞俊担任执行事务合伙人
4	香港宝信	郑瑞俊直接持有 50.80%的股份并担任董事

5	汇成投资	郑瑞俊直接持有 70%的股权并担任董事
6	瑞成建筑	郑瑞俊直接持有 80%的股权并担任董事
7	瑞成投资	郑瑞俊直接持有 70%的股权并担任董事
8	香港瑞仕	郑瑞俊之子直接持有 100%的股权并担任董事
9	百瑞发投资	郑瑞俊直接持有 50.96%的股权，香港瑞仕持有 48.97%的股权

（3）控股股东、实际控制人担任董事、高级管理人员或施加重大影响的其他企业

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	本溪瑞成房地产开发经营有限公司	实际控制人郑瑞俊担任副董事长的企业	已于 2001 年 6 月因逾期未年检被吊销
2	海南巨东房地产开发有限公司	实际控制人郑瑞俊担任副董事长的企业	已于 1999 年 12 月因逾期未年检被吊销

2、持有发行人 5%以上股份的其他股东相关

序号	姓名	关联关系	备注
1	纪念	间接持股 5%以上的其他股东	通过扬州新瑞连间接持有发行人 6.26%股份，系发行人董事沈建纬之子沈国威的配偶

3、发行人的子公司、联营企业、合营企业

序号	公司名称	关联关系
1	江苏汇成	子公司
2	晶汇聚芯	发行人直接持有 14.20%财产份额的企业
3	晶合汇信	发行人直接持有 13.00%股权的企业

4、发行人董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员的具体情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”。

5、其他关联方

除上述关联方外，公司关联方还包括上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，及其直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其子公司以外的法人或者其他组织。

除此之外，截至 2024 年 5 月 13 日，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或者关联自然人投资的且报告期内曾与发行人发生关联交易的法人或其他组织如下：

序号	公司名称	关联关系
1	志道投资	赵亚彬担任董事、总经理的企业，报告期内曾持有发行人 5%以上的股份
2	武汉正奇志道投资有限公司	赵亚彬担任执行董事、总经理的企业，志道投资持股 100%
3	合肥质然房地产开发有限公司	赵亚彬担任董事的企业
4	正奇（上海）股权投资管理有限公司	赵亚彬担任董事、总经理的企业
5	安徽正奇资产管理有限公司	赵亚彬担任董事、总经理的企业
6	安徽大湖诚文化传媒有限公司	赵亚彬持股 45%，为第一大股东
7	广东惠伦晶体科技股份有限公司	赵亚彬担任董事的企业
8	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	吴海龙担任董事的企业
9	安徽易芯半导体有限公司	吴海龙担任董事的企业
10	合肥北航通航产业技术有限公司	吴海龙担任董事的企业
11	合肥工投智聚股权投资有限公司	吴海龙担任执行董事、总经理的企业
12	合肥市科创集团有限公司	吴海龙担任董事的企业
13	合肥市创业投资引导基金有限公司	吴海龙担任董事的企业
14	科大硅谷服务平台（安徽）有限公司	吴海龙担任董事长兼总经理的企业
15	合肥市场景应用创新促进中心有限公司	吴海龙担任董事长的企业
16	合肥德丰杰雷名创业投资企业	吴海龙担任法定代表人的企业
17	北京华拓云智科技有限公司	蔺智挺配偶的哥哥姜金竹持股 80%，并担任执行董事、经理
18	苏州麦种科技有限公司	蔺智挺持股 51%，并担任总经理的企业
19	合肥存算体企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	蔺智挺担任执行事务合伙人的企业
20	艾科微电子（深圳）有限公司	马行天的弟弟马行健担任董事的企业
21	苏州格兰科医药科技有限公司	陈殊凡担任董事的企业
22	安徽恒言一信息科技有限公司	闫柳妹妹的配偶衡威威持股 100%，并担任执行董事、总经理
23	上海携益信息技术有限公司	郭小鹏担任执行董事的企业
24	南京邦盛投资管理有限公司	郭小鹏担任董事的企业
25	浩德科技股份有限公司	郭小鹏担任董事的企业
26	成都万创科技股份有限公司	郭小鹏担任董事的企业

27	南京博兰得电子科技有限公司	郭小鹏担任董事的企业
28	江苏华中气体有限公司	郭小鹏担任董事的企业
29	南京典格通信科技有限公司	郭小鹏担任董事的企业

6、报告期内曾存在的关联方

截至 2024 年 5 月 13 日，因发生离职、离任、股份稀释、法人资格注销等情形导致关联关系消除的历史关联方情况如下：

序号	姓名/名称	与发行人的关联关系	报告期内是否存在交易
1	萧明山	报告期内曾担任发行人董事、总经理，已于 2020 年 9 月离职	否
2	袁飞	报告期内曾担任发行人董事，已于 2021 年 3 月离任	否
3	杨毅梅	报告期内曾担任发行人监事，已于 2021 年 3 月离任	否
4	Tieer Gu（顾铁）	报告期内曾担任发行人独立董事，已于 2021 年 6 月离任	否
5	施周峰	报告期内曾担任发行人财务总监、董事会秘书，已于 2022 年 11 月离职	否
6	赵志清	报告期内曾担任发行人监事，已于 2023 年 5 月离任	否
7	杨欢	报告期内曾担任发行人监事，已于 2023 年 11 月离任	否
8	童富	报告期内童富及其关系密切的家庭成员曾通过 Great Title 持有发行人 5%以上股权	否
9	陈玉琴	报告期内陈玉琴及其关系密切的家庭成员曾通过 Advance 间接持有发行人 5%以上股权	否
10	张兆文	陈玉琴的配偶	否
11	上海泰菱金属制品有限公司	张兆文控制的企业	否
12	正奇控股股份有限公司	持有志道投资 100%股权，报告期内曾通过志道投资间接持有发行人 5%以上股份	否
13	联想控股股份有限公司	持有正奇控股股份有限公司 94.62%股权，报告期内曾通过正奇控股股份有限公司间接持有发行人 5%以上股份	否
14	珠海市横琴惟诚投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 90.13%合伙份额，已于 2023 年 10 月 18 日注销	否
15	安徽嘉润金地企业管理有限公司	志道投资持股 100%	否
16	合肥泰兴商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%	否
17	铜陵志道商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%	否
18	铜陵惟道商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%	否

序号	姓名/名称	与发行人的关联关系	报告期内是否存在交易
19	正奇光能科技有限公司	志道投资持股 45%，武汉正奇志道投资有限公司持股 40%	否
20	安徽惟本投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 99.12%合伙份额，已于 2023 年 11 月退出并离任执行事务合伙人	否
21	安徽正乾股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 5%合伙份额	否
22	安徽惟道投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 94.17%合伙份额，已于 2023 年 12 月 15 日注销	否
23	安徽正臻创业投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1%合伙份额	否
24	天津正奇壹号产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1%合伙份额	否
25	哈尔滨祥冠股权投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1%合伙份额	否
26	厦门正奇腾飞一期股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 0.99%合伙份额	否
27	天津原力正奇产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1%合伙份额	否
28	天津正奇凯旋一期新兴产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1%合伙份额	否
29	安徽志飞股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 30%合伙份额	否
30	嘉兴弘道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，并持有 6.67%合伙份额的企业，已于 2021 年 5 月注销	否
31	珠海市横琴惟信股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，并持有 5%合伙份额的企业，已于 2021 年 4 月注销	否
32	安徽正坤创业投资中心（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，已于 2021 年 10 月注销	否
33	合肥雪祺电气股份有限公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2021 年 4 月离任	否
34	安徽统唯新材料科技股份有限公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2021 年 4 月离任	否
35	浙江祥邦科技股份有限公司	赵亚彬曾担任董事，已于 2021 年 6 月离任	否
36	安徽新华国金小额贷款有限公司	赵亚彬曾担任总经理，已于 2023 年 11 月离任	否
37	海口三立现代办公设备有限公司	郑瑞俊曾实际控制的企业，已于 2021 年 11 月注销	否
38	江苏越莱萤环保科技有限公司	杨会曾持股 50%的企业，已于 2021 年 11 月注销	否
39	合肥工大高科信息科技股份有限公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2021 年 9 月离任	否
40	一拓通信集团股份有限公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2021 年 8 月离任	否

序号	姓名/名称	与发行人的关联关系	报告期内是否存在交易
41	合肥新站众智创业投资有限公司	吴海龙曾任董事的企业，已于 2021 年 11 月注销	否
42	西藏志道企业管理有限公司	赵亚彬曾任董事长兼总经理的企业，已于 2022 年 2 月注销	否
43	安徽九华山旅游发展股份有限公司	赵亚彬担任董事的企业，已于 2022 年 4 月离任	否
44	安徽省信息产业投资控股有限公司	吴海龙曾任董事的企业，已于 2022 年 5 月离任	否
45	合肥市东芯信息技术有限公司	吴海龙曾任董事的企业，已于 2023 年 3 月离任董事并担任监事，并已于 2023 年 11 月离任监事	否
46	合肥产投资本创业投资管理有限公司	吴海龙曾任董事、副总经理的企业，已于 2022 年 1 月离任董事，于 2022 年 12 月离任副总经理	否
47	合肥市新站产业投资有限公司	吴海龙曾任董事长的企业，已于 2023 年 7 月离任	否
48	合肥国正	吴海龙曾任董事的企业，已于 2023 年 7 月离任	是
49	浙江阳光普泽融资担保有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 82%，已于 2023 年 10 月注销	否
50	上海剑桥科技股份有限公司	郭小鹏曾任董事的企业，已于 2021 年 7 月离任	否
51	江苏建金科技发展有限公司	郭小鹏曾任董事的企业，已于 2021 年 11 月离任	否
52	江苏斑马软件技术有限公司	郭小鹏曾任董事的企业，已于 2022 年 7 月离任	否
53	江苏千米网络科技有限公司	郭小鹏曾任董事的企业，已于 2024 年 3 月离任	否
54	杨绍校	报告期内曾持有发行人 5%以上股份	否
55	嘉兴高和	报告期内曾持有发行人 5%以上股份，杨绍校为执行事务合伙人	否
56	浙江红太阳毛纺织有限公司	杨绍校担任执行董事	否
57	顺木供应链（浙江）有限公司	杨绍校担任执行董事	否
58	浙江茂森置业有限公司	杨绍校持股 10%并担任董事	否
59	Deep Blue International Investment Holding Ltd.	杨绍校持股 100%并担任董事	否
60	品德国际投资控股（香港）有限公司	杨绍校持股 100%并担任董事	否
61	浙江高和羊毛科技有限公司	品德国际投资控股（香港）有限公司曾持股 100%	否
62	浙江扳鞍实业发展有限公司	嘉兴高和持股 99.61%，杨绍校持股 0.39%	否
63	珠海扳鞍资产管理有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 100%	否
64	扳鞍智慧供应链（嘉兴）有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 100%	否

序号	姓名/名称	与发行人的关联关系	报告期内是否存在交易
65	扳鞍羊毛工业（嘉兴综合保税区）有限公司	扳鞍智慧供应链（嘉兴）有限公司持股 100%	否
66	桐乡市民间融资服务中心有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 70%	否
67	浙江扳鞍资产管理有限公司	嘉兴高和持股 83%，杨绍校持股 17%	否
68	沈阳云智科技有限公司	蔺智挺配偶的哥哥姜金竹曾持股 57%，并担任执行董事的企业，已于 2024 年 2 月退出并离任	否
69	江苏奇纳新材料科技有限公司	郭小鹏担任董事的企业，已于 2024 年 4 月 15 日离任	否

除上述已披露关联方外，发行人的关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其他组织，以及在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述情形之一的法人、其他组织或自然人（视同发行人的关联方）。

（二）关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项简要汇总如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
（一）经常性关联交易				
关键管理人员	薪酬	747.83	599.23	465.13
（二）偶发性关联交易				
郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	关联担保	为发行人提供担保		
扬州新瑞连、瑞成建筑	资金拆入	/	/	为发行人提供资金支持
（三）比照关联方交易				
蔚华、天虹	采购商品	429.37	3,003.20	2,400.90
Spirox、Strong Lion	资金拆入	/	/	为发行人提供资金支持
安徽创新融资担保有限公司	融资担保	为发行人提供担保并收取融资担保费用		

1、经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易为关键管理人员薪酬。

单位：万元

名称	2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
关键管理人员薪酬	747.83	0.82%	599.23	0.89%	465.13	0.83%

注 1：公司股改后聘任的关键管理人员报酬在报告期内连续计算；

注 2：公司前财务总监、董事会秘书施周峰任期自 2021 年 3 月开始，至 2022 年 11 月离职；现财务总监闫柳任期为 2022 年 11 月至 2024 年 3 月，2022 年度关键管理人员薪酬包含上述两人 2022 年度自公司获得的全年税前报酬总额；

注 3：公司现董事会秘书奚勰任期为 2023 年 4 月至 2024 年 3 月，副总经理黄振芳任期为 2023 年 5 月至 2024 年 3 月，前任监事赵志清于 2023 年 5 月离任，2023 年度关键管理人员薪酬包含上述三人 2023 年度自公司获得的税前报酬总额。

报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬分别为 465.13 万元、599.23 万元和 747.83 万元。

2、偶发性关联交易

（1）关联担保

报告期内，汇成股份和江苏汇成发生的关联担保情况如下：

①公司作为被担保方的关联担保

1）报告期内汇成股份作为被担保方的关联担保

序号	债权人	担保方/反担保方	主债权金额（万元）	主债权期限	担保/反担保方式	是否履行完毕
1	中国建设银行股份有限公司龙门支行	扬州新瑞连	6,800.00	2017.09.22-2021.12.15	为担保人合肥鑫城提供股权质押反担保	是
		郑瑞俊			为担保人合肥鑫城提供连带责任保证反担保	
		扬州新瑞连	8,200.00	2018.09.29-2021.12.15	为担保人合肥鑫城提供股权质押反担保	是
2	中国建设银行股份有限公司合肥城东支行	郑瑞俊、杨会、瑞成建筑、安徽创新融资担保有限公司（注1）	7,000.00	2020.05.28-2022.06.01	为担保人合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保	是
		郑瑞俊、杨会、瑞成建筑			为反担保人安徽创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保	是
3	东莞银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊	最高额 8,060.00	主债权发生期间 2019.07.03-2025.07.02	最高额连带责任保证	否
4	合肥国正（委托华夏银行股份有限公司合肥高新区支行贷款）	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	1,000.00	2020.01.21-2021.01.21	连带责任保证	是
			3,000.00	2020.04.30-2021.04.30	连带责任保证	是
			4,000.00	2020.06.10-2021.06.01	连带责任保证	是
			1,000.00	2021.02.26-2022.02.11	连带责任保证	是
			3,000.00	2021.05.10-2022.05.10	连带责任保证	是
			4,000.00	2021.06.21-2022.06.21	连带责任保证	是

序号	债权人	担保方/反担保方	主债权金额（万元）	主债权期限	担保/反担保方式	是否履行完毕
5	合肥兴泰商业保理有限公司	郑瑞俊、杨会	保理总额度 2,000.00	额度有效期 2020.09.18-2021.09.17	连带责任保证	是
6	合肥兴泰科技融资租赁有限公司	郑瑞俊、杨会	4,500.00	2019.02.01-2021.07.02	以个人名下房产提供抵押担保；连带责任保证	是
7	中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.05.06-2022.05.05	最高额连带责任保证（担保债权最高额为 10,000.00 万元）	是
			15,000.00	2021.12.21-2022.08.25		是
8	招商银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.03.29-2022.03.28	最高额连带责任保证	是
		郑瑞俊	最高额 15,000.00	主债权发生期间 2022.02.28-2023.08.15（注 2）	最高额连带责任保证	是
		杨会	最高额 15,000.00			是
9	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.05.17-2022.05.17	以个人名下房产提供抵押担保	是
				主债权发生期间 2021.05.17-2022.11.19（注 3）	最高额连带责任保证	是
10	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊、杨会	最高额 4,000.00	主债权发生期间 2021.05.24-2022.04.29	最高额连带责任保证	是
11	兴业银行股份有限公司合肥支行	郑瑞俊	最高额 6,000.00（注 4）	主债权发生期间 2021.10.19-2022.10.19	最高额连带责任保证	是
		杨会	最高额 6,000.00（注 4）	主债权发生期间 2021.10.20-2022.10.20		是

序号	债权人	担保方/反担保方	主债权金额（万元）	主债权期限	担保/反担保方式	是否履行完毕
12	杭州银行股份有限公司合肥瑶海支行	郑瑞俊	最高额 11,000.00	主债权发生期间 2022.02.21-2023.08.15	最高额连带责任保证	是
		杨会	最高额 11,000.00			是
13	中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 4,800.00	主债权发生期间 2022.06.13-2023.08.21	最高额连带责任保证	是

注 1：安徽创新融资担保有限公司系志道投资的关联公司；

注 2：根据保证合同的相关约定，编号为 551XY2021007941 的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分转入本项担保的被担保主债权范围。

注 3：根据保证合同的相关约定，编号为 HF11（高融）20210002 的《最高额融资合同》和编号为 HF11（高融）20210002-补 1 的《补充协议》项下债权转入本项担保的被担保主债权范围，前述主债权发生期间为 2021 年 05 月 17 日-2022 年 05 月 17 日；

注 4：根据保证合同的相关约定，2021 年 3 月 23 日公司与债权人签署的，编号为 215302 保 007 的《开立银行保函协议》的相关债权也属于该项担保的被担保主债权；

注 5：截至 2023 年 12 月 31 日，上表中尚未履行完毕的担保合同项下均无正在履行的借款。

2）报告期内江苏汇成作为被担保方的关联担保

序号	债权人	担保方	被担保最高债权额（万元）	主债权发生期间	担保方式	是否履行完毕
1	江苏银行股份有限公司扬州分行	郑瑞俊	4,000.00	2019.05.07-2021.09.07	最高额连带责任保证	是
		郑瑞俊、杨会	5,000.00	2021.09.08-2024.07.22	最高额连带责任保证	否
2	中信银行股份有限公司扬州分行	郑瑞俊	3,000.00	2018.04.19-2021.04.19	最高额连带责任保证	是
3	中国银行股份有限公司扬州邗江支行	郑瑞俊	3,500.00	2018.06.22-2023.06.21（注1）	最高额连带责任保证	是
		瑞成建筑	3,500.00	2021.06.01-2023.08.07（注2）	最高额连带责任保证	是
4	正奇国际商业保理有限公司	郑瑞俊、杨会	3,000.00	额度有效期 2020.07.30-2021.01.30	连带责任保证	是
5	招商银行股份有限公司扬州分行	郑瑞俊、杨会	30,00.00	2021.09.26-2022.09.25	最高额连带责任保证	是

注 1：根据保证合同的相关约定，在 2018 年 6 月 22 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权；

注 2：根据保证合同的相关约定，在 2021 年 6 月 1 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权；

注 3：截至 2023 年 12 月 31 日，上表中尚未履行完毕的担保合同项下均无正在履行的借款。

②公司作为担保方的关联担保

报告期内，公司曾作为担保方为扬州新瑞连支付合肥市创业投资引导基金有限公司股权转让款事项提供担保，截至本募集说明书签署日，上述担保事项已解除，具体情况如下：

2018 年 10 月 15 日，扬州新瑞连与合肥市创业投资引导基金有限公司签署股权转让协议，约定合肥市创业投资引导基金有限公司将其持有的汇成有限 16.93%股权（对应出资额 6,800 万元）转让给扬州新瑞连，股权转让价格为合肥市创业投资引导基金有限公司取得该等股权时对应的投资款 17,000 万元附加相应的利息，股权转让款项应在 2021 年 12 月 27 日前付清，公司曾为上述事项提供担保。截至本募集说明书签署日，公司上述担保事项已解除。

担保事项相关信息如下表所示：

被担保人名称	扬州新瑞连
注册资本	50 万元
实收资本	50 万元

住所	扬州高新技术产业开发区纵一路与横三路交界处管委会大楼内 12 楼 1202 室
生产经营情况	股权投资平台
与发行人关系	发行人控股股东
财务数据	**2023.12.31/2023 年度**
总资产（万元）	39,687.88
净资产（万元）	51.54
营业收入（万元）	-
净利润（万元）	0.02
主债务的种类	股权收购款及对应利息
主债务的金额	股权收购款 17,000 万元及对应利息
合同约定履行债务的期限	2018 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 27 日
担保方式	无限连带责任保证
担保范围	扬州新瑞连向合肥市创业投资引导基金有限公司收购 6,800 万股本的交易对价 17,000 万元及对应利息
约定担保期间	2018 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 27 日
解决争议的方法	依法承担违约责任
其他对担保人有重大影响的条款	合肥市创业投资引导基金有限公司、扬州新瑞连、汇成股份与瑞成建筑于 2021 年 9 月签订了补充协议，约定由瑞成建筑作为担保方，发行人不再承担担保义务
担保履行情况	截至本募集说明书签署日，上述担保已解除
是否存在反担保	不存在
该等担保对发行人业务经营与财务状况的影响	上述担保已解除，对发行人不存在不利影响

（2）关联方资金拆入

①直接进行资金拆入

报告期内，公司向关联方直接进行资金拆入具体情况如下：

单位：万元

拆出方	期初数	本期拆入	本期应计利息	本期减少	本期豁免利息	期末数	说明
2021 年度							
扬州新瑞连	1,182.85	1,500.00	45.52	2,682.85	45.52	-	注 1
瑞成建筑	1,000.00	-	32.17	1,000.00	32.17	-	注 1
合计	**2,182.85**	**1,500.00**	**77.68**	**3,682.85**	**77.68**	**-**	

注 1：豁免的拆借款利息计入资本公积。

公司上述资金拆借已经于 2021 年 7 月全部归还。

②委托贷款形式拆入

报告期内，公司通过委托贷款形式拆入资金情况具体如下：

单位：万元

委托方	贷款银行	借款年度	贷款金额
合肥国正	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2021 年度	8,000.00
合计			**8,000.00**

合肥国正系合肥市国资委下属公司，公司出于日常经营资金需求与其签订委托贷款合同，合肥国正通过委托贷款方式向本公司提供借款，上述借款均已归还。

（三）比照关联交易披露的交易

1、交易对方情况

序号	交易对方名称	与本公司关系
1	蔚华电子	公司持股 5%以下股东
2	Spirox	蔚华电子之母公司
3	蔚华科技	Spirox 之母公司
4	蔚华国际有限公司	蔚华电子之关联公司
5	天虹科技	郑瑞俊直接持股 7.10%，其控制的百瑞发投资股份有限公司持股 6.40%的企业
6	鑫天虹（厦门）科技有限公司	天虹科技的全资子公司
7	传晶电子（上海）有限公司	鑫天虹（厦门）科技有限公司的全资子公司
8	Strong Lion	公司持股 5%以下股东
9	安徽创新融资担保有限公司	志道投资的关联公司

2、采购商品

单位：万元

公司名称	交易内容	2023 年度	2022 年度	2021 年度
蔚华	设备	429.37	2,978.27	2,367.37
天虹	材料及费用	-	24.93	33.53
合计	**-**	**429.37**	**3,003.20**	**2,400.90**

注：上表中，按照同一控制下合并口径披露，蔚华包括蔚华科技、蔚华电子和蔚华国际有限公司；天虹包括天虹科技、鑫天虹（厦门）科技有限公司和传晶电子（上海）有限公司。

蔚华科技系中国台湾上市公司，系专业集成电路设备代理商。报告期内，受限于全球及中国集成电路行业的发展情况，公司直接向境外的集成电路设备厂商购置设备需有较长的交期，蔚华科技作为专业的集成电路设备代理商，拥有丰富

的集成电路设备渠道资源，可提高公司的设备采购效率。上述交易价格系双方根据市场公允价格协商确定。

天虹科技、鑫天虹（厦门）科技有限公司系集成电路设备制造商。报告期内，公司曾向天虹科技、鑫天虹（厦门）科技有限公司采购零星配件等。上述采购价格系双方根据市场公允价格协商确定。

3、比照关联方资金拆入

报告期内，公司向比照关联方拆借资金具体情况如下：

单位：万元

拆借单位名称/自然人姓名	期初数	本期拆入	本期应计利息	本期减少	本期豁免利息	期末数	说明
2021 年度							
Spirox	99.81	-	-	99.81	-	-	
Strong Lion	35.62	-	-	35.62	-	-	
合计	**135.43**	**-**	**-**	**135.43**	**-**	**-**	

4、融资担保

报告期内，安徽创新融资担保有限公司为发行人取得银行借款提供融资担保。2021 年度，公司向安徽创新融资担保有限公司支付了融资担保手续费 140.00 万元。

（四）关联交易履行的程序及独立董事的有关意见

股份公司设立以来，公司关联交易履行了《公司章程》规定的程序。报告期内已发生关联交易的审议程序如下：

2021 年 9 月 18 日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》，关联董事在董事会审议该议案时回避表决，并同意将其提交发行人股东大会审议。

2021 年 10 月 8 日，发行人召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

发行人全体独立董事就关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与关联方发生的关联交易系公司正常生产经营活动所需，交易遵循公平、公正、公允的市

场原则，没有对公司财务状况和经营成果产生不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

2021 年 6 月 10 日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事在董事会审议该议案时回避表决，并同意将其提交发行人股东大会审议。

2021 年 6 月 30 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

发行人全体独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司对 2021 年日常关联交易情况的预计是正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价依据合理，价格公允，交易公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

2022 年 4 月 10 日，发行人召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易情况预计的议案》，关联董事在董事会审议该议案时回避表决，该议案无需提交发行人股东大会审议。

发行人全体独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司对 2022 年日常关联交易情况的预计是正常的生产经营需要而发生的，关联交易定价依据合理，价格公允，交易公平、公正，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。

根据对公司 2023 年业务发展和经营需要的预判，除关联人薪酬外，公司预计 2023 年度不存在其他关联交易情况。

（五）关于规范和减少关联交易的承诺

发行人上市以来，不存在新增影响发行人独立性的关联交易的情况，发行人控股股东和实际控制人不存在违反关联交易相关承诺的情况。

1、控股股东承诺

发行人控股股东扬州新瑞连就关于规范和减少关联交易事项承诺如下：

（1）截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本企业及本企业控制的其

他企业与公司之间不存在任何依照相关法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易；

（2）本企业将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本企业及本企业控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

（3）本企业及本企业控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，不在任何情况下要求公司及其下属企业为本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式的担保；

（4）根据相关法律、法规和规范性文件，为减少并规范关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与公司及其子公司发生不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、价格公允的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程（草案）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的规定办理有关审议程序，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

（5）若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本企业将承担全额赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本企业不再为汇成股份控股股东或汇成股份终止在科创板上市时为止。本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

（2）实际控制人承诺

发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就关于规范和减少关联交易事项承诺如下：

（1）截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控制的其他企业与公司之间不存在任何依照相关法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易；

（2）本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

（3）本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，不在任何情况下要求公司及其下属企业为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保；

（4）根据相关法律、法规和规范性文件，为减少并规范关联交易，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与公司及其子公司发生不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、价格公允的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程（草案）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的规定办理有关审议程序，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

（5）若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本人不再为汇成股份实际控制人或汇成股份终止在科创板上市时为止。本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金使用计划

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 114,870.00 万元（含 114,870.00 万元），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资总额	本次募集资金拟投入金额
1	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目	47,611.57	35,000.00
2	12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目	56,099.47	50,000.00
3	补充流动资金	35,000.00	29,870.00
合计		**138,711.04**	**114,870.00**

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自有资金或自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

公司本次募集资金使用符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目

1、项目概况

本项目的实施主体为合肥新汇成微电子股份有限公司，项目建设地点为合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号，项目总投资 47,611.57 万元，计划建设期为 36 个月。本项目利用现有厂房进行建设，开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试生产。本项目建成后，将有效提升公司的生产能力和产能规模，

为公司未来业务发展提供可靠的扩产基础，进一步巩固公司行业地位，提高市场份额。

2、与现有业务的关系

公司目前聚焦于显示驱动芯片的封装测试，以金凸块制造（Gold Bumping）为核心，综合晶圆测试（CP）及玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），具备显示驱动芯片全制程的先进封装测试综合服务能力。本项目拟在现有业务的基础上，结合当前 OLED 等新型显示驱动芯片市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备和软件，开展新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造、晶圆测试服务。本项目建成后，将有效提升公司 OLED 等新型显示驱动芯片的封测服务规模，为公司未来业务发展提供可靠的扩产基础，巩固公司在显示驱动芯片封测领域的领先地位，提高市场份额。

3、项目实施的必要性

（1）本项目有利于满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求

公司是国内领先的显示驱动芯片封装测试服务商，制程包括金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装。公司多次开展生产线投资扩产，目前已建成江苏扬州和安徽合肥两大生产基地，由于技术稳定且服务完善，在全球范围内取得了广泛认可。

在市场需求方面，近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达到 14.0 亿颗，预计 2025 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达 24.5 亿颗，市场占比达到 10.5%。针对市场发展趋势，公司计划扩大在 OLED 领域的产能配置，但是公司当前的设备配置无法满足 OLED 显示驱动芯片需求快速增长的生产需要。为抓住市场机遇，公司计划引进先进高效的生产设备，提升 OLED 产品封装测试能力，满足 OLED 显示驱动芯片快速增长的市场需求，进一步提升公司在显示驱动芯片领域的竞争优势。

（2）本项目有利于满足市场对先进封装测试服务的需要

随着技术的升级换代，高集成度、低能耗成为电子产品最主要的发展趋势，终端用户对性能体验的要求促进了芯片设计、制造与封装的发展。先进封装测试

工艺能够减小芯片占用尺寸、布线长度、厚度等，帮助降低能耗，提高终端用户的屏幕交互体验，促使显示面板厂商会优先采用先进封装测试工艺，因此市场规模快速增长。公司自主开发的金凸块制造技术直接在晶圆上形成焊球或金柱，在此基础上实现了显示驱动芯片的晶圆级高密度细间距倒装封装，有助于开发屏占比高和轻薄化的显示面板，符合整体行业发展趋势。本项目引入先进高效的生产设备后能够提高公司针对 OLED 等新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造和测试服务能力，满足下游客户不断增长的对先进显示驱动芯片封装测试的需求。

（3）本项目有利于提升公司的品牌影响力

随着我国集成电路产业供应链体系的不断完善，本土显示驱动芯片产业的发展前景广阔。首先，第三代显示技术 OLED 具有能耗低、发光率好、亮度高和轻薄等优点，在终端设备中的应用越来越广泛，国产厂商的产能规模快速扩大。其次，随着智能网联汽车的兴起，座舱系统对显示面板的需求快速增加，有望拉动显示面板行业的增长。本项目建成后，公司将扩大 OLED 面板的显示驱动封装测试规模，并且拓展车载显示面板市场，扩大国内市场份额，提升公司的品牌影响力。

4、项目实施的可行性

（1）公司具备先进且成熟的制程工艺

公司长期专注于显示驱动芯片封装测试的研究开发和产业化应用，针对显示驱动芯片封装测试过程中的具体工艺或生产装置进行技术研发，自主研发积累了大量工艺技术，在行业内具有领先地位。公司的核心技术包括驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术、高精度高效内引脚接合工艺等，特别是金凸块制造技术以黄金作为材料，具有出色的导电性、机械加工性以及散热性能，可满足显示面板驱动的使用要求。本项目各制程主要采用公司成熟的工艺，可快速部署投入生产，保障项目顺利实施。

（2）公司具备扎实的客户合作基础

集成电路设计与制造行业具有技术和资本密集特点，行业集中度较高。基于对产品良率和成本的考量，封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺

认证后才能达成长期合作，故存在较高的供应链门槛。公司凭借稳定的产品良率、全流程的生产服务能力和交付能力获得了行业内知名客户的广泛认可。公司的下游客户覆盖了全球排名前五和国内排名前十显示驱动芯片设计公司中的主要企业，包括联咏科技、天钰科技、集创北方、奕力科技、瑞鼎科技、奇景光电、矽创电子等知名显示驱动芯片设计企业，具备良好的客户合作基础，能够为本项目的投产运营提供市场支持。

（3）公司具备良好的产业政策和区位优势

公司地处长三角地区，整体经济较为发达，具备产业人才和科研力量集聚优势，并且得到国家和地方的政策扶持，因此该地区也成为我国集成电路发展最快的区域。安徽省及合肥市均出台了集成电路产业相关政策，例如《安徽省“十四五”科技创新规划》等，鼓励先进封装测试技术的研发和产线投资建设，为企业发展提供了良好条件。

本项目实施地点位于合肥市新站区综合保税区内，在长三角区域经济一体化的辐射范围内。新站区以新型显示、集成电路、高端装备制造、新能源汽车为四大主导产业，集聚了京东方、维信诺、晶合集成等面板产业链企业，显示面板产线规模为国内领先，并以产业分类排名第一获评国家级新型显示产业集群。公司立足合肥市，面向长三角地区，具备与产业链上下游沟通合作的便利条件，有利于节约成本和提升运营效率，为项目建设实施提供便利条件。

5、项目实施和投资概算

（1）项目实施主体及地址

本项目实施主体为汇成股份，建设地点位于合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号，保税区及周边交通顺畅，厂区内公辅配套设施完善，可充分满足项目需求。

（2）项目实施时间及进展

本项目实施期为 36 个月，厂房内部装修预计在建设期第一年内完成，主要生产设备将分批次下单采购、安装和调试，依次投入试生产和运营，以保证项目尽快取得经济效益。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	装修施工	*											
2	设备采购	*	*			*	*			*			
3	设备安装调试		*	*			*			*	*		
4	人员招聘与培训			*	*		*	*			*		
5	项目试运行					*	*	*	*	*	*	*	*

（3）项目投资概算

本项目计划投资总额为 47,611.57 万元，总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，其中建设投资 44,171.33 万元，铺底流动资金 3,440.24 万元。本项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	**建设投资**	**44,171.33**	**35,000.00**
1.1	建筑工程费（装修）	290.50	200.00
1.2	设备及软件购置费	42,181.11	34,200.00
1.3	安装工程费	783.62	600.00
1.4	工程建设其他费用	50.00	-
1.5	预备费	866.10	-
2	**铺底流动资金**	**3,440.24**	**-**
合计		**47,611.57**	**35,000.00**

6、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）营业收入预计

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。本项目建成后，预计在正常年可实现营业收入为 30,269.04 万元（不含税），年利润总额为 6,021.05 万元，项目投资财务内部收益率为 12.98%（所得税后），投资回收期为 7.88 年（所得税后，含建设期 3 年）。

（2）营业成本和费用测算

本次募投项目的产品成本主要包括原辅材料、直接人工、燃料动力和制造费

用。原辅材料参考目前各产品材料成本计算；直接人工根据项目新增生产人员和工程人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算；燃料动力包含水、电、天然气和液氮；制造费用包含折旧、摊销、修理费和其他制造费用。

期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。销售费用按照公司销售费用占收入比例的历史水平进行测算。管理费用中人工费用根据项目新增管理人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算，折旧摊销费用根据项目投资对应折旧摊销金额进行测算，其余管理费用参照汇成股份管理费用占收入比例的历史水平进行测算。研发费用参照汇成股份研发费用占收入比例的历史水平进行测算。财务费用按照本次可转债预计发生的利息费用进行测算。

（3）所得税测算

增值税按照 13%测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；企业所得税率按 15%测算。

7、项目的立项、土地、环保等有关报批事项

本项目在合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号现有厂房进行建设，公司已取得本项目建设地所属地块的不动产权证书。本项目已完成项目备案手续（项目备案号：2306-340163-04-05-470278），已取得环评批复（环建审（2023）12038 号）。

（二）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目

1、项目概况

本项目的实施主体为公司的全资子公司江苏汇成光电有限公司，项目建设地点为江苏省扬州市高新区金荣路 19 号，项目总投资 56,099.47 万元，计划建设期为 36 个月。本项目利用现有厂房进行扩产建设，拟在现有业务的基础上，结合当前市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备，扩大新型显示驱动芯片晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）的生产规模。本项目建成后，将有效提高公司生产能力，满足下游市场需求，扩大公司在行业的影响力，提高盈利能力。

2、与现有业务的关系

公司是一家专业从事显示驱动芯片封装测试的企业，为客户提供芯片封测服务。根据行业发展趋势和公司战略发展，公司拟建设本次“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”，由全资子公司江苏汇成光电有限公司建设实施。本项目拟在现有业务的基础上，结合当前 OLED 等新型显示驱动芯片市场需求和技术发展趋势，通过购置先进的设备，扩大晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装的生产规模。本项目建成后，将有效提高公司 OLED 等新型显示驱动芯片的封装测试能力，满足下游市场需求，扩大公司在行业的影响力，提高盈利能力。

3、项目实施的必要性

（1）顺应行业发展趋势，满足市场需求

随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。公司作为专业从事于晶圆测试和封装的企业，在显示驱动芯片封测行业深耕多年，具备丰富的产品经验和服务技术经验。本项目主要面向逐步扩大的 OLED 面板市场，提前进行产能规划，提升晶圆测试服务的规模，提高覆晶封装产线的服务能力，有利于发挥公司行业竞争优势，满足公司发展需求，同时有利于满足 OLED 显示驱动芯片市场需求，促进显示驱动芯片行业高质量发展。

（2）有利于提高规模效益，抢占市场份额

显示驱动芯片封装测试行业技术水平要求较高、资金需求大、人才综合素质门槛高、客户认证严格，因此行业进入壁垒较高，国内可以实现大规模显示驱动芯片封装测试的企业较少。公司在显示驱动芯片封装测试领域从业多年，拥有扎实的核心技术体系和规模生产经验，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。通过本项目的建设，公司的封装测试服务能力进一步加强，扩充了产品生产规模，强化了规模效益，有利于降低服务成本，提高单位产品的盈利能力；另一方面，本项目购置的先进封测设备，能够满

足新型 OLED 产品的生产需求，从而公司能够更快地布局 OLED 显示驱动芯片封测市场，抓住 OLED 市场机遇。有助于公司稳固现有客户的同时，进行 OLED 市场的开拓，获取更大的市场份额。

（3）有利于提高封装测试行业的国产化水平

目前，我国的液晶显示面板产能占到了全球的 60%以上，但我国芯片产业起步较晚，境外发达国家及地区已经掌握芯片制程的核心技术，并占据了主要芯片市场，因此显示面板上游的芯片制造等高附加值产业大多为境外企业所掌握。在此背景下，境内企业拓展显示面板产品上游产业链，提升产业链上游及中游产品供给能力，实现全流程国产化势在必行。本项目的建设，有助于推动芯片产业链中芯片封测这一环节的建设，强化国产芯片在晶圆封测这一环节的技术能力，使境内产业链整体流转更加畅通，提高行业的国产化水平。

4、项目实施的可行性

（1）广阔的市场前景为项目的实施提供了保障

随着社会经济和科学技术的发展，显示驱动产品不仅仅应用于智能手机、电脑、电视等电子产品，智能家居的兴起使得智能冰箱、空调、家居中控也都采用显示屏作为智能交互系统。同时，由于新能源汽车的智能驾驶、智慧座舱理念的推广，车载用屏尺寸和数量持续上升，车载显示市场需求快速增长。根据 Frost & Sullivan 分析，由于晶圆产能供给紧张，显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模也将随之上涨，预计在 2025 年达到 56.10 亿美元。在显示驱动芯片封测市场需求量持续走高的情况下，下游市场能够快速消化本项目新增的产能，为本项目的运营提供保障。

（2）夯实的技术基础为项目建设提供了保障

显示驱动芯片封装测试行业属于技术密集型行业，技术壁垒较高，需要企业具备丰富的生产加工经验。近年来，OLED 显示驱动芯片不断应用于高端电子消费产品和新能源汽车上，下游厂商对于 OLED 显示驱动芯片的品质要求越来越高，且集成电路设计和制造业技术不断进步，加快了各种封装技术和工艺水平的更新进步周期，需要企业不断进行创新和改进技术水平。公司具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力，在核心技术上，公司拥有驱动芯片可靠性工艺、微间

距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术、高精度高效内引脚接合工艺等。此外，公司技术团队从事显示驱动芯片封测行业多年，具备丰厚的技术经验，能够满足设计公司的目标和下游客户的需求。因此，公司具备扎实的行业经验，为本项目的实施提供支撑。

（3）广泛的客户资源为项目建设提供了良好基础

由于芯片制造对技术、质量和成本有严格的把控要求，显示驱动芯片封测企业与客户建立合作需要进行层层严格认证。公司成立至今，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了众多优质客户，且产生了客户黏性，客户对公司认可度高，合作稳定。公司在长期的市场开拓过程中，已获得众多全球知名显示驱动芯片设计企业的认可，所封测的显示驱动芯片也被应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，服务能力被各方合作企业所信赖。综上所述，广泛的客户资源和良好的客户认可度，为公司的业务承接和业务推广提供了帮助，有助于本项目建成后的产能消化。

5、项目实施和投资概算

（1）项目实施主体及地址

本项目由公司的全资子公司江苏汇成建设实施，建设地点位于江苏省扬州市高新区金荣路 19 号，将利用现有的厂房进行项目扩产建设。

（2）项目实施时间及进展

本项目实施期为 36 个月，厂房内部装修预计在建设期第一年内完成，主要生产设备将分批次下单采购、安装和调试，依次投入试生产和运营，以保证项目尽快取得经济效益。具体进度如下表所示：

序号	建设内容	月份											
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36
1	装修施工	*											
2	设备采购	*	*			*	*			*			
3	设备安装调试		*	*			*			*	*		
4	人员招聘与培训			*	*		*	*			*		
5	项目试运行					*	*	*	*	*	*	*	*

（3）项目投资概算

本项目计划投资总额为 56,099.47 万元，总投资包括建设投资、建设期利息和铺底流动资金，其中建设投资 54,806.42 万元，铺底流动资金 1,293.05 万元。本项目具体投资构成情况如下：

单位：万元

序号	项目	投资额	募集资金拟投入金额
1	**建设投资**	**54,806.42**	**50,000.00**
1.1	建筑工程费（装修）	1,885.10	1,500.00
1.2	设备及软件购置费	50,800.67	48,000.00
1.3	安装工程费	996.01	500.00
1.4	工程建设其他费用	50.00	-
1.5	预备费	1,074.64	-
2	**铺底流动资金**	**1,293.05**	**-**
合计		**56,099.47**	**50,000.00**

6、募投项目效益预测的假设条件及主要计算过程

（1）营业收入预计

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司同类型产品平均销售单价为基础，结合市场情况，在谨慎性原则基础上确定，并根据各年销量情况测算得出。本项目建成后，预计在正常年可实现营业收入为 14,873.40 万元（不含税），年利润总额为 3,996.87 万元，项目投资财务内部收益率为 9.49%（所得税后），投资回收期为 8.64 年（所得税后，含建设期 3 年）。

（2）营业成本和费用测算

本次募投项目的产品成本主要包括原辅材料、直接人工、燃料动力和制造费用。原辅材料参考目前各产品材料成本计算；直接人工根据项目新增生产人员和工程人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算；燃料动力包含水、电、天然气和液氮；制造费用包含折旧、摊销、修理费和其他制造费用。

期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用和财务费用。销售费用按照公

司销售费用占收入比例的历史水平进行测算。管理费用中人工费用根据项目新增管理人员的数量及公司对应员工薪酬水平并考虑运营期内薪酬适当上涨因素后进行测算，折旧摊销费用根据项目投资对应折旧摊销金额进行测算，其余管理费用参照江苏汇成管理费用占收入比例的历史水平进行测算。研发费用参照江苏汇成研发费用占收入比例的历史水平进行测算。财务费用按照本次可转债预计发生的利息费用进行测算。

（3）所得税测算

增值税按照 13%测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；企业所得税率按 15%测算。

7、项目的立项、土地、环保等有关报批事项

本项目在江苏省扬州市高新区金荣路 19 号现有厂房进行建设，公司已取得本项目建设地所属地块的国有土地使用证及房屋所有权证。本项目已取得扬州市邗江区工业和信息化局出具的《江苏省投资项目备案证》（扬邗工信备[2023]87 号），已取得环评批复（扬环审批〔2023〕05-51 号）。

（三）补充流动资金

1、项目概况

为满足公司未来业务发展对流动资金的需求，公司拟将本次可转换公司债券募集资金中的 29,870.00 万元用于补充流动资金。

2、补充流动资金的必要性

（1）公司业务规模快速增长，营运资金需求逐步增加

公司目前处于业务规模快速扩张时期，2021 年至 2023 年，公司营业收入分别为 79,569.99 万元、93,965.28 万元和 123,829.30 万元，年均复合增长率为 24.75%。随着公司业务规模的快速扩张，公司货币资金、应收账款、存货等流动资金需求逐步增加。因此，本次向不特定对象发行可转换公司债券将为公司补充与业务规模相适应的流动资金，有效缓解公司的资金压力，为公司业务持续发展提供保障，实现公司长期持续稳定发展。

（2）持续增加的研发投入需要充足的流动资金作保障

公司是国内领先的显示驱动芯片封装测试服务商，显示驱动芯片封装测试行业技术水平要求较高、资金需求大，公司需要不断进行研发创新、保持技术先进性。公司始终坚持技术研发在经营中的重要地位，将技术研发作为公司可持续经营的支柱，2021 年、2022 年和 2023 年，公司研发费用金额分别为 6,060.30 万元、6,514.01 万元和 7,885.72 万元，始终保持较大研发投入，因此公司需要充足的流动资金以支持公司持续研发创新的需求。

3、补充流动资金的可行性

（1）本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定

本次发行募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。

（2）公司内部治理规范，内控完善

公司建立了以法人治理为核心的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

三、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金投资属于科技创新领域

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目将用于“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”、“12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”以及“补充流动资金”，系按照现有技术和客户基础、研发创新战略、业务发展规划等情况对现有先进封装业务进行的产能扩产和技术的延伸升级，有利于公司进一步提高先进封装测试领域的生产与研发实力，资金投向均围绕主营业务进行，投资于科技创新领域。

（二）募投项目实施将促进公司科技创新水平提升

“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目”和“12吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”都是公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，前者将形成公司每年新增晶圆金凸块制造240,000.00片、晶圆测试54,000.00片的生产能力，后者将形成公司每年新增晶圆测试68,400.00片、玻璃覆晶封装20,400.00万颗、薄膜覆晶封装9,600.00万颗的生产能力，在保证产品良率的同时，提升产品技术水平和生产效率，巩固并提升公司的市场地位和综合竞争力，进一步提高相关产品的市场占有率。“补充流动资金项目”主要满足业务规模扩大带动的营运资金需求、研发投入的资金需求，将帮助公司夯实研发的软硬件基础，进一步提升研发实力。

四、本次募投项目相关既有业务的发展概况、扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性

（一）本次募投项目相关既有业务的发展概况

本次募投项目募集资金系用于扩大公司显示驱动芯片封装测试业务的规模。在显示驱动芯片领域，公司具有领先的行业地位，是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力，具有较强的市场竞争力。同时，公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、奕力科技、集创北方等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。报告期各期内，公司在显示驱动芯片的先进封装测试领域营业收入分别为 76,593.90 万元、88,438.82 万元和 116,845.37 万元，收入规模快速上升。

（二）扩大业务规模的必要性及新增产能规模的合理性

1、扩大业务规模的必要性

公司扩大显示驱动芯片封测业务规模的必要性分析详见本节“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金

凸块制造与晶圆测试扩能项目”之“3、项目实施的必要性”和本节“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目”之“3、项目实施的必要性”

2、新增产能规模的合理性

公司拟通过本次募投项目扩大显示驱动芯片封测业务产能，主要是基于旺盛的下游市场需求，具体来说：

（1）中国大陆封装测试市场井喷式增长

随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，而受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，中国大陆封装测试市场跟随集成电路产业也实现了高速发展。近些年，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时中国大陆芯片设计企业的规模也在逐步扩大，以及全球晶圆制造龙头企业也陆续在大陆建厂扩产，在此背景下，中国大陆封装测试企业将会步入更为快速的发展阶段。根据 Frost & Sullivan 数据，2016 年至 2020 年中国大陆封测市场的年复合增长率为 12.54%，远高于全球封测市场 3.89%的增长速度，同时在未来中国大陆封测市场预计将继续保持高速增长，在 2025 年达到 3,551.90 亿元的市场规模。

（2）OLED 显示驱动芯片快速增长

随着消费升级和技术进步，消费电子产品呈现更薄、更轻的发展趋势，消费者也更加青睐于具有轻薄设计的电子产品。由于 OLED 显示屏具有更加轻薄的属性，其应用范围逐步拓展。显示驱动芯片作为 OLED 屏的上游产业，晶圆封装和测试服务的需求量也会大幅上涨。在市场需求方面，近年来 OLED 显示屏市场渗透率快速提升，根据 Frost & Sullivan 数据，2020 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达到 14.0 亿颗，预计 2025 年全球 OLED 显示驱动芯片出货量达 24.5 亿颗，市场占比达到 10.5%。

（3）先进封装成为行业主流

随着集成电路器件性能的要求不断提高，促进了如 Bumping、Flip Chip、WLCSP、2.5D、3D 等先进封装技术的快速发展。后摩尔定律时代，由于先进制

程的研发投入及难度不断提升，制程技术不能带来成本的有效降低，集成电路行业将更多依靠先进封装技术来实现硬件上的突破。先进封装在提升芯片性能方面具有巨大优势，可以在不依赖先进制程工艺前提下，提高芯片整体性能以及集成度，从而满足终端设备对于芯片体积、性能等不断提升的需求。随着智能汽车、5G 手机等的先进封装需求增加，产能紧张，将会带动封测价格提升，国内提前布局先进封装业务的厂商将会受益。

综上所述，本次募投项目新增产能规模不仅充分考虑了下游需求规模及增速，也将下游客户新增产能对应的匹配需求纳入考量。因此，主动把握未来广阔的市场空间及发展机遇，扩大前瞻性布局，提前进行产能建设储备，以扩大先发优势，新增产能规模具有合理性。

五、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

（一）本次发行对公司经营管理的影响

本次发行募集资金将用于 12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆金凸块制造与晶圆测试扩能项目、12 吋先进制程新型显示驱动芯片晶圆测试与覆晶封装扩能项目和补充流动资金。本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，不会造成公司主营业务的重大变动。同时，上述项目投向科技创新领域，符合国家的相关产业政策和公司的整体战略发展方向，有利于公司巩固现有的竞争优势，具有良好的市场前景和经济效益。

本次募集资金投资项目的顺利实施，有利于公司扩大市场份额，深化公司在相关板块的业务布局，有效提高公司的盈利能力及市场占有率。同时募投项目结合了市场需求和未来发展趋势，契合行业未来发展方向，有助于公司充分发挥规模优势，进而提高公司整体竞争实力和抗风险能力，符合公司长期发展需求及股东利益。

（二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产和总负债规模将相应增加，能够增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有力保障。可转换公司债券转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转换公司债券持有人陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升

公司的抗风险能力。

本次发行募集资金投资项目具有良好的经济效益，虽然短期内可能导致净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定程度的下降。但随着募投项目建设完毕并逐步释放效益，公司的经营规模和盈利能力将得到有效提升，进一步增强公司综合实力，促进公司持续健康发展，为公司股东贡献回报。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1256 号），公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 166,970,656 股，发行价为每股人民币 8.88 元，共计募集资金 1,482,699,425.28 元，坐扣承销和保荐费用 131,269,942.53 元（不含增值税）后的募集资金为 1,351,429,482.75 元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2022 年 8 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 31,069,835.33 元（不含增值税）后，公司募集资金净额为 1,320,359,647.42 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕412 号）。

（二）募集资金的存放情况

根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022 年 8 月，公司与保荐机构海通证券分别同存放募集资金的中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、招商银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

1、截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	132,035.96

项目		序号	金额
截至期初累计发生额	项目投入	B1	100,961.92
	利息收入净额	B2	200.79
本期发生额	项目投入	C1	31,615.74
	利息收入净额	C2	340.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	132,577.65
	利息收入净额	D2=B2+C2	541.69
应结余募集资金		E=A-D1+D2	-
实际结余募集资金（注）		F	-
差异		G=E-F	-

2、截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2023年12月31日余额	备注
中国工商银行股份有限公司合肥新站区支行	1302045719100295856	10,000.00	-	已销户
华夏银行股份有限公司合肥分行	14750000001168508	49,035.96	-	已销户
兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100365322	5,000.00	-	已销户
招商银行股份有限公司合肥分行	514902669010558	68,000.00	-	已销户
合计		**132,035.96**	-	-

二、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司前次募集资金具体使用情况见以下对照表：

前次（首次公开发行）募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：			132,035.96			已累计使用募集资金总额：				132,577.65
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：			不适用			2022 年度				100,961.92
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2023 年度				31,615.74
投资项目			**募集资金投资总额**			**截止日募集资金累计投资额**				**项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）**
序号	**承诺投资项目**	**实际投资项目**	**募集前承诺投资金额**	**募集后承诺投资金额**	**实际投资金额**	**募集前承诺投资金额**	**募集后承诺投资金额**	**实际投资金额**	**实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额**	
1	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	97,406.15	78,000.00	78,000.00	97,406.15	78,000.00	78,493.88	493.88	2023 年 12 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	8,980.84	5,000.00	5,000.00	8,980.84	5,000.00	5,047.37	47.37	2023 年 9 月
3	补充流动资金	补充流动资金	50,000.00	49,035.96	49,035.96	50,000.00	49,035.96	49,036.40	0.44	-
合计			**156,386.99**	**132,035.96**	**132,035.96**	**156,386.99**	**132,035.96**	**132,577.65**	**541.69**	**-**

注 1：“实际投资金额”包括募集资金到账后投入金额及实际已置换预先投入金额；
注 2：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

（二）前次募集资金投资项目变更及延期情况

1、前次募集资金投资项目变更情况

截至2023年12月31日，公司不存在募集资金投资项目的变更情况。

2、前次募集资金投资项目延期情况

公司前次募投项目建设的主要内容为集成电路封装测试设备购置、安装及调试，设备采购的下单时间及付款时间直接影响着募集资金使用和募投项目实施进度。“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”所需购置设备以高值、先进的测试机、探针台等进口设备为主，公司发出采购订单后，设备供应商备货时间周期较长，特别是部分高阶设备产能较为紧张，设备供应商在手订单较多，进一步延长了设备交期。“研发中心建设项目”实施过程中的设备选型及安装调试工作不断优化，同时受国内外经济环境的持续影响，公司在实施项目的过程中相对谨慎，根据下游市场及客户需求的变化适时调整项目实施进度及研发方向。

因此，经过综合分析和审慎评估，公司于2023年5月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”预计达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

项目名称	原计划达到预定可使用状态的时间	调整后达到预定可使用状态的时间
12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	2022 年 12 月	2023 年 12 月
研发中心建设项目	2023 年 06 月	2023 年 09 月

注：截至2023年12月31日，公司前募项目已实施完毕，

前次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。前次募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司正常经营活动造成重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1、前次募集资金投资项目对外转让情况

截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目发生对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

公司于2022年9月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币39,672.78万元。上述事项业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）专项审验，并由其于2022年9月26日出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕9785号）。具体内容详见公司于2022年9月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《合肥新汇成微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2022-003）。截至2022年12月31日，上述置换事项已完成。

（四）前次募集资金投资项目实现效益情况说明

截至2023年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益的情况详见下表：

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	截止日累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2022 年	2021 年		
1	12 吋显示驱动芯片封测扩能项目	不适用	11,496.93 [注 4]	7,516.82	5,034.09	不适用	12,550.91 [注 1]	是
2	研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [注 2]
3	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用 [注 3]

注 1：12 吋显示驱动芯片封测扩能项目是以公司为实施主体，是公司利用现有厂区，在现有技术及工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，公司 12 吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。由于该项目需与其他产线配套使用，公司未针对募投项目新增产能另设单独的管理、核算体系，为直观充分的披露募投项目情况，公司结合原有设备的产能情况和新增募投项目设备产能情况测算募投项目新增产量，再根据当期 12 吋金凸块制造和晶圆测试以及合肥生产基地玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装整体平均

单价、平均单位成本、公司整体费用率等数据测算募投项目实现的效益（利润总额）；公司编制前次募投项目可行性研究报告测算预计效益系根据前次募投项目新增设备情况在与原有产线配套使用情况下达到的预计产能基础上减去原有产能测算各制程新增产能，根据 12 吋金凸块制造和晶圆测试以及合肥生产基地玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装整体平均单价、平均单位变动成本、新增设备折旧、公司整体费用率等数据进行测算，与前述对前次募投项目实现效益的测算不存在矛盾；截止日累计实现效益 12,550.91 万元包括公司 2022 年度实际效益 5,034.09 万元和 2023 年度实际效益 7,516.82 万元。

注 2：该项目无法单独核算效益

注 3：该项目无法单独核算效益

注 4：公司前次募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”的预计效益包括公司 2022 年度和 2023 年度所承诺需要达到的效益水平，其中，2022 年度承诺效益水平为 4,427.43 万元，2023 年度承诺效益水平为 7,069.50 万元。

（五）闲置募集资金使用情况

公司于2022年9月29日召开的第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过人民币70,000.00万元（含本数）（含等值外币）的暂时闲置自有资金进行现金管理（包括但不限于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好、满足保本要求的产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财（含结构性存款）无余额。

（六）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的情况。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

前次募集资金投资项目与公司现有主营业务密切相关，包括 12 吋显示驱动芯片封测扩能项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

前次募集资金是按照发行人已有技术和客户基础、研发创新战略、业务发展规划等情况对先进封装业务进行的产能扩产和技术的延伸升级，有利于公司进一步提高先进封装测试领域的生产与研发实力。前次募投项目中“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”均属于科技创新领域，项目建成达产后，公司产品多样性及产品供应能力将得到增强。补充流动资金项目增强了公

司的资金实力，保障了公司对研发和创新的资金支持，进一步巩固和提升了公司的市场竞争力和抗风险能力。

四、前次募集资金运用专项报告结论

天健会计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2023 年 6 月 16 日、2023 年 8 月 23 日、2024 年 5 月 8 日出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2023〕8167 号、天健审〔2023〕9145 号、天健审〔2024〕5428 号）认为，汇成股份公司董事会编制的截至 2023 年 3 月 31 日、2023 年 6 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目是效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了汇成股份前次募集资金使用情况。

第九节 声明

一、发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事签名：

郑瑞俊　沈建纬　洪伟刚

朱景懿　杨辉　罗昆

蔺智挺

全体监事签名：

郭小鹏　程红艳　陈殊凡

全体高管签名：

郑瑞俊　林文浩　钟玉玄

马行天　黄振芳　奚勰

闫柳

合肥新汇成微电子股份有限公司

2024 年 8 月 5 日

二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

控股股东：扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）

控股股东执行事务合伙人：杨会

实际控制人：郑瑞俊

杨会

2024 年 8 月 5 日

三、保荐机构（主承销商）声明（一）

本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

项目协办人签名：

秦寅臻

秦寅臻

保荐代表人签名：

赵庆辰 何 立

赵庆辰 何 立

法定代表人签名：

周 杰

海通证券股份有限公司

2024年 8 月 5 日

三、保荐机构（主承销商）声明（二）

本人已认真阅读合肥新汇成微电子股份有限公司募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

总经理签名：

李 军

董事长签名：

周 杰

海通证券股份有限公司

2024年 8 月 5 日

四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

卢贤榕

经办律师：

卢贤榕 陈磊

孙静

安徽天禾律师事务所

2024年 8月 5日

天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

地址：杭州市钱江路 1366 号
邮编：310020
电话：（0571） 8821 6888
传真：（0571） 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称募集说明书），确认募集说明书内容与本所出具的《审计报告》（天健审〔2022〕278号、天健审〔2023〕2878号、天健审〔2024〕2278号）、《内部控制审计报告》（天健审〔2024〕2279号）、《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕5428号）以及《最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2024〕5427号）不存在矛盾之处。本所及签字注册会计师对合肥新汇成微电子股份有限公司在募集说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

向晓三 许红瑾

天健会计师事务所负责人

王国海

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二四年八月五日

六、评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

评级人员签名：

董斌 李爱文

评级机构负责人签名：

张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2024年 8 月5 日

七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

（二）关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

公司关于本次发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施具体见“重大事项提示”之“六、关于填补即期回报的措施和承诺”。

第十节 备查文件

一、发行人最近三年的财务报告及审计报告，以及最近一期的财务报告；

二、保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；

三、法律意见书和律师工作报告；

四、董事会编制、股东大会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的鉴证报告；

五、资信评级报告；

六、其他与本次发行有关的重要文件。

附件一、专利

截至 2024 年 5 月 13 日，公司共拥有国内专利 442 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 409 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请时间	专利权保护期限	取得方式	他项权利
1	一种 FOUP 开启器	汇成股份	发明专利	ZL201910321851.9	2019.04.22	20 年	原始取得	无
2	一种应对真空异常的晶圆切割处理方法	汇成股份	发明专利	ZL201911051044.6	2019.10.31	20 年	原始取得	无
3	一种基于内引脚接合机用拆装方便的黏轮安装装置	汇成股份	发明专利	ZL202010273698.X	2020.04.09	20 年	原始取得	无
4	一种全自动贴胶机用工作盘装置	汇成股份	发明专利	ZL202010370518.X	2020.05.06	20 年	原始取得	无
5	一种晶圆研磨前裂片异常的处理方法	汇成股份	发明专利	ZL202010434613.1	2020.05.21	20 年	原始取得	无
6	一种带有防护栏的双层推车	汇成股份	发明专利	ZL202010467875.8	2020.05.28	20 年	原始取得	无
7	一种料盘形变修正治具	汇成股份	发明专利	ZL202110125284.7	2021.01.29	20 年	原始取得	无
8	一种料带盖印方向和盖印码的自动比对方法	汇成股份	发明专利	ZL202110245241.2	2021.03.05	20 年	原始取得	无
9	一种半导体晶圆快速冷却控制装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238101.8	2017.09.26	10 年	原始取得	无
10	一种半导体晶圆的切割装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238001.5	2017.09.26	10 年	原始取得	无
11	一种半导体晶圆级封装结构	汇成股份	实用新型	ZL201721238003.4	2017.09.26	10 年	原始取得	无
12	一种半导体晶圆的检测装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238078.2	2017.09.26	10 年	原始取得	无
13	一种半导体晶圆减薄装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238327.8	2017.09.26	10 年	原始取得	无
14	一种半导体晶圆封装结构	汇成股份	实用新型	ZL201721238104.1	2017.09.26	10 年	原始取得	无
15	一种半导体晶圆传输装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238004.9	2017.09.26	10 年	原始取得	无
16	一种半导体晶圆电镀夹持装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238359.8	2017.09.26	10 年	原始取得	无
17	一种用于半导体晶圆包装的承载台	汇成股份	实用新型	ZL201721237986.X	2017.09.26	10 年	原始取得	无
18	一种半导体晶圆清洗装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238357.9	2017.09.26	10 年	原始取得	无
19	一种专用于半导体晶圆运送的推车	汇成股份	实用新型	ZL201721238328.2	2017.09.26	10 年	原始取得	无
20	一种用于显示器固定	汇成	实用	ZL201821718675.X	2018.10.22	10 年	原始取得	无

	的支架	股份	新型					
21	一种专用于 12 寸金属提篮运送的推车	汇成股份	实用新型	ZL201821718690.4	2018.10.22	10 年	原始取得	无
22	一种晶粒挑拣机 Tray Cover 盘放置平台	汇成股份	实用新型	ZL201821708795.1	2018.10.22	10 年	原始取得	无
23	一种防撞型标准提篮	汇成股份	实用新型	ZL201821718686.8	2018.10.22	10 年	原始取得	无
24	一种半导体晶圆湿法蚀刻装置	汇成股份	实用新型	ZL201821708415.4	2018.10.22	10 年	原始取得	无
25	一种用于晶圆转换的工治具	汇成股份	实用新型	ZL201821718689.1	2018.10.22	10 年	原始取得	无
26	一种用于对胶膜进行切割的工具	汇成股份	实用新型	ZL201821718688.7	2018.10.22	10 年	原始取得	无
27	一种光刻制程中的新型光阻去边喷嘴结构	汇成股份	实用新型	ZL201821921716.5	2018.11.21	10 年	原始取得	无
28	一种蚀刻制程中的新型铁氟龙治具	汇成股份	实用新型	ZL201821921713.1	2018.11.21	10 年	原始取得	无
29	一种可消除气泡的电镀槽	汇成股份	实用新型	ZL201821921711.2	2018.11.21	10 年	原始取得	无
30	一种带真空传感器的显微镜	汇成股份	实用新型	ZL201821922365.X	2018.11.21	10 年	原始取得	无
31	一种风淋防护推车	汇成股份	实用新型	ZL201821953475.2	2018.11.21	10 年	原始取得	无
32	一种用于显微镜观察的操作装置	汇成股份	实用新型	ZL201821922403.1	2018.11.21	10 年	原始取得	无
33	一种蚀刻设备管路排水优化系统	汇成股份	实用新型	ZL201821921712.7	2018.11.21	10 年	原始取得	无
34	一种具有防气泡效果的光刻胶缓冲罐	汇成股份	实用新型	ZL201821921679.8	2018.11.21	10 年	原始取得	无
35	一种蚀刻夹爪作业装置	汇成股份	实用新型	ZL201920350531.1	2019.03.20	10 年	原始取得	无
36	一种蚀刻槽体中的新型晶舟承载装置	汇成股份	实用新型	ZL201920359607.7	2019.03.21	10 年	原始取得	无
37	一种电镀辅助盐的分析装置	汇成股份	实用新型	ZL201920363635.6	2019.03.21	10 年	原始取得	无
38	一种对凸块粗糙度改善的电流密度电镀装置	汇成股份	实用新型	ZL201920363202.0	2019.03.21	10 年	原始取得	无
39	一种 Koyo 烤箱门锁防呆装置	汇成股份	实用新型	ZL201920378175.4	2019.03.25	10 年	原始取得	无
40	一种具有产品保护的风刀导轮	汇成股份	实用新型	ZL201920378158.0	2019.03.25	10 年	原始取得	无
41	一种机器自动安全门装置	汇成股份	实用新型	ZL201920444259.3	2019.04.03	10 年	原始取得	无
42	一种槽位定位标识设备	汇成股份	实用新型	ZL201920444266.3	2019.04.03	10 年	原始取得	无
43	一种晶圆转换器的定位装置	汇成股份	实用新型	ZL201920444750.6	2019.04.03	10 年	原始取得	无
44	一种真空吸笔测量仪	汇成	实用	ZL201920444253.6	2019.04.03	10 年	原始取得	无

		股份	新型					
45	一种 Coater 机台作业腔体真空环境形成装置	汇成股份	实用新型	ZL201920499407.1	2019.04.15	10 年	原始取得	无
46	一种光刻胶放置桶	汇成股份	实用新型	ZL201920517747.2	2019.04.17	10 年	原始取得	无
47	一种提篮反向装置	汇成股份	实用新型	ZL201920517569.3	2019.04.17	10 年	原始取得	无
48	一种检测治具	汇成股份	实用新型	ZL201920517746.8	2019.04.17	10 年	原始取得	无
49	一种集成电路生产用排风节能设备	汇成股份	实用新型	ZL201920704792.9	2019.05.17	10 年	原始取得	无
50	一种实验室研磨台排水装置	汇成股份	实用新型	ZL201920704779.3	2019.05.17	10 年	原始取得	无
51	一种晶圆共用背检平台	汇成股份	实用新型	ZL201921021380.1	2019.07.03	10 年	原始取得	无
52	一种修正齿轮运转偏心的制具	汇成股份	实用新型	ZL201921021348.3	2019.07.03	10 年	原始取得	无
53	一种新型顶针帽机构	汇成股份	实用新型	ZL202020332477.0	2020.03.17	10 年	原始取得	无
54	一种用于内引脚接合机的胡椒罐装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338540.1	2020.03.17	10 年	原始取得	无
55	一种用于内引脚接合机的单排顶针座装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338536.5	2020.03.17	10 年	原始取得	无
56	一种用于内引脚接合机的吸嘴安装座装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338509.8	2020.03.17	10 年	原始取得	无
57	一种用于内引脚接合机的双排顶针座装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338528.0	2020.03.17	10 年	原始取得	无
58	一种基于内引脚接合机用卡锁装置	汇成股份	实用新型	ZL202020508956.3	2020.04.09	10 年	原始取得	无
59	一种基于内引脚接合机的保护放料端承接板	汇成股份	实用新型	ZL202020508945.5	2020.04.09	10 年	原始取得	无
60	一种内引脚接合机开关控制箱保护壳装置	汇成股份	实用新型	ZL202020716295.3	2020.05.06	10 年	原始取得	无
61	一种晶粒拾取手臂水平校正装置	汇成股份	实用新型	ZL202020716084.X	2020.05.06	10 年	原始取得	无
62	一种内引脚接合机传送带用盖板结构	汇成股份	实用新型	ZL202020870687.5	2020.05.22	10 年	原始取得	无
63	一种内引脚接合机之轴心保护盖装置	汇成股份	实用新型	ZL202020870666.3	2020.05.22	10 年	原始取得	无
64	一种内引脚接合机之导轮机构	汇成股份	实用新型	ZL202020870268.1	2020.05.22	10 年	原始取得	无
65	一种防止显微镜镜头刮伤晶圆的装置	汇成股份	实用新型	ZL202121707202.1	2021.07.26	10 年	原始取得	无
66	一种电镀设备内环压合机构	汇成股份	实用新型	ZL202121705335.5	2021.07.26	10 年	原始取得	无
67	一种电镀活性炭洗槽系统	汇成股份	实用新型	ZL202121707208.9	2021.07.26	10 年	原始取得	无

68	一种金凸块制造溅镀机用陶瓷洞板	汇成股份	实用新型	ZL202122190278.8	2021.09.10	10 年	原始取得	无
69	一种刮晶圆边缘残金载台	汇成股份	实用新型	ZL202122188571.0	2021.09.10	10 年	原始取得	无
70	一种具有防倾斜功能的钛钨蚀刻机用晶圆盒固定装置	汇成股份	实用新型	ZL202122467541.3	2021.10.14	10 年	原始取得	无
71	一种蚀刻设备药液供给机构	汇成股份	实用新型	ZL202122674661.0	2021.11.03	10 年	原始取得	无
72	一种切割胶带固定长度定位治具	汇成股份	实用新型	ZL202122875132.7	2021.11.23	10 年	原始取得	无
73	一种 12 寸提篮槽层延伸治具	汇成股份	实用新型	ZL202122875117.2	2021.11.23	10 年	原始取得	无
74	一种设备维修推车	汇成股份	实用新型	ZL202122935043.7	2021.11.26	10 年	原始取得	无
75	一种清洁平台四面吸气治具	汇成股份	实用新型	ZL202122945492.X	2021.11.29	10 年	原始取得	无
76	一种卷带封装站成品运送推车	汇成股份	实用新型	ZL202122985508.X	2021.11.30	10 年	原始取得	无
77	一种用于防止提前取货治具	汇成股份	实用新型	ZL202122987461.0	2021.12.01	10 年	原始取得	无
78	一种提篮槽层延伸治具	汇成股份	实用新型	ZL202123002868.X	2021.12.02	10 年	原始取得	无
79	一种机台目检显微镜装置	汇成股份	实用新型	ZL202123017849.4	2021.12.03	10 年	原始取得	无
80	一种双层卷带搬运推车	汇成股份	实用新型	ZL202123023264.3	2021.12.04	10 年	原始取得	无
81	一种机台共面性量测治具	汇成股份	实用新型	ZL202221777383.X	2022.07.11	10 年	原始取得	无
82	一种测试平板放置盒	汇成股份	实用新型	ZL202221937220.3	2022.07.26	10 年	原始取得	无
83	车间机台作业用备料架	汇成股份	实用新型	ZL202221968225.2	2022.07.28	10 年	原始取得	无
84	Handler 治具收纳箱	汇成股份	实用新型	ZL202221970594.5	2022.07.28	10 年	原始取得	无
85	一种防外溢的废弃芯片抛料盒	汇成股份	实用新型	ZL202222060425.4	2022.08.06	10 年	原始取得	无
86	一种机械手臂用真空吸盘	汇成股份	实用新型	ZL202222087895.X	2022.08.09	10 年	原始取得	无
87	一种打孔器分类放置柜	汇成股份	实用新型	ZL202222087922.3	2022.08.09	10 年	原始取得	无
88	一种升降平台用固定块槽	汇成股份	实用新型	ZL202222105513.1	2022.08.10	10 年	原始取得	无
89	一种混合集成电路外壳封装用喷砂夹具	汇成股份	实用新型	ZL202222457611.1	2022.09.16	10 年	原始取得	无
90	半导体晶圆表面切割设备	汇成股份	实用新型	ZL202222496532.1	2022.09.20	10 年	原始取得	无
91	一种混合集成电路封装测试用定位夹具	汇成股份	实用新型	ZL202222488233.3	2022.09.20	10 年	原始取得	无

92	半导体晶圆封装装置	汇成股份	实用新型	ZL202222501951.X	2022.09.21	10 年	原始取得	无
93	一种防呆提篮改造装置	汇成股份	实用新型	ZL202222737110.9	2022.10.18	10 年	原始取得	无
94	一种减震推车装置	汇成股份	实用新型	ZL202222757882.9	2022.10.20	10 年	原始取得	无
95	一种可移动式散热贴产品冲孔辅助定位装置	汇成股份	实用新型	ZL202222757850.9	2022.10.20	10 年	原始取得	无
96	一种夹具装置	汇成股份	实用新型	ZL202222946225.9	2022.11.07	10 年	原始取得	无
97	一种镭射机拱料报警装置	汇成股份	实用新型	ZL202223140861.9	2022.11.25	10 年	原始取得	无
98	一种减少轴心磨损的卡锁装置	汇成股份	实用新型	ZL202223139945.0	2022.11.25	10 年	原始取得	无
99	一种防晶背刮伤的升降装置	汇成股份	实用新型	ZL202223158948.9	2022.11.28	10 年	原始取得	无
100	一种 SR 面散热贴贴附治具	汇成股份	实用新型	ZL202223543775.2	2022.12.26	10 年	原始取得	无
101	一种手动清洁工具	汇成股份	实用新型	ZL202320016675.X	2023.01.03	10 年	原始取得	无
102	晶圆测试探针卡	江苏汇成	发明专利	ZL201210527894.0	2012.12.11	20 年	原始取得	无
103	一种用于微结构三维形变和位移测试的干涉测量系统	江苏汇成	发明专利	ZL201410064678.6	2014.02.25	20 年	继受取得	无
104	洗除氧化钨的洗液及清洗附着有氧化钨生产工具的方法	江苏汇成	发明专利	ZL201810093214.6	2018.01.31	20 年	原始取得	无
105	一种集成电路芯片的金凸块制造工艺	江苏汇成	发明专利	ZL201810431710.8	2018.05.08	20 年	原始取得	无
106	一种自动化晶圆转移方法	江苏汇成	发明专利	ZL201811492066.1	2018.12.07	20 年	原始取得	无
107	一种晶圆的三面切割方法	江苏汇成	发明专利	ZL201910541212.3	2019.06.21	20 年	原始取得	无
108	一种 COF 封装用涂胶针头回收清洗平台	江苏汇成	发明专利	ZL202011335520.X	2020.11.25	20 年	原始取得	无
109	一种可降低 Tape Bonding 工艺过程中抖动的机构	江苏汇成	发明专利	ZL202011335523.3	2020.11.25	20 年	原始取得	无
110	一种用于产品包装的抽真空压板	江苏汇成	发明专利	ZL202011372548.0	2020.11.30	20 年	原始取得	无
111	一种晶圆离子清洁装置	江苏汇成	发明专利	ZL202011455432.3	2020.12.10	20 年	原始取得	无
112	一种 Prober 点墨器的新型调节打点稳定装置	江苏汇成	发明专利	ZL202011460367.3	2020.12.11	20 年	原始取得	无
113	一种 PP 头 HOLDER 水平检测治具及其使用方法	江苏汇成	发明专利	ZL202011476146.5	2020.12.15	20 年	原始取得	无

114	防脱落防滑手柄	江苏汇成	发明专利	ZL202011524201.3	2020.12.22	20 年	原始取得	无
115	一种防晃推车	江苏汇成	发明专利	ZL202011524204.7	2020.12.22	20 年	原始取得	无
116	一种柔性电路板表面微尘清除器	江苏汇成	发明专利	ZL201310055567.4	2013.02.21	20 年	原始取得	无
117	IC 晶粒防刮伤吸取装置	江苏汇成	实用新型	ZL201420668953.0	2014.11.11	10 年	原始取得	无
118	晶圆测试机晶舟盒乘载平台	江苏汇成	实用新型	ZL201420669400.7	2014.11.11	10 年	原始取得	无
119	IC 芯片检查辅助载具	江苏汇成	实用新型	ZL201420668892.8	2014.11.11	10 年	原始取得	无
120	一种芯片涂胶机的涂胶平台	江苏汇成	实用新型	ZL201420668554.4	2014.11.11	10 年	原始取得	无
121	两段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201420706092.0	2014.11.21	10 年	原始取得	无
122	多段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201420706075.7	2014.11.21	10 年	原始取得	无
123	一种多段式保护层液晶面板驱动芯片封装凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201620029828.4	2016.01.13	10 年	原始取得	无
124	一种微间距驱动芯片金凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201620159958.X	2016.03.03	10 年	原始取得	无
125	一种用于固定 tray 盘的盒子	江苏汇成	实用新型	ZL201620357207.9	2016.04.26	10 年	原始取得	无
126	一种提篮反向装置	江苏汇成	实用新型	ZL201620611335.1	2016.06.21	10 年	原始取得	无
127	一种用于半导体晶圆的便携提篮	江苏汇成	实用新型	ZL201720080677.X	2017.01.22	10 年	原始取得	无
128	一种防刮伤晶圆转移装置	江苏汇成	实用新型	ZL201720080657.2	2017.01.22	10 年	原始取得	无
129	一种打磨油石安装座	江苏汇成	实用新型	ZL201720080419.1	2017.01.22	10 年	原始取得	无
130	一种 UV 机灯管照度检测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201720080940.5	2017.01.22	10 年	原始取得	无
131	一种芯片卷带料盘修复模具	江苏汇成	实用新型	ZL201720232240.3	2017.03.10	10 年	原始取得	无
132	一种切割机防反向拿取装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820074059.9	2018.01.17	10 年	原始取得	无
133	一种晶圆观察检测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820074444.3	2018.01.17	10 年	原始取得	无
134	一种防撞提篮	江苏汇成	实用新型	ZL201820074107.4	2018.01.17	10 年	原始取得	无
135	一种抛光磨轮保养防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820143588.X	2018.01.29	10 年	原始取得	无
136	一种厚度量测仪量测治具	江苏汇成	实用新型	ZL201820143581.8	2018.01.29	10 年	原始取得	无
137	一种用于切割机进料手臂的吸料装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820279791.X	2018.02.28	10 年	原始取得	无

138	一种提篮用防晶圆掉落装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820279703.6	2018.02.28	10 年	原始取得	无
139	一种结构经过改进的漏真空检测盒	江苏汇成	实用新型	ZL201820725616.9	2018.05.16	10 年	原始取得	无
140	一种预防自动打拔器卡死结构	江苏汇成	实用新型	ZL201820769771.0	2018.05.23	10 年	原始取得	无
141	一种晶圆框架平整度检测治具	江苏汇成	实用新型	ZL201821179642.2	2018.07.25	10 年	原始取得	无
142	一种切割机换刀防护工具	江苏汇成	实用新型	ZL201821235709.X	2018.08.02	10 年	原始取得	无
143	一种捡晶机滑块安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL201821261885.0	2018.08.07	10 年	原始取得	无
144	一种吸芯顶针机构	江苏汇成	实用新型	ZL201821447142.2	2018.09.05	10 年	原始取得	无
145	一种检测料带传送脱轨的装置	江苏汇成	实用新型	ZL201821447092.8	2018.09.05	10 年	原始取得	无
146	一种捡晶机顶针夹	江苏汇成	实用新型	ZL201821613263.X	2018.09.30	10 年	原始取得	无
147	一种干式晶圆自动清洁机	江苏汇成	实用新型	ZL201821688068.3	2018.10.18	10 年	原始取得	无
148	一种捡晶机模组定位机构	江苏汇成	实用新型	ZL201821879865.X	2018.11.15	10 年	原始取得	无
149	一种捡晶机 tray 盘定位模组	江苏汇成	实用新型	ZL201821879681.3	2018.11.15	10 年	原始取得	无
150	一种集成电路封测凸块供气管路	江苏汇成	实用新型	ZL201821996488.8	2018.11.30	10 年	原始取得	无
151	一种高位加药装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822021104.7	2018.12.04	10 年	原始取得	无
152	一种晶圆专用读刻号装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822048157.8	2018.12.07	10 年	原始取得	无
153	一种晶舟转盘	江苏汇成	实用新型	ZL201822048068.3	2018.12.07	10 年	原始取得	无
154	一种晶圆胶膜抽水装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822111814.9	2018.12.17	10 年	原始取得	无
155	一种晶圆送料定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822048086.1	2018.12.07	10 年	原始取得	无
156	一种自动化晶圆转移装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822047584.4	2018.12.07	10 年	原始取得	无
157	一种 tray 盘翻盘治具	江苏汇成	实用新型	ZL201822111836.5	2018.12.17	10 年	原始取得	无
158	一种晶圆合框撕胶装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038280.3	2019.01.10	10 年	原始取得	无
159	一种晶圆研磨抛光设备	江苏汇成	实用新型	ZL201920038412.2	2019.01.10	10 年	原始取得	无
160	一种外定位框环贴底膜装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038244.7	2019.01.10	10 年	原始取得	无
161	一种晶圆用合框装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038462.0	2019.01.10	10 年	原始取得	无
162	一种晶圆合框防二次撕胶装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038245.1	2019.01.10	10 年	原始取得	无

163	一种晶圆贴底膜装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038411.8	2019.01.10	10 年	原始取得	无
164	一种可调整式 IC 应力测试装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920120628.3	2019.01.24	10 年	原始取得	无
165	一种晶圆研磨胶膜撕胶用加热型压板	江苏汇成	实用新型	ZL201920121314.5	2019.01.24	10 年	原始取得	无
166	一种增加输入和输出凸点数量的集成电路芯片	江苏汇成	实用新型	ZL201920161638.1	2019.01.30	10 年	原始取得	无
167	一种螺旋式光阻涂布结构及其制备装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920214825.1	2019.02.20	10 年	原始取得	无
168	一种捡晶机顶针安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL201920223065.0	2019.02.22	10 年	原始取得	无
169	一种硅片封装结构	江苏汇成	实用新型	ZL201920223070.1	2019.02.22	10 年	原始取得	无
170	一种带防护装置的晶圆载台	江苏汇成	实用新型	ZL201920239753.6	2019.02.26	10 年	原始取得	无
171	一种带漏涂侦测功能的涂胶装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920240031.2	2019.02.26	10 年	原始取得	无
172	一种保护带磁铁装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920253486.8	2019.02.28	10 年	原始取得	无
173	一种 COF 卷带运输推车	江苏汇成	实用新型	ZL201920396801.2	2019.03.27	10 年	原始取得	无
174	一种 COF 卷盘活动放置架	江苏汇成	实用新型	ZL201920396751.8	2019.03.27	10 年	原始取得	无
175	一种晶圆包装作业操作装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920397436.7	2019.03.27	10 年	原始取得	无
176	一种产品包装封口作业操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920396942.4	2019.03.27	10 年	原始取得	无
177	一种 COF 卷带立式存储货架	江苏汇成	实用新型	ZL201920396988.6	2019.03.27	10 年	原始取得	无
178	一种用于 COF 卷带入库传输窗口内的传输工具	江苏汇成	实用新型	ZL201920396684.X	2019.03.27	10 年	原始取得	无
179	一种用于库房晶圆包装的多功能操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920396987.1	2019.03.27	10 年	原始取得	无
180	一种用于驱动 IC 晶粒包装多功能性工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920396755.6	2019.03.27	10 年	原始取得	无
181	一种保护带自动清洁卷绕机	江苏汇成	实用新型	ZL201920492263.7	2019.04.12	10 年	原始取得	无
182	一种集成电路芯片光阻去除装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920494127.1	2019.04.12	10 年	原始取得	无
183	一种驱动 IC 异常品自动分类收集盒	江苏汇成	实用新型	ZL201920492296.1	2019.04.12	10 年	原始取得	无
184	一种带吹屑装置的捡晶机	江苏汇成	实用新型	ZL201920914298.5	2019.06.18	10 年	原始取得	无
185	一种束带机抽风装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920914280.5	2019.06.18	10 年	原始取得	无

186	一种捡晶机载盘载台定位机构	江苏汇成	实用新型	ZL201920914278.8	2019.06.18	10 年	原始取得	无
187	一种用于清洁治具的工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920914554.0	2019.06.18	10 年	原始取得	无
188	一种 tray 盘入料堆栈区定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920914535.8	2019.06.18	10 年	原始取得	无
189	一种无尘室专用钻孔加工辅助治具	江苏汇成	实用新型	ZL201921109400.0	2019.07.16	10 年	原始取得	无
190	一种包装机用压板	江苏汇成	实用新型	ZL201921222729.8	2019.07.31	10 年	原始取得	无
191	一种内引脚接合机放料机构	江苏汇成	实用新型	ZL201921285137.0	2019.08.09	10 年	原始取得	无
192	一种防掉料目捡机	江苏汇成	实用新型	ZL201921614708.0	2019.09.26	10 年	原始取得	无
193	一种内引脚接合机轨道机构	江苏汇成	实用新型	ZL201921614298.X	2019.09.26	10 年	原始取得	无
194	一种用于调整红外检测装置的反光镜	江苏汇成	实用新型	ZL201921639049.6	2019.09.29	10 年	原始取得	无
195	一种可调整的不良 IC 产品检测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201921639010.4	2019.09.29	10 年	原始取得	无
196	一种自动清洁保护带的装置	江苏汇成	实用新型	ZL201921785283.X	2019.10.23	10 年	原始取得	无
197	一种料带清洁箱	江苏汇成	实用新型	ZL201921785304.8	2019.10.23	10 年	原始取得	无
198	一种料带传输完成自动报警装置	江苏汇成	实用新型	ZL201921785377.7	2019.10.23	10 年	原始取得	无
199	一种晶圆铁环放置推车	江苏汇成	实用新型	ZL201921805345.9	2019.10.25	10 年	原始取得	无
200	一种用于驱动 IC 仓储货架 ESD 防护的设备	江苏汇成	实用新型	ZL201921805006.0	2019.10.25	10 年	原始取得	无
201	一种自动束带机卡套	江苏汇成	实用新型	ZL202020103292.2	2020.01.17	10 年	原始取得	无
202	一种捡晶机侧挡板托盘	江苏汇成	实用新型	ZL202020102066.2	2020.01.17	10 年	原始取得	无
203	一种切割机换刀用弹性三角夹具	江苏汇成	实用新型	ZL202020137028.0	2020.01.21	10 年	原始取得	无
204	一种晶圆撕胶废膜回收装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020136736.2	2020.01.21	10 年	原始取得	无
205	一种 IC 封装称胶重辅助装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020191434.5	2020.02.21	10 年	原始取得	无
206	一种 IC 封装点胶组件高度辅助调节装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020191433.0	2020.02.21	10 年	原始取得	无
207	一种卷带封装注胶治具	江苏汇成	实用新型	ZL202020191460.8	2020.02.21	10 年	原始取得	无
208	一种柔性软带电路板放料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020205272.6	2020.02.25	10 年	原始取得	无
209	一种卷带收料编辑改善治具	江苏汇成	实用新型	ZL202020205251.4	2020.02.25	10 年	原始取得	无

210	一种减小凸块底切的结构	江苏汇成	实用新型	ZL202020224706.7	2020.02.28	10 年	原始取得	无
211	一种缩小凸块底切的结构	江苏汇成	实用新型	ZL202020224822.9	2020.02.28	10 年	原始取得	无
212	一种自动化晶圆上下料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020394874.0	2020.03.25	10 年	原始取得	无
213	提高驱动芯片可靠度的电浆源表面处理装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020394875.5	2020.03.25	10 年	原始取得	无
214	一种出货封口机电子秤平台	江苏汇成	实用新型	ZL202020531228.4	2020.04.13	10 年	原始取得	无
215	一种组合式打印机标签货架	江苏汇成	实用新型	ZL202020531218.0	2020.04.13	10 年	原始取得	无
216	一种入库封口机打印机专用平台	江苏汇成	实用新型	ZL202020531743.2	2020.04.13	10 年	原始取得	无
217	一种用于库房晶圆包装的功能性操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL202020531816.8	2020.04.13	10 年	原始取得	无
218	一种库房用手动缠膜机	江苏汇成	实用新型	ZL202020554764.6	2020.04.15	10 年	原始取得	无
219	一种仓库用重型载物手推车	江苏汇成	实用新型	ZL202020554484.5	2020.04.15	10 年	原始取得	无
220	一种高稳定性多功能 COF 卷带运输推车	江苏汇成	实用新型	ZL202020554474.1	2020.04.15	10 年	原始取得	无
221	一种切割刀片背面刮痕处理装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020859610.8	2020.05.21	10 年	原始取得	无
222	一种具有速度测报警功能的手动卷绕机	江苏汇成	实用新型	ZL202020872376.2	2020.05.22	10 年	原始取得	无
223	一种卷绕机台料带防尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020872237.X	2020.05.22	10 年	原始取得	无
224	一种防掉料的保护带回收装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020873431.X	2020.05.22	10 年	原始取得	无
225	一种卷带垂直放置双层运输装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021222742.6	2020.06.29	10 年	原始取得	无
226	一种胶材快速回温装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021223679.8	2020.06.29	10 年	原始取得	无
227	一种便携式卷带盘放置架	江苏汇成	实用新型	ZL202021222665.4	2020.06.29	10 年	原始取得	无
228	一种防止产品摔落放置货架	江苏汇成	实用新型	ZL202021222767.6	2020.06.29	10 年	原始取得	无
229	一种 tray 盘包装出货输送装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021295545.7	2020.07.06	10 年	原始取得	无
230	一种可循环使用的 tray 盘覆盖治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021296692.6	2020.07.06	10 年	原始取得	无
231	一种可移动式晶背切割 IC 滴水检验治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021545530.1	2020.07.30	10 年	原始取得	无
232	一种 IC 应力量测机安全防护和断晶收集装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021543265.3	2020.07.30	10 年	原始取得	无
233	一种防 OTP 产品接触紫外线的治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021544906.7	2020.07.30	10 年	原始取得	无

234	一种多功能包装储物工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL202021559994.8	2020.07.31	10 年	原始取得	无
235	一种针头清洗专用工作台	江苏汇成	实用新型	ZL202021557718.8	2020.07.31	10 年	原始取得	无
236	一种料带接合器专用转运装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021709037.9	2020.08.17	10 年	原始取得	无
237	一种料带检测机台防脱轨专用观察治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021760252.1	2020.08.21	10 年	原始取得	无
238	一种下料用料盘扩张治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021760230.5	2020.08.21	10 年	原始取得	无
239	一种机台维修晶圆防护专用治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021759705.9	2020.08.21	10 年	原始取得	无
240	一种封装卷带产品存储和搬运两用货架	江苏汇成	实用新型	ZL202021759709.7	2020.08.21	10 年	原始取得	无
241	一种贴膜机换刀治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021777679.2	2020.08.24	10 年	原始取得	无
242	一种捡晶机光源安装固定支架	江苏汇成	实用新型	ZL202021777620.3	2020.08.24	10 年	原始取得	无
243	一种换胶辅助支架治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021777617.1	2020.08.24	10 年	原始取得	无
244	一种新型捡晶机摆臂结构	江苏汇成	实用新型	ZL202021822661.X	2020.08.27	10 年	原始取得	无
245	一种捡晶机双面 tray 盘定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021822624.9	2020.08.27	10 年	原始取得	无
246	一种研磨机主轴转速传感器保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021822687.4	2020.08.27	10 年	原始取得	无
247	一种顶针安装校正装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021854557.9	2020.08.31	10 年	原始取得	无
248	一种卷带封装成品摆放运送推车	江苏汇成	实用新型	ZL202021854436.4	2020.08.31	10 年	原始取得	无
249	一种晶圆移动抓取机构	江苏汇成	实用新型	ZL202021854447.2	2020.08.31	10 年	原始取得	无
250	一种内引脚接合机收料端料盘定位组件	江苏汇成	实用新型	ZL202021854314.5	2020.08.31	10 年	原始取得	无
251	一种旋转轴心金属颗粒收集防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022167395.8	2020.09.28	10 年	原始取得	无
252	一种机台固定料盘专用治具	江苏汇成	实用新型	ZL202022169144.3	2020.09.28	10 年	原始取得	无
253	一种内引脚接合机台颗粒排除装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022199948.8	2020.09.30	10 年	原始取得	无
254	一种防粘料的料带放料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022279897.X	2020.10.14	10 年	原始取得	无
255	一种轴向位置可调的放料端料盘	江苏汇成	实用新型	ZL202022279844.8	2020.10.14	10 年	原始取得	无
256	一种内引脚接合机弹簧组件承接保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022517144.8	2020.11.04	10 年	原始取得	无
257	一种料带出货方向比对检测机台	江苏汇成	实用新型	ZL202022515514.4	2020.11.04	10 年	原始取得	无
258	一种内引脚接合机料带标记料位识别机构	江苏汇成	实用新型	ZL202022515538.X	2020.11.04	10 年	原始取得	无

259	一种内引脚接合机保护带导向机构	江苏汇成	实用新型	ZL202022517124.0	2020.11.04	10 年	原始取得	无
260	一种内引脚接合机台开关防误触装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022543711.7	2020.11.06	10 年	原始取得	无
261	一种合框撕胶一体机传感器安全防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022609235.4	2020.11.12	10 年	原始取得	无
262	一种捡晶机顶针安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL202022609234.X	2020.11.12	10 年	原始取得	无
263	一种束带机计数装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022605513.9	2020.11.12	10 年	原始取得	无
264	一种捡晶机离子风枪防撞架	江苏汇成	实用新型	ZL202022605511.X	2020.11.12	10 年	原始取得	无
265	一种辅助晶圆模组挑拣 IC 的光照装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022620291.8	2020.11.13	10 年	原始取得	无
266	一种防刮蹭的内引脚接合机料带导轨	江苏汇成	实用新型	ZL202022655801.5	2020.11.17	10 年	原始取得	无
267	一种内引脚接合机急停按钮防误触保护罩	江苏汇成	实用新型	ZL202022658643.9	2020.11.17	10 年	原始取得	无
268	一种便捷式辅助工具盒	江苏汇成	实用新型	ZL202022655855.1	2020.11.17	10 年	原始取得	无
269	一种涂胶机目检区防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022706258.7	2020.11.20	10 年	原始取得	无
270	一种涂胶机台连接处防落尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022698969.4	2020.11.20	10 年	原始取得	无
271	一种涂胶机马达弹簧保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022706221.4	2020.11.20	10 年	原始取得	无
272	一种卷带烘烤支撑载具	江苏汇成	实用新型	ZL202022864704.7	2020.12.03	10 年	原始取得	无
273	一种涂胶机涂胶区防落尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022858749.3	2020.12.03	10 年	原始取得	无
274	一种涂胶针头清洗平台	江苏汇成	实用新型	ZL202022858732.8	2020.12.03	10 年	原始取得	无
275	一种流程卡规范放置收纳装置	江苏汇成	实用新型	ZL202023291054.8	2020.12.31	10 年	原始取得	无
276	一种快速检测料盘宽度治具	江苏汇成	实用新型	ZL202023308025.8	2020.12.31	10 年	原始取得	无
277	一种半导体仓储多功能包装桌	江苏汇成	实用新型	ZL202023307900.0	2020.12.31	10 年	原始取得	无
278	一种用于 IC 封装点胶针头清洗的治具	江苏汇成	实用新型	ZL202023291018.1	2020.12.31	10 年	原始取得	无
279	一种 COF 卷带运输推车	江苏汇成	实用新型	ZL202023307972.5	2020.12.31	10 年	原始取得	无
280	一种用于少量产品存储的货架	江苏汇成	实用新型	ZL202120255157.4	2021.01.29	10 年	原始取得	无
281	一种用于运输 COF 卷带的推车	江苏汇成	实用新型	ZL202120255879.X	2021.01.29	10 年	原始取得	无
282	一种 COF 卷带存储货架	江苏汇成	实用新型	ZL202120255155.5	2021.01.29	10 年	原始取得	无
283	一种晶圆多功能包装台	江苏汇成	实用新型	ZL202120255113.1	2021.01.29	10 年	原始取得	无

284	一种用于 IC 拼盘的固定治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120423619.9	2021.02.26	10 年	原始取得	无
285	一种软性电路板打孔比对卡	江苏汇成	实用新型	ZL202120478334.5	2021.03.05	10 年	原始取得	无
286	一种可实现温度管控报警的烤箱	江苏汇成	实用新型	ZL202120478341.5	2021.03.05	10 年	原始取得	无
287	一种内引脚接合机料盘扩张轮机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120628338.7	2021.03.29	10 年	原始取得	无
288	一种改良的内引脚接合机轨道	江苏汇成	实用新型	ZL202120628500.5	2021.03.29	10 年	原始取得	无
289	一种高效率料盘清洁机	江苏汇成	实用新型	ZL202120654632.5	2021.03.31	10 年	原始取得	无
290	一种防反向捡晶机 tray 盘定位机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120654266.3	2021.03.31	10 年	原始取得	无
291	一种卷带手持裁切器	江苏汇成	实用新型	ZL202120667281.1	2021.04.01	10 年	原始取得	无
292	一种可调料带导向机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120722848.0	2021.04.09	10 年	原始取得	无
293	一种可调配重式张力轮机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120722842.3	2021.04.09	10 年	原始取得	无
294	一种用于点胶头拔针治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120733271.3	2021.04.12	10 年	原始取得	无
295	一种料盘垂直存放架	江苏汇成	实用新型	ZL202120733164.0	2021.04.12	10 年	原始取得	无
296	一种内引脚接合机放料端防料带粘黏装置	江苏汇成	实用新型	ZL202120747178.8	2021.04.13	10 年	原始取得	无
297	一种料盘快速量测治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120883405.X	2021.04.27	10 年	原始取得	无
298	一种软性电路板散热贴比对卡	江苏汇成	实用新型	ZL202120883605.5	2021.04.27	10 年	原始取得	无
299	一种拆卸蓝膜辅助治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120927212.X	2021.04.30	10 年	原始取得	无
300	一种用于库房包装缠膜多功能包装台	江苏汇成	实用新型	ZL202120927884.0	2021.04.30	10 年	原始取得	无
301	一种轨道前端可调式出料导向机构	江苏汇成	实用新型	ZL202121647406.0	2021.07.20	10 年	原始取得	无
302	一种防磨损旋转轴心	江苏汇成	实用新型	ZL202121647218.8	2021.07.20	10 年	原始取得	无
303	一种可快速安装料盘的旋转轴心	江苏汇成	实用新型	ZL202121759086.8	2021.07.30	10 年	原始取得	无
304	一种料盘挡板卡锁治具	江苏汇成	实用新型	ZL202121759059.0	2021.07.30	10 年	原始取得	无
305	一种料盘用防卡料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202121777403.9	2021.08.02	10 年	原始取得	无
306	一种便于驱动 IC 晶粒包装的集成化工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL202121843196.2	2021.08.09	10 年	原始取得	无
307	一种用于库房包装作业的一体式操作台	江苏汇成	实用新型	ZL202121843510.7	2021.08.09	10 年	原始取得	无

308	一种料带压料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202121868222.7	2021.08.11	10 年	原始取得	无
309	一种内引脚接合机轨道防拱料压条机构	江苏汇成	实用新型	ZL202121868009.6	2021.08.11	10 年	原始取得	无
310	一种用于卷带产品包装的一体式操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL202122739202.6	2021.11.10	10 年	原始取得	无
311	一种用于仓储出货优化使用缠绕膜的可滚动工具	江苏汇成	实用新型	ZL202122738912.7	2021.11.10	10 年	原始取得	无
312	一种登高梯一体式货架	江苏汇成	实用新型	ZL202220123767.3	2022.01.18	10 年	原始取得	无
313	一种缠绕膜放置桌	江苏汇成	实用新型	ZL202220123755.0	2022.01.18	10 年	原始取得	无
314	一种 Reel 专用推车	江苏汇成	实用新型	ZL202220166411.8	2022.01.21	10 年	原始取得	无
315	一种多样性存储货架	江苏汇成	实用新型	ZL202220185086.X	2022.01.24	10 年	原始取得	无
316	一种 wafer 专用托盘	江苏汇成	实用新型	ZL202220225543.3	2022.01.27	10 年	原始取得	无
317	一种蓝膜专用货架	江苏汇成	实用新型	ZL202220225737.3	2022.01.27	10 年	原始取得	无
318	一种 Frame 变形检测治具	江苏汇成	实用新型	ZL202220344348.2	2022.02.21	10 年	原始取得	无
319	一种带真空检测功能的蓝膜吸附装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220366135.X	2022.02.23	10 年	原始取得	无
320	一种固定式防错位挡板机构	江苏汇成	实用新型	ZL202220366335.5	2022.02.23	10 年	原始取得	无
321	一种研磨检验平台	江苏汇成	实用新型	ZL202220389568.7	2022.02.25	10 年	原始取得	无
322	一种磁吸式应力测试机上压刀安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL202220389558.3	2022.02.25	10 年	原始取得	无
323	一种非接触电容式半导体加工物厚度量测装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220421697.X	2022.03.01	10 年	原始取得	无
324	一种光学量测仪一体式量测平台	江苏汇成	实用新型	ZL202220421431.5	2022.03.01	10 年	原始取得	无
325	一种自动化测量仪精度校准块规装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220511741.6	2022.03.10	10 年	原始取得	无
326	一种内引脚接合机旋转轴心	江苏汇成	实用新型	ZL202220581369.6	2022.03.17	10 年	原始取得	无
327	一种防晶圆污染保护提篮	江苏汇成	实用新型	ZL202220581539.0	2022.03.17	10 年	原始取得	无
328	一种捡晶机入料区 tray 盘防反向装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220776839.4	2022.04.06	10 年	原始取得	无
329	一种便于测量墨点大小的指示卡	江苏汇成	实用新型	ZL202220776363.4	2022.04.06	10 年	原始取得	无
330	一种内引脚机台用料带表面金属颗粒清除装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220869598.8	2022.04.15	10 年	原始取得	无

331	一种测试机 IC 不良品收集装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220869582.7	2022.04.15	10 年	原始取得	无
332	一种料盘调节档杆及旋钮保护防误碰治具	江苏汇成	实用新型	ZL202220914102.4	2022.04.20	10 年	原始取得	无
333	一种防料带弯曲的真空吸附装置	江苏汇成	实用新型	ZL202220914527.5	2022.04.20	10 年	原始取得	无
334	一种内引脚机台分离式轨道防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202221212052.1	2022.05.20	10 年	原始取得	无
335	一种辅助分析电性测试不良品的治具	江苏汇成	实用新型	ZL202221212049.X	2022.05.20	10 年	原始取得	无
336	一种晶圆背检平台	江苏汇成	实用新型	ZL202221293060.3	2022.05.27	10 年	原始取得	无
337	一种防穿料错误治具	江苏汇成	实用新型	ZL202221293081.5	2022.05.27	10 年	原始取得	无
338	一种防止货架中料盘歪倒治具	江苏汇成	实用新型	ZL202221386609.3	2022.06.06	10 年	原始取得	无
339	一种卷绕机台料盘快速停动装置	江苏汇成	实用新型	ZL202221490073.X	2022.06.15	10 年	原始取得	无
340	一种测试机台传送辅助治具	江苏汇成	实用新型	ZL202221490085.2	2022.06.15	10 年	原始取得	无
341	一种翻转机构产生颗粒承接治具	江苏汇成	实用新型	ZL202221517217.6	2022.06.17	10 年	原始取得	无
342	一种卷带式机台备料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202221517221.2	2022.06.17	10 年	原始取得	无
343	一种可调节收料端共面机构	江苏汇成	实用新型	ZL202221538125.6	2022.06.20	10 年	原始取得	无
344	一种不良品防混装治具	江苏汇成	实用新型	ZL202221566822.2	2022.06.22	10 年	原始取得	无
345	一种预防多批作业的货架挡条	江苏汇成	实用新型	ZL202221808689.7	2022.07.14	10 年	原始取得	无
346	一种切口可调节式封箱器	江苏汇成	实用新型	ZL202221981257.6	2022.07.29	10 年	原始取得	无
347	层高可调节式推车	江苏汇成	实用新型	ZL202222030917.9	2022.08.03	10 年	原始取得	无
348	一种升降式货梯	江苏汇成	实用新型	ZL202222030914.5	2022.08.03	10 年	原始取得	无
349	一种卷带双层手推车	江苏汇成	实用新型	ZL202222055267.3	2022.08.05	10 年	原始取得	无
350	一种可消除静电的操作台	江苏汇成	实用新型	ZL202222055225.X	2022.08.05	10 年	原始取得	无
351	一种用于仓库竖放卷带的密集型货架	江苏汇成	实用新型	ZL202222202066.1	2022.08.22	10 年	原始取得	无
352	一款辅助确认产品编辑效果的机构	江苏汇成	实用新型	ZL202222300773.4	2022.08.31	10 年	原始取得	无
353	一种测试机台的高精准定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL202222314700.0	2022.08.31	10 年	原始取得	无
354	一种新型抛料盒装置	江苏汇成	实用新型	ZL202222557281.3	2022.09.27	10 年	原始取得	无
355	一种辅助放大视觉相机机构	江苏汇成	实用新型	ZL202222558112.1	2022.09.27	10 年	原始取得	无

356	一种改善产品翘曲度的收料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202222572593.1	2022.09.28	10 年	原始取得	无
357	一种治工具物料收纳装置	江苏汇成	实用新型	ZL202222751070.3	2022.10.19	10 年	原始取得	无
358	一种桌面分隔防撞装置	江苏汇成	实用新型	ZL202222765473.3	2022.10.20	10 年	原始取得	无
359	一种防料带误穿挡板治具	江苏汇成	实用新型	ZL202222765390.4	2022.10.20	10 年	原始取得	无
360	一种晶圆铁框堆叠防滑落装置	江苏汇成	实用新型	ZL202222777847.3	2022.10.21	10 年	原始取得	无
361	一种预防混料的多层货架	江苏汇成	实用新型	ZL202222777471.6	2022.10.21	10 年	原始取得	无
362	一种适用于无尘更衣室使用的衣帽架	江苏汇成	实用新型	ZL202222932710.0	2022.11.04	10 年	原始取得	无
363	一种手动卷绕机专用静电箱	江苏汇成	实用新型	ZL202222933283.8	2022.11.04	10 年	原始取得	无
364	一种检测齿轮与导轮间距的测量工具	江苏汇成	实用新型	ZL202222965850.8	2022.11.08	10 年	原始取得	无
365	一种标签和色豆贴纸摆放盒	江苏汇成	实用新型	ZL202223042477.5	2022.11.16	10 年	原始取得	无
366	一种可重复使用标牌	江苏汇成	实用新型	ZL202223047269.4	2022.11.16	10 年	原始取得	无
367	一种入料载台提篮卡扣防挡治具	江苏汇成	实用新型	ZL202223203480.0	2022.12.01	10 年	原始取得	无
368	一种接触式 IC 厚度量测装置	江苏汇成	实用新型	ZL202223203486.8	2022.12.01	10 年	原始取得	无
369	一种平边晶圆刻画治具	江苏汇成	实用新型	ZL202223220671.8	2022.12.02	10 年	原始取得	无
370	一种双固定部吸嘴安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL202223220676.0	2022.12.02	10 年	原始取得	无
371	一种 COF 成品翘曲度量测治具	江苏汇成	实用新型	ZL202320068236.3	2023.01.10	10 年	原始取得	无
372	一种防静电刷装置及卷带封装设备	江苏汇成	实用新型	ZL202320090790.1	2023.01.31	10 年	原始取得	无
373	一种包装机真空侦测报警装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320140485.9	2023.02.07	10 年	原始取得	无
374	一种内引脚接合机的防护罩阻裂装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320152314.8	2023.02.08	10 年	原始取得	无
375	一种光刻机防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320195481.0	2023.02.13	10 年	原始取得	无
376	一种喷胶嘴保湿盒	江苏汇成	实用新型	ZL202320195480.6	2023.02.13	10 年	原始取得	无
377	一种去光阻稀释剂罐液位传感器防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320208344.6	2023.02.14	10 年	原始取得	无
378	一种具有防护门的晶圆放置装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320217426.7	2023.02.15	10 年	原始取得	无
379	一种晶圆搬送控制按钮防护罩	江苏汇成	实用新型	ZL202320393381.9	2023.03.06	10 年	原始取得	无
380	一种用于晶周盒胶带缠绕的设备	江苏汇成	实用新型	ZL202320602490.7	2023.03.24	10 年	原始取得	无

381	一种可改善保护带共面的调节式阶梯轮	江苏汇成	实用新型	ZL202320602489.4	2023.03.24	10 年	原始取得	无
382	一种显微镜平台防 Particle 保护盖	江苏汇成	实用新型	ZL202320668349.7	2023.03.30	10 年	原始取得	无
383	一种内引脚接合机多功能鼠标承接板	江苏汇成	实用新型	ZL202320718639.8	2023.04.04	10 年	原始取得	无
384	一种节省压缩气体装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320704273.9	2023.04.03	10 年	原始取得	无
385	一种辅助 tape 量测的玻璃冶具	江苏汇成	实用新型	ZL202320685179.3	2023.03.31	10 年	原始取得	无
386	一种改进型卷绕机料盘固定卡锁	江苏汇成	实用新型	ZL202320589229.8	2023.03.23	10 年	原始取得	无
387	一种风刀固定装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320140502.9	2023.02.07	10 年	原始取得	无
388	一种高精密辅助分析捲带式驱动 IC 的装置	江苏汇成	发明专利	ZL202111540839.0	2021.12.16	20 年	原始取得	无
389	一种晶圆贴底膜装置	江苏汇成	发明专利	ZL201910022232.X	2019.01.10	20 年	原始取得	无
390	一种自动化晶圆转移装置	江苏汇成	发明专利	ZL201811492067.6	2018.12.07	20 年	原始取得	无
391	一种 OVEN 机台控制面板防误触装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320718626.0	2023.04.04	10 年	原始取得	无
392	一种读取及播报机台异常报警代码装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320704277.7	2023.04.03	10 年	原始取得	无
393	一种切割后晶圆包装盒	江苏汇成	实用新型	ZL202320685181.0	2023.03.31	10 年	原始取得	无
394	一种可调节式离子枪安装支架	江苏汇成	实用新型	ZL202320668365.6	2023.03.30	10 年	原始取得	无
395	一种涂覆涂胶轴颗粒防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320668355.2	2023.03.30	10 年	原始取得	无
396	一种防打滑的卷绕机轴心刹车装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320589247.6	2023.03.23	10 年	原始取得	无
397	一种防晶圆污染显微镜挡板	江苏汇成	实用新型	ZL202320393379.1	2023.03.06	10 年	原始取得	无
398	一种用于 load port 的排风装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320353384.X	2023.03.01	10 年	原始取得	无
399	一款 FT 测试机台冲裁不良品的计数器治具	江苏汇成	实用新型	ZL202320353388.8	2023.03.01	10 年	原始取得	无
400	一种光阻涂布机械手晶圆防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320323260.7	2023.02.27	10 年	原始取得	无
401	一种显微镜遮光组件	江苏汇成	实用新型	ZL202320323108.9	2023.02.27	10 年	原始取得	无
402	一种判断 COF 产品品质的显示装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320068238.2	2023.01.10	10 年	原始取得	无
403	卷绕机台保护带传输导轨装置	江苏汇成	发明专利	ZL202111540989.1	2021.12.16	20 年	原始取得	无
404	一种石英舟运输专用防震车	江苏汇成	实用新型	ZL202321175157.9	2023.05.16	10 年	原始取得	无

405	一种防真空掉落保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321139803.6	2023.05.12	10 年	原始取得	无
406	半导体芯片封装用点胶设备	汇成股份	发明专利	ZL202211175520.7	2022.09.26	20 年	原始取得	无
407	一种卷带式封装设备用料带可视镜	汇成股份	实用新型	ZL202321441205.4	2023.06.07	10 年	原始取得	无
408	一种合框机滑行盖固定装置	江苏汇成	发明专利	ZL202111534416.8	2021.12.15	20 年	原始取得	无
409	一种内引脚接合机网状式加强型挡板	江苏汇成	实用新型	ZL202321139805.5	2023.05.12	10 年	原始取得	无
410	一种离子风扇安装固定装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321242441.3	2023.05.22	10 年	原始取得	无
411	一种用于涂胶机前置清针装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321628739.8	2023.06.26	10 年	原始取得	无
412	一种新型锁紧装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321628730.7	2023.06.26	10 年	原始取得	无
413	一种 12 寸晶圆专用推车	江苏汇成	实用新型	ZL202321662581.6	2023.06.28	10 年	原始取得	无
414	一种 ESD 防护卷带货架	江苏汇成	实用新型	ZL202321662606.2	2023.06.28	10 年	原始取得	无
415	一种防止料盘宽度用错装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321855040.5	2023.07.14	10 年	原始取得	无
416	一种 AVI 机台张力轮防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321855035.4	2023.07.14	10 年	原始取得	无
417	一种保护带张力调节装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321872275.5	2023.07.17	10 年	原始取得	无
418	一种限制测试机台显微镜载台高度的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322009387.4	2023.07.28	10 年	原始取得	无
419	一种防止 INK 笔泼墨的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322228723.4	2023.08.18	10 年	原始取得	无
420	一种金凸块表面粗糙度改善方法	汇成股份	发明专利	ZL202111062370.4	2021.09.10	20 年	原始取得	无
421	一种马达轴心防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202321872281.0	2023.07.17	10 年	原始取得	无
422	一种摄像头安装固定装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322009376.6	2023.07.28	10 年	原始取得	无
423	一种电浆机台显示器及鼠标固定装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322189568.X	2023.08.15	10 年	原始取得	无
424	一种油墨机台线圈笔架保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322258863.6	2023.08.22	10 年	原始取得	无
425	一种 COF 料带紧密型放置搁架	江苏汇成	实用新型	ZL202322258846.2	2023.08.22	10 年	原始取得	无
426	涂胶前轨道风刀	汇成股份	实用新型	ZL202322078322.5	2023.08.03	10 年	原始取得	无
427	一种改造后的轨道支撑弧	汇成股份	实用新型	ZL202322121466.4	2023.08.08	10 年	原始取得	无
428	一种便于更换内环 o-ring 装置	汇成股份	实用新型	ZL202322619040.1	2023.09.25	10 年	原始取得	无
429	一种胶管存储放置架	汇成股份	实用新型	ZL202322741041.3	2023.10.11	10 年	原始取得	无

430	一种螺旋式光阻涂布结构及其制备装置与方法	江苏汇成	发明专利	ZL201910125864.9	2019.02.20	20 年	原始取得	无
431	一种硅片封装结构及其制备方法	江苏汇成	发明专利	ZL201910131730.8	2019.02.22	20 年	原始取得	无
432	一种 UV 机晶圆铁框定位装置	江苏汇成	发明专利	ZL202011549660.7	2020.12.24	20 年	原始取得	无
433	一种 OVEN 机台电源开关防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202320668358.6	2023.03.30	10 年	原始取得	无
434	一种具备连接插头快速控制开关的点墨机台	江苏汇成	实用新型	ZL202322146524.9	2023.08.10	10 年	原始取得	无
435	一种电浆机台晶圆收纳盒保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322189598.0	2023.08.15	10 年	原始取得	无
436	一种用于 INK 笔开封的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322228703.7	2023.08.18	10 年	原始取得	无
437	一种可调节的防止 INK 笔刮伤晶圆表面的装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322356459.2	2023.08.31	10 年	原始取得	无
438	一种 IC 拾取承接装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322371853.3	2023.09.01	10 年	原始取得	无
439	一种晶舟盒氮气柜流量计保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322416133.4	2023.09.06	10 年	原始取得	无
440	一种配备有外挂计时蜂鸣器的烘干烤箱	江苏汇成	实用新型	ZL202322416123.0	2023.09.06	10 年	原始取得	无
441	一种晶圆溅镀定位治具	江苏汇成	实用新型	ZL202322428452.7	2023.09.07	10 年	原始取得	无
442	一种取标头存放装置	江苏汇成	实用新型	ZL202322498833.2	2023.09.14	10 年	原始取得	无

注 1：发明专利保护期限为 20 年，实用新型专利保护期限为 10 年，自申请之日起算。

注 2：一种用于微结构三维形变和位移测试的干涉测量系统（ZL201410064678.6）系江苏汇成自西安电子科技大学处受让取得。